

목 차

분 기 보 고 서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	3
3. 자본금 변동사항	3
4. 주식의 총수 등	3
5. 정관에 관한 사항	3
II. 사업의 내용	4
1. 사업의 개요	4
2. 주요 제품 및 서비스	5
3. 원재료 및 생산설비	7
4. 매출 및 수주상황	14
5. 위험관리 및 파생거래	18
6. 주요계약 및 연구개발활동	25
7. 기타 참고사항	30
III. 재무에 관한 사항	52
1. 요약재무정보	52
2. 연결재무제표	54
2-1. 연결 재무상태표	54
2-2. 연결 손익계산서	55
2-3. 연결 포괄손익계산서	56
2-4. 연결 자본변동표	56
2-5. 연결 현금흐름표	58
3. 연결재무제표 주석	59
1. 일반적 사항 (연결)	59
2. 중요한 회계처리방침 (연결)	70
3. 범주별 금융상품 (연결)	71
4. 공정가치금융자산 (연결)	72
5. 채고자산 (연결)	74
6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)	74
7. 유형자산 (연결)	79
8. 무형자산 (연결)	80
9. 차입금 (연결)	81
10. 사채 (연결)	83
11. 순확정급여부채(자산) (연결)	84
12. 충당부채 (연결)	85
13. 우발부채와 약정사항 (연결)	86
14. 계약부채 (연결)	87
15. 자본금 (연결)	87
16. 연결이익잉여금 (연결)	89
17. 기타자본항목 (연결)	90
18. 비용의 성격별 분류 (연결)	92
19. 판매비와관리비 (연결)	93
20. 기타수익 및 기타비용 (연결)	93

21. 금융수익 및 금융비용 (연결).....	94
22. 법인세비용 (연결).....	95
23. 주당이익 (연결).....	95
24. 현금흐름표 (연결).....	96
25-1. 재무위험관리 (연결).....	99
25-2. 공정가치측정 (연결).....	102
26. 부문별 보고 (연결).....	108
27. 특수관계자와의 거래 (연결).....	110
28. 사업결합 (연결).....	115
29. 보고기간 후 사건 (연결).....	117
4. 재무제표.....	117
4-1. 재무상태표.....	117
4-2. 손익계산서.....	119
4-3. 포괄손익계산서.....	119
4-4. 자본변동표.....	120
4-5. 현금흐름표.....	120
5. 재무제표 주석.....	121
1. 일반적 사항.....	121
2. 중요한 회계처리방침.....	122
3. 범주별 금융상품.....	123
4. 공정가치금융자산.....	124
5. 채고자산.....	125
6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자.....	126
7. 유형자산.....	127
8. 무형자산.....	128
9. 차입금.....	129
10. 사채.....	131
11. 순확정급여부채(자산).....	132
12. 충당부채.....	133
13. 우발부채와 약정사항.....	134
14. 계약부채.....	135
15. 자본금.....	136
16. 이익잉여금.....	137
17. 기타자본항목.....	138
18. 비용의 성격별 분류.....	140
19. 판매비와관리비.....	141
20. 기타수익 및 기타비용.....	142
21. 금융수익 및 금융비용.....	142
22. 법인세비용.....	143
23. 주당이익.....	143
24. 현금흐름표.....	144
25-1. 재무위험관리.....	146
25-2. 공정가치측정.....	150
26. 부문별 보고.....	155
27. 특수관계자와의 거래.....	156
6. 배당에 관한 사항.....	167
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항.....	170

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	170
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	174
8. 기타 재무에 관한 사항	175
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	198
V. 회계감사인의 감사의견 등	199
1. 외부감사에 관한 사항	199
2. 내부통제에 관한 사항	206
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	207
1. 이사회에 관한 사항	207
2. 감사제도에 관한 사항	207
3. 주주총회 등에 관한 사항	207
VII. 주주에 관한 사항	215
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	222
1. 임원 및 직원 등의 현황	222
2. 임원의 보수 등	266
IX. 계열회사 등에 관한 사항	267
X. 대주주 등과의 거래내용	268
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	271
1. 공시내용 진행 및 변경사항	271
2. 우발부채 등에 관한 사항	271
3. 제재 등과 관련된 사항	273
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	273
XII. 상세표	274
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	274
2. 계열회사 현황(상세)	274
3. 타법인출자 현황(상세)	274
4. 연구개발실적(상세)	275
【 전문가의 확인 】	299
1. 전문가의 확인	299
2. 전문가와의 이해관계	299

분기보고서

(제 57 기)

사업연도	2025.01.01	부터
	2025.03.31	까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2025년 5월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

전 영 현

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2025년 1분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2025. 5. 15

삼성전자 주식회사

대표이사: 전 영 현



신고업무 담당임원: 박 순 철



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 230개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등을 생산·판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산·판매하고 있습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 32개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이(주)와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매(주), 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스(주), 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍(주) 등으로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 198개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set제품의 미국판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체·디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 48개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 68개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 21개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 29개의 법인이 운영되고 있습니다.

2025년 1분기 당사의 매출은 79조 1,405억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Alphabet, Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Verizon(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

2025년 1분기 매출은 DX 부문이 51조 7,172억원(65.3%), DS 부문이 25조 1,310억원(31.8%)이며, SDC가 5조 8,669억원(7.4%), Harman은 3조 4,194억원(4.3%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
-----	-------	-----	----

DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	517,172	65.3%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	251,310	31.8%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	58,669	7.4%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	34,194	4.3%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△69,940	△8.8%
총 계		791,405	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2025년 1분기 TV의 평균 판매가격은 전년 연간평균 대비 약 6% 하락하였으며, 스마트폰은 전년 연간평균 대비 약 11% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 연간평균 대비 약 1% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 17% 하락하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 연간평균과 유사한 수준입니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기(주) 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인(주), SILTRONIC 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 (주)비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	모바일AP 솔루션	CPU	47,891	22.5%	Qualcomm, MediaTek
	디스플레이 패널	TV·모니터용 화면표시장치	20,729	9.7%	CSOT, AUO 등
	Camera Module	스마트폰 카메라	18,071	8.5%	삼성전기(주),SUNNY 등
	기타	-	126,069	59.3%	
	소 계		212,760	100.0%	
DS 부문	Chemical	원판 가공	6,850	17.3%	솔브레인(주), 동우화인켐(주) 등
	Wafer	반도체 원판	5,180	13.1%	SILTRONIC, SK실트론(주) 등
	기타	-	27,580	69.6%	
	소 계		39,610	100.0%	
SDC	FPCA	구동회로	4,589	17.7%	(주)비에이치,(주)유니온등
	Cover Glass	강화유리	3,339	12.8%	Apple, LENS 등
	기타	-	18,064	69.5%	
	소 계		25,992	100.0%	
Harman	SOC(System-On-Chip)	CPU	2,121	11.8%	NVIDIA, INTEL 등
	통신 모듈	차량 통신	1,258	7.0%	WISTRON NEWEB CORP(WNC) 등
	기타	-	14,610	81.2%	
	소 계		17,989	100.0%	
기타	-	-	69	-	
총 계			296,420	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주)는 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 연간평균대비 약 19% 상승하였고, Camera Module은 약 18% 상승, TV·모니터용 디스플레이 패널은 변동이 없었습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 연간평균 대비 약 2% 하락하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 23% 하락, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 15% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip) 가격은약 1% 하락하였으며, 통신 모듈은 변동이 없었습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래 등을 포함하고 있습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제57기 1분기	제56기	제55기
DX 부문	TV, 모니터 등	13,407	51,795	53,552
	스마트폰 등	66,150	265,700	284,700
DS 부문	메모리	468,475,889	2,238,240,405	1,926,651,546
SDC	디스플레이 패널	575	2,264	2,320
Harman	디지털 콕핏	1,923	8,520	10,912

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처·제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2025년(제57기) 1분기 DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 10,988천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 53,174천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 468,476백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 446천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 1,433천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고 있습니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제57기 1분기	제56기	제55기
DX 부문	TV, 모니터 등	10,988	41,354	40,085
	스마트폰 등	53,174	193,500	189,991
DS 부문	메모리	468,475,889	2,238,240,405	1,926,651,546
SDC	디스플레이 패널	446	1,759	1,407
Harman	디지털 콕핏	1,433	5,814	7,658

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2025년(제57기) 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 82.0%, 스마트폰 등은 80.4%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제57기 1분기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	TV, 모니터 등	13,407	10,988	82.00%
	스마트폰 등	66,150	53,174	80.40%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2025년(제57기) 1분기 가동일은 휴일을 포함하여 총 90일입니다. 가동률은 생산라인 별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제57기 1분기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	21,600	21,600	100.00%
SDC	디스플레이 패널	10,800	10,800	100.00%

Harman의 2025년(제57기) 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 74.5%입니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제57기 1분기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	1,923	1,433	74.50%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 삼성로 114(고덕동)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465(성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158(북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181(명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	7421 King Fahd Road Al Olaya Dist, Riyadh 12212, KSA
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucuri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany

	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands
--	-----------------------------------	--

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2025년 1분기말 현재 장부금액은 207조 3,857억원으로 전년말 대비 1조 4,405억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기 초	기초장부금액	102,482	470,319	909,066	531,173	46,412	2,059,452
	- 취득원가	104,350	824,153	3,732,764	531,173	158,521	5,350,961
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△1,868	△353,834	△2,823,698	-	△112,109	△3,291,509
증 감	일반취득 및 자본적지출	2,620	5,616	43,181	68,633	3,208	123,258
	사업결합을 통한 취득	51	25	2	111	18	207
	감가상각	△124	△11,116	△91,832	-	△4,230	△107,302
	처분·폐기·손상	△55	△1,934	△179	△5	△183	△2,356
	기타	59	313	119	3	104	598
기 말	기말장부금액	105,033	463,223	860,357	599,915	45,329	2,073,857
	- 취득원가	106,949	825,224	3,765,083	599,915	160,008	5,457,179
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△1,916	△362,001	△2,904,726	-	△114,679	△3,383,322

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2025년 1분기 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 12.0조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 메모리 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 추진하였고, 시스템 반도체는 Advanced 노드 CAPA 확보를 위한 투자도 진행 중입니다. 내실을 다지는 활동을 통해 투자 효율성 제고에도 집중할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신·증설, 보완 등	2025.01~2025.03	건물·설비 등	109,480
SDC	신·증설, 보완 등	2025.01~2025.03	건물·설비 등	4,965
기 타	신·증설, 보완 등	2025.01~2025.03	건물·설비 등	5,538
합 계				119,983

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2025년(제57기) 1분기 매출은 79조 1,405억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가하였습니다.

부문별로는 전년 동기 대비 DX 부문이 9.4%, DS 부문이 8.6%, SDC는 8.9%, Harman은 6.8% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제57기 1분기	제56기	제55기
DX 부문	제 · 상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	517,172	1,748,877	1,699,923
DS 부문	제 · 상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	251,310	1,110,660	665,945
SDC	제 · 상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	58,669	291,578	309,754
Harman	제 · 상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	34,194	142,749	143,885
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△69,940	△285,155	△230,152
합 계			791,405	3,008,709	2,589,355

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제57기 1분기	제56기	제55기
TV, 모니터 등	77,563	309,316	303,752
스마트폰 등	361,876	1,144,249	1,086,325
메모리	190,690	844,630	441,254
디스플레이 패널	58,669	291,578	309,754

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제57기 1분기	제56기	제55기
제 · 상품	751,546	2,933,617	2,461,380
용역 및 기타매출	39,859	75,092	127,975
계	791,405	3,008,709	2,589,355

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제57기 1분기	제56기	제55기
내수	국내	60,845	202,978	205,196
수출	미주	175,953	613,533	510,934
	유럽	81,947	290,967	239,342
	아시아 · 아프리카	107,414	333,769	326,262
	중국	129,190	649,275	422,007
계		555,349	2,090,522	1,703,741

※ 별도 기준의 내수 · 수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인 등)	

(2) 해외

판매자	판 매 경 로					소비자
생산법인	판매법인	Retailer				소비자
		Dealer		Retailer		
		Distributor	Dealer		Retailer	
		통신사업자, Automotive OEM				
		직접판매(B2B 및 온라인)				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer		Retailer	
			Distributor	Dealer	Retailer	

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	18%	24%	49%	9%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2025년 1분기 당사의 주요 매출처로는 Alphabet, Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Verizon 등(알파벳순)입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 12% 수준입니다.

바. 수주상황

2025년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2025년 1분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 75,229백만원(전기: 58,830백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 1,111백만원(전기: 2,333백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 중속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제57기 1분기말	제56기말
부 채	109,762,479	112,339,878
자 본	406,614,269	402,192,070
부채비율	27.0%	27.9%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2025년 1분기말 현재 당사는 USD, EUR 등 총 33개 통화에 대하여 3,783건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산·부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	73,891	89,603	223,290	279,912

그리고 당사는 레인보우로보틱스(주) 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 옵션 중 2024년 12월 31일 이사회에서 레인보우로보틱스(주)의 최대주주 등 6인이 보유한 지분 394만주를 인수하는 콜옵션의 행사를 의결하였고, 인수대가는 267,463백만원이며, 2025년 3월 12일에 지분인수 절차를 완료하였습니다. 2025년 1분기말 현재 보유한 콜옵션의 행사 가격은 시가로 콜옵션의 공정가치를 별도로 평가하지 않았습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이(주)가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2025년 1분기말 현재 상기 풋옵션들의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2026.03.31
	목적 및 내용	유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 · 부제소를 통한 사업 자유도 확보
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Nokia	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보

※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2025년(제57기) 1분기 당사의 연구개발비용은 9조 348억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 9조 327억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원, %)

과 목		제57기 1분기	제56기	제55기
연구개발비용 총계		9,034,812	35,021,531	28,352,769
(정부보조금)		△2,071	△23,389	△13,045
연구개발비용 계		9,032,741	34,998,142	28,339,724
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-
	연구개발비(비용)	9,032,741	34,998,142	28,339,724
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100]		11.4%	11.6%	10.9%

※ 연결 누계기준입니다.

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

다. 연구개발 조직 및 운영

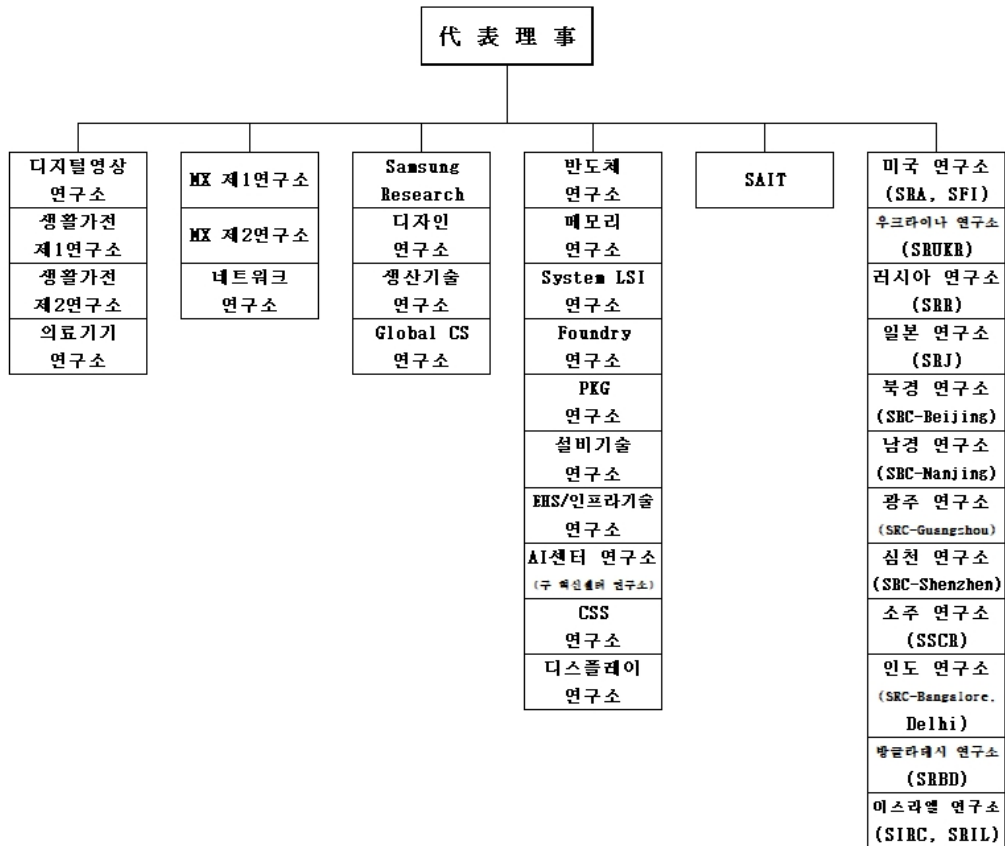
(국내)

당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합 연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.



라. 연구개발실적

2025년 1분기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Galaxy S25	• Galaxy S25 • S25+ • S25 Ultra 출시
	Galaxy A	• Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A06 5G, Galaxy M16 5G 출시
	Galaxy북	• Galaxy Book5 Pro • Pro H, Galaxy Book5 360 출시
	Neo QLED 8K	• 8K Wireless One Connect Box, 8K AI Upscaling Pro, AI HDR Remastering Pro, AI Motion Enhancer Pro, 8K 120Hz 4K 240Hz VRR을 적용한 QN990F 출시
	Neo QLED 4K	• NQ5 SI Gen3 Processor 적용을 통해 강화된 AI 기능을 제공하고, Glare Free, VRR 4K 165Hz을 적용한 QN90F 출시
	OLED TV	• NQ5 SI Gen3 Processor 적용을 통해 강화된 AI 기능을 제공하는 S90/S95F 출시
	냉장고	• 9인치 LCD, Bixby LLM, AI Vision Inside 2.0, Auto Open door 등을 적용한 글로벌 36인치 T-Type FDR 냉장고 출시
	세탁기	• Vent 건조 방식, All-in-one , AI Home, AI Optiwash&Dry, Auto Open Door, Easy Lint Clean 필터 등을 적용한 북미향 27인치 Vent 콤보 출시
DS 부문	그래픽 DRAM	• 업계 최초 24Gb GDDR7 D램 양산
	브랜드 SSD	• PCIe 5.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '9100 PRO' 출시
	LSI	• 업계 최초 하드웨어 PQC(Post Quantum Cryptography) 탑재 IC 개발(S3SSE2A) • 무선 전력 컨소시엄(Wireless Power Consortium)의 Qi 표준을 지원하는 무선충전 IC 개발(S2MIW06)
SDC	OLED	• Galaxy S25 Ultra AMOLED 개발
	QD-Display	• 27인치 UHD 16:9 QD-OLED 모니터 개발

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으로 총 270,618건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2025년 1분기말 현재,연결 기준)]

(단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	63,654	100,655	48,391	29,615	8,768	19,535	270,618

2025년 1분기 중 총 9조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 2,364건, 미국 특허 2,357건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수]

(단위 : 건)

구분	2025년 1분기	2024년	2023년
한국	2,364	7,806	8,908
미국	2,357	9,227	8,958

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로서 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2025년 1분기 중 미국에서 85건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국의 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」
「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」
「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」 제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사의 국내 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO₂-eq, TJ)

구 분	2024년	2023년	2022년
온실가스(tCO ₂ -eq)	17,674,973	17,337,196	19,285,537
에너지(TJ)	320,701	301,616	290,024

- ※ 정부에 신고된 본사 및 자회사 포함 기준입니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 컬러 TV 등장 이후 지금까지, 평면 TV(LCD),스마트 TV, 초대형 TV(OLED/QLED/Neo QLED/8K), 마이크로 LED 등으로 발전하면서 최고 화질을 제공하기 위한 혁신활동들이 지속적으로 일어나는 분야입니다.

TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체제(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 특히 AI기술의 급성장으로 인해 TV 화면에 나오는 상품 관련 정보를 실시간으로 검색하거나 관련된 콘텐츠들을 추천받을 수도 있고, 사용자 취향의 예술 이미지를 만들거나 대화 방식으로 기기를 제어하는 수준으로 발전하고 있습니다.

TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하기 위한 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 75~83인치대가 주도하는 시대를 넘어서 85, 98, 100, 115인치급의 초대형 제품들이 성장을 이끌어갈 것으로 전망됩니다. 이에 따라 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.

TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)를 통해 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알람 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다.

한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. . 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치 편의성, 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동 통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2024년에는 8.7억대로 판매가 확대되었습니다. 이러한 5G의 확산은 AI·XR·자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2025.03).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2024년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 85% 수준, 피쳐폰의 비중은 15% 수준입니다(출처:TechInsights 2025.03). 스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터,멀티카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

TV 시장 수요는 2023년 2억 139만대 수준에서 2024년에는 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대로 전년비 3.7% 성장한 2억 883만대를 기록하였으며, 2025년에는 무역전쟁 등 글로벌 경기 불확실성이 확대되며 2024년과 동등한 수준인 2억 891만대 수준으로 전망됩니다(출처: Omdia 2025.03).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2025년 1분기	2024년	2023년
TV	30.0%	28.3%	30.1%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였으며, 2025년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 경기 회복 기대에 따른 소비심리 상승과 AI 제품·서비스 확대 등으로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 12.2억대 수준으로 성장하였습니다. 2025년에는 글로벌 경제 환경의 불확실성이 커질 것으로 전망되나 AI 스마트폰의 수요 증가로 스마트폰 시장은 소폭 성장한 12.4억대로 전망됩니다. 태블릿 시장은 2023년 1.4억대에서 2024년 1.5억대로 소폭 성장하였으며, 2025년은 2024년과 비슷한 수준을 유지할 전망입니다(출처: TechInsights 2025.03).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2025년 1분기	2024년	2023년
스마트폰	20.4%	18.3%	19.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2024년까지 19년 연속으로 TV 판매 1위를 지키고 있습니다. 이 기간 동안 공격적으로 영업, 마케팅 활동을 전개하여 시장 점유율을 2006년말 14.2%에서 2024년말 약 28%로 두배 수준으로 증대하였습니다. 또한 전세계 소비자와 유통 파트너사들이 원하는 프리미엄 제품과 혁신 제품들을 선제적으로 지속 출시함으로써 TV 트렌드를 선도하는 기업이라는 평판을 쌓아가고 있습니다.

글로벌 TV 시장은 75인치 이상 초대형 TV와 1,500불 이상 프리미엄 TV군이 성장을 주도하고 있으며, 특히 북미와 유럽, 한국, 동남아, 중국 지역에서 판매가 크게 증가하고 있습니다. 하지만 업체들간 경쟁이 점점 더 치열해 지고 있고, 패널가격도 지속적으로 상승하고 있어 수익성 확보에 어려움이 가중되고 있습니다.

당사는 이러한 어려운 경영환경 속에서도 시장점유율을 확대하고 수익성을 제고하기 위해, 2025년에는 AI TV 라인업을 기존 Neo QLED, OLED 에서 QLED와 더 프레임으로 확대하고 초대형 TV, Q시리즈 사운드바 등 다양한 카테고리에서 신제품을 출시하였습니다.

AI TV는 2024년 9개 시리즈 34개 모델에서 2025년 11개 시리즈 58개 모델로 라인업이 크게 늘어나서 소비자 선택의 폭이 넓어졌습니다. 삼성 AI TV는 'AI 홈', 'AI 어시스턴트', 'AI 시청 최적화'의 세 가지 핵심 AI 기능들을 제품에 채용하여 소비자들에게 편리한 스마트홈 사용 경험과 실시간 번역 및 영상정보 검색, AI로 업그레이드된 화질과 사운드를 제공합니다.

2025년형 Neo QLED 8K는 2개 시리즈에서 7개 모델을 출시할 예정이며, Neo QLED 4K는 총 4개 시리즈에서 22개 모델을 선보일 예정입니다. 기존 최대 화면 크기였던 98인치에서 2025년에는 100인치, 115인치 제품을 새롭게 추가하여 초대형 TV 시장 확대를 주도해 나갈 것입니다.

삼성 OLED는 3개 시리즈에서 14개 모델을 출시하여 42인치부터 83인치까지 라인업을 확대할 계획이며, 트리플 레이저 기술로 약 43 cm의 짧은 거리에서도 최대 100인치 대화면을 투사할 수 있는 초단초점 프로젝터 '더 프리미어 5'도 출시할 예정입니다.

11년 연속 글로벌 판매 1위를 기록한 삼성 사운드는 성능이 한층 향상되었습니다. 2025년형 'Q시리즈 사운드바'는 서브우퍼의 크기를 기존 대비 절반 이상 줄이면서도 강력한 저음을 구현하며, 2025년 신규 출시된 '컨버터블 사운드바'는 사운드바에 내장된 자이로 센서가 설치 방향을 감지해 자동으로 사운드를 최적화해 줍니다.

이와 함께, 기존 '더 프레임'에서만 지원되던 '삼성 아트 스토어'가 2025년형 NeoQLED와 QLED제품으로까지 확대되었습니다. 삼성 아트 스토어는 삼성 TV 전용 예술작품 구독 서비스로 약 70개의 글로벌 유명 미술관, 박물관 등과 협력을 통해 3,000개 이상의 세계적인 작품을 제공하여 일상에서 쉽게 예술을 접할 수 있게 합니다.

또한, 2025년형 NeoQLED 8K 제품과 더 프레임 프로 (The Frame Pro)에는 '무선 원 커넥트 박스'가 새롭게 적용되었습니다. '무선원 커넥트 박스'는 무지향성 무선 기술을 적용하여 TV에서 멀리 떨어진 곳에서도 주변기기를 연결하여 끊임없이 시청을 할 수 있습니다. 당사는 최신 기술을 채용한 신제품들을 적기에 출시하여 글로벌 1위위치를 굳건히 지켜 나가겠습니다.

2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 14년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다(출처: TechInsights 2025.3). 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 콘텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 생성형 AI를 적용한 검색·실시간 통번역·자동 내용 요약·사진 편집, Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영·8K 동영상특화 카메라 기능 등 고객이 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 Galaxy Z 폴드로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 Galaxy Z 플립을 출시하였습니다. Galaxy Z 플립 시리즈는 아이코닉한 디자인과 높은 휴대성으로, 여성과 젊은 세대의 Galaxy 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 5세대, 6세대 Galaxy Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 주도해 왔습니다.

한편, 2025년 2월에는 Galaxy S25 시리즈를 출시하였으며, 한층 더 발전한 Galaxy AI를 통해 자연스럽게 개인화된 모바일 경험을 제공하고 있습니다. 통합형 AI 플랫폼인 'One UI 7'이 탑재되어 자연스럽게 직관적인 사용성을 제공하고, 텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 접점에서 사용자의 상황을 이해하고 취향을 분석해 개인화된 AI 경험을 구현하였습니다. 또한 역대 가장 강력한 성능과 함께 AI 기반의 차세대 '프로비주얼 엔진(ProVisual Engine)'을 탑재해 향상된 카메라 경험을 제공하고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 편안한 착용감으로 맞춤형 건강정보를 제공하는 스마트 링, 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Wallet(舊 Samsung Pay), Samsung Health 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔습니다. Samsung Wallet은 결제 외에도 신분증, 티켓 등의 다양한 기능을 제공하여 실물 지갑을 대체할 수 있는 서비스로 발전시켜 나가고 있으며, Samsung Health는 새로운 폼팩터와 AI 기능 적용을 통해 통합 건강관리 플랫폼으로서의 위상을 더욱 강화해 나가고자 합니다

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 특히, Galaxy S25 시리즈에는 금, 구리 등 8종의 재활용 소재를 사용하였고, 더 나아가 구형 갤럭시 단말의 폐배터리에서 직접 코발트를 추출하여 재사용하는배터리 순환 재활용 체계를 적용하였습니다.

추가로, 당사는 2023년 5월 자가 수리 프로그램을 도입하고 대상 모델과 국가를 확대해 나가며 e-waste를 최소화하고 있습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공할 것입니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지 센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM(Integrated DeviceManufacturer)업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 Foundry 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2025년 1분기 메모리 시장은 주요 데이터센터 및 테크 기업들의 AI향 투자가 지속되며 견조한 서버향 DRAM 수요가 유지되었으나, 서버 SSD는 일부 데이터센터 고객사 과제가 순연되면서 상대적으로 수요 약세를 보였습니다. PC, 모바일향 수요 회복세는 기존 전망 대비 개선되었습니다. 주요 국가들의 관세 정책 변동이 지속되어 이와 관련한 직간접적 영향을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 최근 가격 상승세를 보이고 있는 PC, 모바일 시장에서는 수익성 관점에서 시장수요에 유연하게 대응할 예정입니다.

2025년 Foundry 시장은 산업 전반에 걸친 AI Agent 서비스 확대 및 Robotics 등 신산업 육성에 따라 Advanced 노드 중심 성장이 예상되나, 미국의 대규모 관세 정책 등 글로벌 반도체 공급망에 대한 불확실성 요인이 상존하고 있습니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2025년 1분기	2024년	2023년
DRAM	35.8%	41.5%	42.2%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였으며, 2025년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

메모리 사업의 2분기는 상호관세 유예에 따른 선행 구매 수요가 관측되고 있습니다. 서버는 AI향 견조한 수요와 가격 저점 인식 영향으로 수요가 증가할 것으로 예상되며, PC, 모바일 수요 또한 중국 내수 수요가 진작되며 고객사의 재고 정상화 속도가 기존 예상 대비 빨라져 수요 모멘텀이 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 수익성 위주로 사업을 지속적으로 운영하고 있으며, DRAM은 HBM3E 개선 제품의 초기 수요 대응을 확대하고, 서버향 고용량 제품 중심의 Product Mix 운영 기조로 고부가가치 시장에서 입지를 강화할 계획입니다. 또한, NAND는 전용용에서 V8 전환을 가속화하여 원가 경쟁력을 개선하고, 탄력적 Product Mix 운영을 통해 수요 회복세가 보이는 응용 시장 위주로 대응하여 공급할 예정입니다.

System LSI는 2025년 거시 경제 불확실성 확대 영향 등으로 수요 감소가 예상되나, 고부가 제품 수주 확대와 고객 및 응용처 다변화로 극복할 계획입니다. SOC 사업은 Galaxy S24/FE와 A시리즈(A55) 스마트폰 및 Google향 수요가 강세를 보이고 있으며, 이미지 센서는 강화된 광각 및 줌기능 소구점으로 2억 화소시장을 주도하고, 차량용 센서 시장에서도 고화소 신제품 수주를 확대하고 있습니다. DDI는 OLED 모바일 향 시장에서 선도적 위치를 강화하고 LCD TV향 시장에서 대형 고객을 신규 확보하였습니다. 또한, Power는 Server향 신제품 통해 사업을 다각화하고 있으며, Security는 컨슈머 기기 보안 강화로 사업 기회를 확대하고 있습니다.

Foundry는 시장 변화에 맞추어 노드 및 응용별 전략을 수립하여 기술/개발, 제조, 비즈니스 역량 부분의 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. Advanced 노드는 4나노 공정에서 안정적인 수율을 기반으로 모바일 및 HPC 수요를 확대하고 있으며, 특히 상반기에는 3나노, 하반기에는 2나노 모바일용 제품을 양산하여 신규로 출하할 예정으로, 성공적인 양산을 통해 주요 고객으로부터 수요 확보를 추진하고 있습니다. Mature 노드는 RF 및 Automotive 등 Specialty 공정에 대한 투자 및 개발로 응용처 확대 및 사업 다변화를 지속하여 수익성 개선과 노드 장기 활용이 동시에 이뤄질 수 있는 전략을 마련하고 있습니다. 지속적인 고객 협력 및 개발/수주/생산/공급 등 전방위 경쟁력을 강화함으로써 변화하는 시장에 맞춰 사업 기회를 확대해 나가겠습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수 나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2025년에도 2024년 15.5억대로 비슷한 수준일 것으로 전망됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이의 경우 2024년 7.8억대에서 2025년 8.5억대로 증가할 전망이며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 2024년 50.7%에서 2025년 54.5%로 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2025.4).

또한, 대형 디스플레이 패널 시장은 2024년 8.7억대에서 2025년 9.1억대로 성장할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2025.4).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2025년 1분기	2024년	2023년
스마트폰 패널	39.5%	41.0%	50.1%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 자료(금액기준)를 활용하였으며,
2025년 1분기 시장점유율은 Omdia의 예측치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, AUTO 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2025년에는 글로벌 불확실성의 심화 등으로 전체 스마트폰 시장은 정체될 것으로 예상되나, AI의 확대 및 고성능 디스플레이에 대한 수요의 증가로 OLED 침투율은 지속하여 증가할 것으로 전망됩니다. 패널 업체간 경쟁이 심화되는 가운데 당사는 저소비전력, 디자인 차별화 라인업 확대 등 제품 경쟁력을 강화하여 경쟁우위를 유지해 나가겠습니다.

또한, 신규 8.6G IT OLED라인을 양산 일정에 맞춰 차질없이 준비하여 확대되는 IT OLED 시장을 선점하고 판매를 확대해 나갈 계획입니다. IT 외에도 Auto, Gaming 등으로 제품 포트폴리오를 확장하여 사업 리더십을 더욱 견고히 하겠습니다.

대형 디스플레이 시장의 경우, TV와 모니터 프리미엄 시장에서 자발광 디스플레이 비중이 지속 증가하고 있습니다. 당사는 QD 디스플레이 관련 기술 역량 강화하여 고성능 제품 판매를 확대하고 생산효율 향상 등 내실을 다져서 사업 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다. 이 중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈에 맞추어 자동차도 IT 제품처럼 SW로 업그레이드 가능한 SDV(Software Defined Vehicle)로 변화하고 있어 자동차 제조사들은 중앙집중형 전장 아키텍처 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 혁신을 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 이에, Harman은 자동차의 SDV로 변화에 대응할 수 있는 SW 기술역량을 강화하고, In-Cabin Experience의 핵심 전장부품과 고성장이 예상되는 AR HUD, 디스플레이, 운전자 모니터링 등 신제품을 육성하는 한편 전자의 SW/서비스 역량을 차량에 접목하여 보다 편리하고 차별화된 사용자 경험을 제공하는데 주력할 계획입니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술 적용 및 AI 탑재가 확산되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 기술 변화에 의해, IT 업체들이 소비자 오디오 시장에 참여하여 음향 설계 기술을 보유한 전통 오디오 업체들과 경쟁 중입니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Home 오디오 및 게이밍 헤드폰 분야에서 고성장이 예상되고, 소비자들은 프리미엄 오디오를 경험(고음질/무손실 음원 등)하고자 하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이에 Harman은 고성장 분야에 사업역량과 경쟁력을 강화하고 신제품을 지속 출시하여 시장에 대응하고 있으며, 프리미엄 오디오 경험을 추구하는 소비자의 Needs에 부합하기 위해 고음질/무손실 음원 재생기술을 보유한 미국업체 Roon Labs LLC를 2023년 4분기에 인수하여 고품질의 오디오 경험을 소비자들에게 제공하고 있습니다. 향후 타사업부 제품에도 Roon 기술을 적용하여 제품을 차별화하고 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

(국내외 시장여건 등)

2025년 1분기 자동차 생산량은 북미와 유럽에서 약세를 보였고, 중국은 강세였으나 전세계 기준으로 전년 대비 소폭 감소했습니다 (출처 S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2025. 3). 향후 미국 주도로 새로운 글로벌 무역 정책과 관련된 관세 부과로 인해 물가 상승 압력이 다시 가속화될 가능성이 있습니다. 2025년 4월 기준으로 관세 부과의 부정적인 영향, 정책 불확실성에 따른 OEM 고객의 보수적인 시장 접근 등으로 인해 2025년 자동차 수요는 감소될 것으로 예상됩니다.

2025년 1분기 디지털 콕핏 매출은 감소하였는데, 이는 수명 주기가 말기인 일부 거래선 수주과제에서 매출이 급감하고 최근 생산을 개시한 과제가 당초 계획보다 일정이 지연된 것이 주요 원인으로, 이에 따라 시장 점유율은 감소하였습니다.

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2025년 1분기	2024년	2023년
디지털 콕핏	12.3%	12.5%	16.5%

- ※ 디지털 콕핏은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
- ※ 시장점유율은 외부조사기관인 Techinsights의 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2025년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

Harman은 독자 보유한 음향 설계능력과 다양한 소비자층을 겨냥한 멀티 브랜드 전략을 구사하여 일반 소비자와 음악 애호가들 사이에서 오디오 전문 업체로서 브랜드 인지도 및 영향력을 확대해 왔습니다. 향후 타 사업부와의 협력을 강화하고 새로운 제품을 출시하여 오디오 산업내에서의 위상과 입지를 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2025년(제57기) 1분기 매출은 DX 부문이 51조 7,172억원(65.3%), DS 부문이 25조 1,310억원(31.8%)이며, SDC가 5조 8,669억원(7.4%), Harman은 3조 4,194억원(4.3%)입니다.

2025년(제57기) 1분기 영업이익은 DX 부문이 4조 7,219억원, DS 부문이 1조 1,055억원, SDC가 4,622억원, 그리고 Harman은 3,069억원입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제57기 1분기		제56기		제55기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	517,172	65.3%	1,748,877	58.1%	1,699,923	65.7%
	영업이익	47,219	70.6%	124,399	38.0%	143,847	219.0%
	총자산	2,699,449	37.5%	2,596,713	36.2%	2,342,534	37.2%
DS 부문	매출액	251,310	31.8%	1,110,660	36.9%	665,945	25.7%
	영업이익	11,055	16.5%	150,945	46.1%	△148,795	△226.6%
	총자산	3,366,314	46.7%	3,430,454	47.8%	2,871,411	45.6%
SDC	매출액	58,669	7.4%	291,578	9.7%	309,754	12.0%
	영업이익	4,622	6.9%	37,334	11.4%	55,665	84.8%
	총자산	803,744	11.2%	821,980	11.4%	792,752	12.6%
Harman	매출액	34,194	4.3%	142,749	4.7%	143,885	5.6%
	영업이익	3,069	4.6%	13,076	4.0%	11,737	17.9%
	총자산	212,233	2.9%	209,347	2.9%	179,566	2.9%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품·모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품·모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제57기	제56기	제55기
	2025년 3월말	2024년 12월말	2023년 12월말
[유동자산]	222,685,717	227,062,266	195,936,557
· 현금및현금성자산	53,161,004	53,705,579	69,080,893
· 단기금융상품	51,943,037	58,909,334	22,690,924
· 기타유동금융자산	29,521	36,877	635,393
· 매출채권	44,866,585	43,623,073	36,647,393
· 재고자산	53,220,267	51,754,865	51,625,874
· 기타	19,465,303	19,032,538	15,256,080
[비유동자산]	293,691,031	287,469,682	259,969,423
· 기타비유동금융자산	11,518,647	11,756,681	8,912,691
· 관계기업 및 공동기업 투자	12,600,953	12,592,117	11,767,444
· 유형자산	207,385,768	205,945,209	187,256,262
· 무형자산	26,695,086	23,738,566	22,741,862
· 기타	35,490,577	33,437,109	29,291,164
자산총계	516,376,748	514,531,948	455,905,980
[유동부채]	90,279,712	93,326,299	75,719,452
[비유동부채]	19,482,767	19,013,579	16,508,663
부채총계	109,762,479	112,339,878	92,228,115
[지배기업 소유주지분]	395,861,094	391,687,603	353,233,775
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	373,062,171	370,513,188	346,652,238
· 기타	17,497,516	15,873,008	1,280,130
[비지배지분]	10,753,175	10,504,467	10,444,090
자본총계	406,614,269	402,192,070	363,677,865
	2025년 1월~3월	2024년 1월~12월	2023년 1월~12월
매출액	79,140,503	300,870,903	258,935,494
영업이익	6,685,272	32,725,961	6,566,976
연결총당순이익	8,222,878	34,451,351	15,487,100
· 지배기업 소유주지분	8,028,407	33,621,363	14,473,401
· 비지배지분	194,471	829,988	1,013,699
기본주당순이익(단위 : 원)	1,192	4,950	2,131
희석주당순이익(단위 : 원)	1,192	4,950	2,131
연결에 포함된 회사수	231개	229개	233개

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

기본주당이익(보통주) 산출근거는 제55기~제56기 연결감사보고서 및 제57기 분기 연결검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제57기	제56기	제55기
	2025년 3월 말	2024년 12월 말	2023년 12월 말
[유동자산]	75,606,503	82,320,322	68,548,442
· 현금및현금성자산	3,288,472	1,653,766	6,061,451
· 단기금융상품	1,414,698	10,187,991	50,071
· 매출채권	34,181,288	33,840,357	27,363,016
· 재고자산	29,610,322	29,154,115	29,338,151
· 기타	7,111,723	7,484,093	5,735,753
[비유동자산]	246,931,494	242,645,805	228,308,847
· 기타비유동금융자산	2,502,109	2,176,346	1,854,504
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	58,701,899	57,427,196	57,392,438
· 유형자산	152,497,152	151,446,870	140,579,161
· 무형자산	11,113,176	10,496,956	10,440,211
· 기타	22,117,158	21,098,437	18,042,533
자산총계	322,537,997	324,966,127	296,857,289
[유동부채]	75,949,386	80,157,976	41,775,101
[비유동부채]	8,732,874	8,411,494	30,294,414
부채총계	84,682,260	88,569,470	72,069,515
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	234,618,166	233,734,316	219,963,351
[기타]	△2,063,836	△2,639,066	△476,984
자본총계	237,855,737	236,396,657	224,787,774
종속 · 관계 · 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2025년 1월~3월	2024년 1월~12월	2023년 1월~12월
매출액	55,534,871	209,052,241	170,374,090
영업이익(손실)	1,469,273	12,361,034	△11,526,297
당기순이익	6,387,197	23,582,565	25,397,099
기본주당순이익(단위 : 원)	948	3,472	3,739
희석주당순이익(단위 : 원)	948	3,472	3,739

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제55기~제56기 감사보고서 및 제57기 분기 검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 57 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 56 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기말	제 56 기말
자산		
유동자산	222,685,717	227,062,266
현금및현금성자산 (주3,25)	53,161,004	53,705,579
단기금융상품 (주3,25)	51,943,037	58,909,334
단기당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	29,521	36,877
매출채권 (주3,25)	44,866,585	43,623,073
미수금 (주3,25)	9,141,453	9,622,974
선급비용	3,553,132	3,362,824
재고자산 (주5)	53,220,267	51,754,865
기타유동자산 (주3,25)	6,770,718	6,046,740
비유동자산	293,691,031	287,469,682
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	10,288,577	10,580,932
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	1,230,070	1,175,749
관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	12,600,953	12,592,117
유형자산 (주7)	207,385,768	205,945,209
무형자산 (주8)	26,695,086	23,738,566
순확정급여자산 (주11)	2,742,083	3,089,571
이연법인세자산	16,821,230	14,236,468
기타비유동자산 (주3,25)	15,927,264	16,111,070
자산총계	516,376,748	514,531,948
부채		
유동부채	90,279,712	93,326,299
매입채무 (주3,25)	14,496,195	12,370,177
단기차입금 (주3,9,25)	5,333,859	13,172,504
미지급금 (주3,25)	20,753,988	18,547,365
선수금 (주14)	1,857,522	1,841,420
예수금 (주3,25)	1,075,205	991,812
미지급비용 (주3,14,25)	28,182,718	29,613,258
당기법인세부채	6,281,482	4,340,171
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	2,035,992	2,207,290
총당부채 (주12)	8,357,439	8,216,469

기타유동부채 (주3,14,25)	1,905,312	2,025,833
비유동부채	19,482,767	19,013,579
사채 (주3,10,25)	14,518	14,530
장기차입금 (주3,9,25)	3,759,579	3,935,860
장기미지급금 (주3,25)	5,609,891	5,510,455
순확정급여부채 (주11)	528,203	521,410
이연법인세부채	535,948	528,231
장기충당부채 (주12)	2,917,989	3,120,044
기타비유동부채 (주3,14,25)	6,116,639	5,383,049
부채총계	109,762,479	112,339,878
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	395,861,094	391,687,603
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	373,062,171	370,513,188
기타자본항목 (주17)	17,497,516	15,873,008
비지배지분	10,753,175	10,504,467
자본총계	406,614,269	402,192,070
부채와자본총계	516,376,748	514,531,948

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기		제 56 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주26)	79,140,503	79,140,503	71,915,601	71,915,601
매출원가 (주18)	51,009,931	51,009,931	45,886,332	45,886,332
매출총이익	28,130,572	28,130,572	26,029,269	26,029,269
판매비와관리비 (주18,19)	21,445,300	21,445,300	19,423,260	19,423,260
영업이익 (주26)	6,685,272	6,685,272	6,606,009	6,606,009
기타수익 (주20)	1,106,305	1,106,305	445,281	445,281
기타비용 (주20)	241,413	241,413	381,393	381,393
지분법이익 (주6)	118,853	118,853	214,833	214,833
금융수익 (주21)	3,970,884	3,970,884	3,484,504	3,484,504

금융비용 (주21)	2,488,325	2,488,325	2,662,511	2,662,511
법인세비용차감전순이익	9,151,576	9,151,576	7,706,723	7,706,723
법인세비용 (주22)	928,698	928,698	952,015	952,015
분기순이익	8,222,878	8,222,878	6,754,708	6,754,708
분기순이익의 귀속				
분기순이익	8,028,407	8,028,407	6,621,030	6,621,030
비지배지분	194,471	194,471	133,678	133,678
주당이익 (주23)				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,192	1,192	975	975
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,192	1,192	975	975

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기		제 56 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	8,222,878	8,222,878	6,754,708	6,754,708
기타포괄손익	1,213,038	1,213,038	4,994,952	4,994,952
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(79,946)	(79,946)	416,418	416,418
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	(73,550)	(73,550)	511,479	511,479
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주 17)	25,384	25,384	(12,818)	(12,818)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(31,780)	(31,780)	(82,243)	(82,243)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,292,984	1,292,984	4,578,534	4,578,534
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주 17)	30,483	30,483	52,627	52,627
해외사업장환산외환차이 (주17)	1,265,204	1,265,204	4,514,980	4,514,980
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	(2,703)	(2,703)	10,927	10,927
총포괄손익	9,435,916	9,435,916	11,749,660	11,749,660
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	9,312,323	9,312,323	11,534,271	11,534,271
비지배지분	123,593	123,593	215,389	215,389

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

자본			
----	--	--	--

	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계		
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130	353,233,775	10,444,090	363,677,865
분기순이익	0	0	6,621,030	0	6,621,030	133,678	6,754,708
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	27,563	435,213	462,776	48,703	511,479
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	48,594	48,594	(8,785)	39,809
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	4,473,803	4,473,803	41,177	4,514,980
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(82,859)	(82,859)	616	(82,243)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	10,927	10,927	0	10,927
배당 (주16)	0	0	(2,452,977)	0	(2,452,977)	(1,026,368)	(3,479,345)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(15)	(15)
연결실체의 변동							
자기주식의 취득 (주15)							
자기주식 소각 (주15)							
주식기준보상 (주17)							
기타	0	0	0	0	0	(32,041)	(32,041)
2024.03.31 (분기말자본)	897,514	4,403,893	350,847,854	6,165,808	362,315,069	9,601,055	371,916,124
2025.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	370,513,188	15,873,008	391,687,603	10,504,467	402,192,070
분기순이익	0	0	8,028,407	0	8,028,407	194,471	8,222,878
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	23,923	(59,586)	(35,663)	(37,887)	(73,550)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	56,242	56,242	(375)	55,867
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	1,297,814	1,297,814	(32,610)	1,265,204
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(31,774)	(31,774)	(6)	(31,780)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	(2,703)	(2,703)	0	(2,703)
배당 (주16)	0	0	(2,454,307)	0	(2,454,307)	(79,267)	(2,533,574)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	379	379
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	204,003	204,003

자기주식의 취득 (주15)	0	0	0	(2,955,851)	(2,955,851)	0	(2,955,851)
자기주식 소각 (주15)	0	0	(3,049,040)	3,049,040	0	0	0
주식기준보상 (주17)	0	0	0	271,326	271,326	0	271,326
기타							
2025.03.31 (분기말자본)	897,514	4,403,893	373,062,171	17,497,516	395,861,094	10,753,175	406,614,269

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기	제 56 기 1분기
영업활동현금흐름	16,580,866	11,866,306
영업에서 창출된 현금흐름	16,540,788	12,106,438
분기순이익	8,222,878	6,754,708
조정 (주24)	11,957,684	8,747,019
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(3,639,774)	(3,395,289)
이자의 수취	1,579,942	1,098,569
이자의 지급	(112,541)	(164,248)
배당금 수입	4,523	35,935
법인세 납부액	(1,431,846)	(1,210,388)
투자활동현금흐름	(6,431,187)	(22,010,751)
단기금융상품의 순감소(증가)	7,129,878	(12,174,719)
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	0	620,858
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	7,357	(1,020)
장기금융상품의 처분	470,135	4,100,008
장기금융상품의 취득	(601,024)	(129,053)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	203,065	53,306
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(13,281)	(24,070)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	8,053	92,282
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(10,362)	(5,924)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	2,081	11,731
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(13,965)	(6,342)
유형자산의 처분	31,361	14,964
유형자산의 취득	(12,127,934)	(13,421,626)
무형자산의 처분	10,228	340
무형자산의 취득	(1,257,544)	(1,143,551)
사업결합으로 인한 순현금유출액	(214,033)	0

매각예정분류자산의 처분으로 인한 현금유입액	0	101,563
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(55,202)	(99,498)
재무활동현금흐름	(11,341,720)	1,261,662
단기차입금의 순증가(감소)	(7,856,026)	2,451,071
장기차입금의 차입	1,559	118,450
사채 및 장기차입금의 상환	(452,816)	(295,008)
배당금의 지급	(78,965)	(1,012,836)
자기주식의 취득	(2,955,851)	0
비지배지분의 증감	379	(15)
외화환산으로 인한 현금의 변동	647,466	1,707,987
현금및현금성자산의 증가(감소)	(544,575)	(7,174,796)
기초현금및현금성자산	53,705,579	69,080,893
분기말의 현금및현금성자산	53,161,004	61,906,097

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 230개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 34개 관계기업과 공동기업을 지분법적용 대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0

	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0
	RAINBOW ROBOTICS USA Co., Ltd.	로봇 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
미주	Samsung Electronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매,	100.0

		R&D	
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	전자제품 판매	100.0

	(SENA)		
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDK)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0
지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad	오디오제품 판매	100.0

	Limitada		
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0

	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle East and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	100.0

	(STIN)		
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0

	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 · FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
국내	삼성디스플레이(주)	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3

삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
㈜레인보우로보틱스	로봇·로봇 부품 생산, 판매	35.0
SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 67호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당분기말		당분기	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	67,062,224	6,303,491	4,997,613	1,771,889
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	53,150,556	20,596,279	10,745,329	519,723
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	35,504,644	412,264	-	4,257,369
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	28,701,583	17,035,728	1,260,276	250,728
Harman과 그 종속기업(*2)	21,223,257	6,547,406	3,407,203	221,856

Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	19,139,290	925,610	2,244,357	277,424
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	17,460,865	9,116,302	11,173,398	104,920
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	15,498,974	14,568,895	779,838	63,170
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	11,604,082	3,882,055	10,752,874	385,556
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	10,723,614	3,733,208	5,353,288	658,633
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,359,768	3,411,402	–	87,139
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	6,561,447	2,220,029	6,342,126	312,936
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	6,529,903	1,752,276	3,691,019	120,519
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	5,197,422	1,002,686	2,031,256	146,968
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,182,653	1,780,157	2,063,974	(14,555)
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	4,987,398	4,887,425	5,492,290	92,472
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,302,442	2,225,094	1,803,028	142,973
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,869,544	2,507,004	4,726,561	129,718
Samsung International, Inc. (SII)	2,548,950	647,557	1,785,204	67,005
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,532,153	1,236,784	1,181,423	109,090
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,425,444	2,300,704	1,858,894	51,045
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,387,013	869,059	1,460,599	107,395
세메스(주)	2,348,438	650,136	535,021	39,860
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,130,456	861,664	905,081	53,279
Samsung Japan Corporation (SJC)	1,941,768	1,637,520	732,564	3,043

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전분기	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성디스플레이(주)	67,541,382	8,305,660	4,416,769	1,988,742
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	50,777,503	18,653,435	10,802,156	320,694
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	31,226,978	353,722	–	4,268,036
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	27,546,958	16,107,374	1,047,393	137,751

Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	21,719,875	13,462,128	6,886,736	71,338
Harman과 그 종속기업(*2)	20,934,732	6,714,174	3,188,425	181,434
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	18,796,411	900,205	3,062,668	278,116
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	16,111,528	15,246,946	824,353	56,727
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	13,497,264	3,802,597	11,035,651	955,233
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	9,561,708	3,226,735	4,473,966	485,100
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,093,393	3,452,430	-	74,334
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	7,819,080	2,167,121	5,682,381	404,813
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,724,664	1,955,376	3,580,221	167,858
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	6,467,878	5,635,634	7,245,188	112,888
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,863,158	807,341	1,685,609	55,077
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,679,383	1,486,272	2,127,073	151,276
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,267,763	2,042,914	1,662,705	44,582
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,637,138	502,266	1,246,205	30,487
Samsung International, Inc. (SII)	2,484,711	646,678	1,657,803	144,799
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,411,145	1,642,510	1,493,143	52,453
세메스(주)	2,365,712	705,818	576,056	36,966
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,118,638	2,049,463	1,803,932	24,164
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,017,910	845,480	1,093,900	40,778
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,928,760	1,710,124	4,310,686	465,913
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1,894,968	726,412	847,508	70,004

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	국내	(주)레인보우로보틱스	지분취득
	미주	RAINBOW ROBOTICS USA Co., Ltd.	지분취득

2. 중요한 회계처리방침 (연결)

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2025년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

동 개정사항은 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해, 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같으며 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 지침을 명확히 하고 추가
- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
- 기타포괄-공정가치금융자산(지분상품)에 대한 추가 공시

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		165,538,456	10,288,577	1,368,688	22,507	177,218,228
금융자산 합계	현금및현금성자산	53,161,004	0	0	0	53,161,004
	단기금융상품	51,943,037	0	0	0	51,943,037
	단기당기손익-공정가치금융자산	0	0	29,521	0	29,521
	매출채권	44,866,585	0	0	0	44,866,585
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	10,288,577	0	0	10,288,577
	당기손익-공정가치 금융자산	0	0	1,230,070	0	1,230,070
	기타금융자산	15,567,830	0	109,097	22,507	15,699,434

전기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		170,616,210	10,580,932	1,689,020	44,262	182,930,424
금융자산 합계	현금및현금성자산	53,705,579	0	0	0	53,705,579
	단기금융상품	58,909,334	0	0	0	58,909,334
	단기당기손익-공정가치금융자산	0	0	36,877	0	36,877
	매출채권	43,623,073	0	0	0	43,623,073
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	10,580,932	0	0	10,580,932
	당기손익-공정가치 금융자산	0	0	1,175,749	0	1,175,749
	기타금융자산	14,378,224	0	476,394	44,262	14,898,880

당기 및 전기 기타금융자산에 대한 각주

기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
금융부채 합계		53,838,337	47,052	9,900,382	63,785,771
금융부채 합계	매입채무	14,496,195	0	0	14,496,195
	단기차입금	315,140	0	5,018,719	5,333,859
	미지급금	19,337,259	0	0	19,337,259
	유동성장기부채	950,219	0	1,085,773	2,035,992
	사채	14,518	0	0	14,518
	장기차입금	6,240	0	3,753,339	3,759,579
	장기미지급금	4,881,844	0	0	4,881,844
	기타금융부채	13,836,922	47,052	42,551	13,926,525

전기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
금융부채 합계		49,704,553	36,795	17,922,059	67,663,407
금융부채 합계	매입채무	12,370,177	0	0	12,370,177
	단기차입금	338,058	0	12,834,446	13,172,504
	미지급금	17,390,861	0	0	17,390,861
	유동성장기부채	1,106,764	0	1,100,526	2,207,290
	사채	14,530	0	0	14,530
	장기차입금	6,537	0	3,929,323	3,935,860
	장기미지급금	4,779,141	0	0	4,779,141
	기타금융부채	13,698,485	36,795	57,764	13,793,044

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	10,288,577

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	10,580,932

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
	지분상품
금융자산	691,940
	567,651

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
	지분상품
금융자산	668,252
	544,374

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시, 합계

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품 및 지분상품
금융자산	1,259,591

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품 및 지분상품
금융자산	1,212,626

공정가치금융자산 중 상당주식 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	측정 단계																
	취득원가									공정가치							
	금융자산, 분류									금융자산, 분류							
	공정가치로 측정하는 금융자산									공정가치로 측정하는 금융자산							
	상당주식									상당주식							
	합계									합계							
	상상중공임(주)	(주)호철산리	(주)아이마켓코	(주)원익홀딩스	(주)원익아이피	Wacom Co., Ltd.	Coming Incorporated	기타		상상중공임(주)	(주)호철산리	(주)아이마켓코	(주)원익홀딩스	(주)원익아이피	Wacom Co., Ltd.	Coming Incorporated	기타
금융자산	932,158	13,957	324	30,821	32,429	62,013	3,532,814	559,923	5,164,438	1,806,688	77,182	5,017	13,317	89,585	47,163	4,766,682	628,340
																	7,633,974

측정 전제																			
특목평가										공정가치									
금융자산, 분류								금융자산, 분류	금융자산, 분류								금융자산, 분류		
공정가치로 측정하는 금융자산									공정가치로 측정하는 금융자산										
상장주식									상장주식										
합계									합계										
삼성중공업(주)		(주)호텔신라		(주)아이마켓코리아		(주)원익홀딩스		(주)원익아이피에스		Wacom Co., Ltd.		Corning Incorporated		기타		합계			
금융자산																			

공정가치금융자산 중 상장주식의 보유주식수 및 지분율에 대한 공시

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류							
공정가치로 측정하는 금융자산							
상장주식							
	삼성중공업(주)	(주)호텔신라	(주)아이마켓코리아	(주)원익홀딩스	(주)원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated
보유주식수(주)	134,027,281	2,004,717	647,320	3,518,342	3,701,872	8,398,400	71,000,000
보유지분율	0.152	0.051	0.019	0.046	0.075	0.058	0.083
지분율에 대한 설명	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가총당금	장부금액 합계
재고자산		58,592,860	(5,372,593)	53,220,267
재고자산	제품 및 상품	15,444,441	(1,471,107)	13,973,334
	반제품 및 재공품	25,947,244	(2,606,999)	23,340,245
	원재료 및 저장품	15,739,355	(1,294,487)	14,444,868
	미착품	1,461,820	0	1,461,820

전기말

(단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가총당금	장부금액 합계
재고자산		56,737,864	(4,982,999)	51,754,865
재고자산	제품 및 상품	15,061,526	(1,219,250)	13,842,276
	반제품 및 재공품	24,808,183	(2,467,701)	22,340,482
	원재료 및 저장품	15,442,327	(1,296,048)	14,146,279
	미착품	1,425,828	0	1,425,828

6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	12,592,117	11,767,444
취득	13,965	6,342
처분	(2,081)	(11,731)
이익 중 지분해당액	118,853	214,833
기타(*)	(121,901)	(69,115)
분기말	12,600,953	11,907,773

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스 (주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공 급	50.0	한국	12월

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액
삼성전기(주)	359,237	2,063,898	2,077,700	359,237	2,058,412	2,067,669
삼성에스디에스(주)	147,963	2,111,858	2,124,500	147,963	2,108,195	2,120,417
삼성바이오로직스(주)	1,424,358	3,521,141	3,525,700	1,424,358	3,403,947	3,406,062
삼성SDI(주)	1,242,605	3,947,348	2,869,667	1,242,605	3,979,333	2,923,991
(주)제일기획	506,162	396,572	696,822	506,162	418,029	718,561
기타	627,624	867,722	1,073,515	674,721	844,623	1,131,648

계	4,307,949	12,908,539	12,367,904	4,355,046	12,812,539	12,368,348
---	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	144,142	144,122	215,000	143,198	143,178
기타	259,994	81,001	88,927	259,994	74,075	80,591
계	474,994	225,143	233,049	474,994	217,273	223,769

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기 및 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	2,067,669	35,865	6,014	(31,848)	2,077,700
삼성에스디에스(주)	2,120,417	48,193	6,559	(50,669)	2,124,500
삼성바이오로직스(주)	3,406,062	119,692	(54)	-	3,525,700
삼성SDI(주)	2,923,991	(75,215)	34,354	(13,463)	2,869,667
(주)제일기획	718,561	8,117	5,861	(35,717)	696,822
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	143,178	945	-	(1)	144,122
기타	1,212,239	(18,744)	3,133	(34,186)	1,162,442
계	12,592,117	118,853	55,867	(165,884)	12,600,953

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,841,393	45,620	19,518	(20,346)	1,886,185
삼성에스디에스(주)	1,966,206	48,113	14,407	(47,175)	1,981,551
삼성바이오로직스(주)	3,073,595	56,544	(836)	-	3,129,303
삼성SDI(주)	2,912,564	34,211	17,833	(13,463)	2,951,145
(주)제일기획	669,363	12,260	6,287	(32,232)	655,678
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	138,938	(710)	-	-	138,228
기타	1,165,385	18,795	(17,400)	(1,097)	1,165,683

계	11,767,444	214,833	39,809	(114,313)	11,907,773
---	------------	---------	--------	-----------	------------

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당분기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	6,466,794	9,235,224	5,263,229	9,734,509	2,494,743
비유동자산	6,825,737	4,111,373	12,173,748	30,975,557	631,130
유동부채	3,558,754	2,648,330	3,619,094	10,095,550	1,397,279
비유동부채	685,885	980,234	2,537,775	9,077,569	329,411
비지배지분	235,307	368,696	-	1,929,432	16,024
요약 포괄손익계산서:					
매출	2,738,649	3,489,764	1,298,273	3,176,818	1,039,417
계속영업손익(*)	134,179	211,496	375,554	(226,169)	28,327
세후중단영업손익(*)	(448)	-	-	5,621	-
기타포괄손익(*)	25,820	28,037	(121)	128,613	21,408
총포괄손익(*)	159,551	239,533	375,433	(91,935)	49,735
II. 배당					
배당	31,848	50,669	-	13,463	35,717

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):					
유동자산	5,891,746	9,003,787	5,518,118	10,334,313	2,754,194
비유동자산	6,900,656	4,234,543	11,818,179	30,263,032	568,459
유동부채	3,056,861	2,495,409	3,853,188	10,855,694	1,594,190
비유동부채	719,688	1,037,472	2,578,432	8,174,413	251,659
비지배지분	226,693	372,330	-	1,800,842	18,806
요약 포괄손익계산서(전분기):					
매출	2,624,289	3,247,268	946,903	5,130,893	1,018,010
계속영업손익(*)	183,479	210,895	179,362	273,134	42,727
세후중단영업손익(*)	(373)	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	83,481	63,780	383	179,519	21,886
총포괄손익(*)	266,587	274,675	179,745	452,653	64,613
II. 배당(전분기)					
배당	20,347	47,175	-	13,463	32,232

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당분기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	125,063	120,786
비유동자산	199,770	199,017
유동부채	36,390	33,294
비유동부채	159	113
요약 포괄손익계산서(*):		
매출	44,582	35,370
계속영업손익	1,887	(1,420)
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	1,887	(1,420)
II. 배당		
배당	-	-

(*) 분기 3개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	(19,460)	716	18,101	694
기타포괄손익	(1,668)	4,801	(17,824)	424
총포괄손익	(21,128)	5,517	277	1,118

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기 업 명	당분기말		전기말
	주식수(주)	시장가치	시장가치
삼성전기(주)	17,693,084	2,284,177	2,190,404
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,030,259	2,232,936
삼성바이오로직스(주)	22,217,309	22,528,351	21,084,226
삼성SDI(주)	13,462,673	2,537,714	3,332,012
㈜제일기획	29,038,075	523,266	492,195

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일에 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법

원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였으나, 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 2차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2024년 8월 14일 증권선물위원회가 부과한 행정처분을 취소한다고 판결하였으나, 증권선물위원회는 2024년 8월 28일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송이 진행 중입니다.

또한, 삼성바이오로직스(주)는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행 정지 결정에 대하여 즉시 항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고 하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년부터 2022년까지 보고기간의 지분법손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	205,945,209
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	12,325,806
사업결합을 통한 취득, 유형자산	20,727
감가상각비, 유형자산	(10,730,215)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(235,629)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	59,870
분기말 유형자산	207,385,768

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	187,256,262
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	11,773,595
사업결합을 통한 취득, 유형자산	0
감가상각비, 유형자산	(9,231,310)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(130,748)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	1,487,761
분기말 유형자산	191,155,560

기타 변동에 대한 각주, 유형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	9,423,481	1,306,734	10,730,215

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	8,197,276	1,034,034	9,231,310

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	5,493,539

전기말

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	5,660,885

사용권자산의 추가와 감가상각비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	327,506
사용권자산감가상각비	(314,199)

전분기

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	464,894
사용권자산감가상각비	(292,806)

8. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초의 무형자산 및 영업권	23,738,566
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	1,297,818
사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	2,263,546
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(788,575)

무형자산의 처분, 폐기 및 손상	(6,572)
기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권	190,303
기말 무형자산 및 영업권	26,695,086

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초의 무형자산 및 영업권	22,741,862
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	844,734
사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	0
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(719,482)
무형자산의 처분, 폐기 및 손상	(9,522)
기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권	389,011
기말 무형자산 및 영업권	23,246,603

기타 변동에 대한 각주, 무형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	539,485	249,090	788,575

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	484,976	234,506	719,482

9. 차입금 (연결)

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

차입금명칭													차입금명칭 합계
장보부차입금													
무담보차입금													
거래상대방													
우리은행 등													
씨티은행 등													
우리은행 등													
씨티은행 등													
법위			법위 합계	법위			법위 합계	법위			법위 합계		
하위법위	상위법위	하위법위		상위법위	하위법위	상위법위		하위법위	상위법위				
연이자율	0.007	0.142							0.000	0.477			
단기차입금			5,027,298								306,561	5,333,859	
차입금에 대한 기술			장보부차입금과 관련하여 매 매출채권을 담보로 제공하였습니다.										

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금명칭												차입금명칭 합계
	장보부차입금						무담보차입금						
	거래상대방												
	우리은행 등			씨티은행 등			우리은행 등			씨티은행 등			
	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	
	상위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		상위법위			
연이자율													
단기차입금			12,834,446								338,058	13,172,504	

차입금에 대한 기술			상보부차입금과 관련하여 에 매출회계로 담보로 제공하였습니다.									
------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭												차입금명칭 합계
	은행차입금												
	거래상대방												
	BNP 등			CSSD 등			BNP 등			CSSD 등			
	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	
	하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		
연이자율	0.035	0.529										0.050	
유동성장기차입금			356,063									1,085,773	1,441,836

전기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭												차입금명칭 합계
	은행차입금												
	거래상대방												
	BNP 등			CSSD 등			BNP 등			CSSD 등			
	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	
	하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		
연이자율													
유동성장기차입금			510,756								1,100,526	1,611,282	

장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭												차입금명칭 합계
	은행차입금										리스 부채		
	거래상대방												
	BNP 등			CSSD 등			BNP 등			CSSD 등			
	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	
	하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		
연이자율	0.0000	0.0740									0.0500		
장기차입금			6,240								3,753,339	3,759,579	

전기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭													차입금명칭 합계
은행차입금										리스 부채			
거래상대방													
BNP 등			CSSD 등			BNP 등			CSSD 등				
법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계	법위		법위 합계		
하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위		하위법위	상위법위			
연이자율													
장기차입금			6,537								3,929,323	3,935,860	

리스부채 이자비용에 대한 공시
당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	61,077
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율 이며 당분기 중 발생한 이자비용은 61,077백만원 입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	53,023
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 전분기 중 발생한 이자비용은 53,023백만원입니다.

10. 사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액	21,998	586,600	608,598
명목금액, 기초통화금액 (USD) [USD, 천]	15,000	400,000	415,000
사채할인발행차금			(220)
사채할증발행차금			296
사채			608,674
차감: 유동성사채			(594,156)
비유동성사채			14,518
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일			
만기상환일			
연이자율			
명목금액	22,050	588,000	610,050
명목금액, 기초통화금액 (USD) [USD, 천]	15,000	400,000	415,000
사채할인발행차금			(255)
사채할증발행차금			743
사채			610,538

차감: 유동성사채			(596,008)
비유동성사채			14,530
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

11. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금 적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	17,248,585	342,995	17,591,580
사외적립자산의 공정가치			(19,805,460)
순확정급여부채(자산) 계			(2,213,880)

전기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금 적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	16,965,629	379,155	17,344,784
사외적립자산의 공정가치			(19,912,945)
순확정급여부채(자산) 계			(2,568,161)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			384,254
순이자비용(수익), 확정급여제도			(33,032)
과거근무원가, 확정급여제도			(97)
기타 비용, 확정급여제도			9,178
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	146,587	213,716	360,303

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			354,156
순이자비용(수익), 확정급여제도			(64,618)
과거근무원가, 확정급여제도			(163)
기타 비용, 확정급여제도			4,534
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	117,751	176,158	293,909

12. 총당부채 (연결)

총당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	총당부채 합계
기초	2,734,501	2,793,901	813,011	4,995,100	11,336,513
순전입(환입)	396,865	207,314	86,369	96,088	786,636
사용	(468,532)	(181,153)	(68,766)	(152,083)	(870,534)
기타	41,856	(17,606)	577	(2,014)	22,813
기말	2,704,690	2,802,456	831,191	4,937,091	11,275,428
총당부채의 성격에 대한 기술	연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.	연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.	연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	

기타 변동에 대한 기술, 기타총당부채

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	2025년(당기 이행연도)
무상할당 배출권(단위: 만톤(tCO ₂ -eq))	1,629
배출량 추정치(단위: 만톤(tCO ₂ -eq))	1,966

배출권 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

배출부채 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	174
순전입(환입)	43
사용	0
기말	217

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	137
순전입(환입)	35
사용	0
기말	172

13. 우발부채와 약정사항 (연결)

법적소송우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	당분기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다.
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	약정의 유형
	매입약정
	발생하지 않은 유무형자산의 취득
약정 금액	12,408,427
약정에 대한 설명	당분기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 12,408,427백만원입니다.

14. 계약부채 (연결)

계약부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	14,413,443

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,523,368

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000

주당 액면가액(원)			100
발행주식 액면 총액(백만원)	591,964	81,597	673,561
납입자본금(백만원)			897,514
자본금에 대한 설명			발행주식의 액면총액은 673,561백만원(보통주 591,964백만원, 우선주 81,597백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.
각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다.

주식에 대한 공시

당분기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,940,082,550	818,836,700
자기주식 취득주식수(주)	(47,444,628)	(6,587,036)
기말 유통주식수(주)	5,892,637,922	812,249,664
소각주식 수를 제외한 발행주식수	5,919,637,922	815,974,664
유통주식수에 대한 기술	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주의 수(소각 주식수 제외)는 5,919,637,922주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다.	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 815,974,664주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다.

전기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700

자기주식 취득주식수(주)	(29,700,000)	(4,050,000)
기말 유통주식수(주)	5,940,082,550	818,836,700
소각주식 수를 제외한 발행주식 수		
유통주식수에 대한 기술		

주식 소각에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
소각한 주식 수	50,144,628	6,912,036	
소각한 주식의 취득원가			3,049,040
주식 소각 이사회 결의일			2025-02-18

16. 연결이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		373,062,171
이익잉여금	임의적립금 등	238,196,358
	연결미처분이익잉여금	134,865,813

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		370,513,188
이익잉여금	임의적립금 등	224,424,501
	연결미처분이익잉여금	146,088,687

배당금에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분		
	분기배당		
	1분기		
	주식		주식 합계
	보통주	우선주	
배당기준일			2025-03-31
배당받을 주식(주)	5,892,637,922	812,249,664	
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)	3.65		

우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.65	
지급될 배당금	2,150,813	296,471	2,447,284

전분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분		
	분기배당		
	1분기		
	주식		주식 합계
	보통주	우선주	
배당기준일			2024-03-31
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)	3.61		
우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.61	
지급될 배당금	2,155,092	297,062	2,452,154

17. 기타자본항목 (연결)

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		17,497,516
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	2,095,729
	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	480,817
	해외사업장환산외환차이	19,912,774
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(3,628,717)
	자기주식	(1,718,586)
	주식기준보상	271,326
	기타	84,173

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		15,873,008
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	2,155,315
	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	424,575

	해외사업장환산외환차이	18,614,960
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,596,943)
	자기주식	(1,811,775)
	주식기준보상	0
	기타	86,876

자기주식에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 자기주식수(주)	27,000,000	3,725,000
자기주식	1,541,799	176,787

전기말

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 자기주식수(주)	29,700,000	4,050,000
자기주식	1,625,252	186,523

주식기준보상약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	주식결제 성과인센티브	임직원 주식보상
주식기준보상약정에 대한 기술	연결회사는 임원을 대상으로 성과인센티브 중 일부를 2026년 1월에 양도제한주식(RSA)으로 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 주식결제가 확정된 인센티브 63,912백만원(보통주 1,176,383주)을 '미지급비용'에서 '기타자본항목'으로 대체하였습니다.	연결회사는 노사협의 결과에 따라 2025년 3월 5일 현재 재직중인 임직원 전원에게 보통주 30주를 부여하기로 약정하였으며, 이에 따라 지급예정인 보통주 3,841,035주의 약정일 현재 공정가치 207,414백만원을 '급여' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당기 중 지급완료할 예정입니다.
주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술	주식결제	주식결제
주식기준보상약정의 부여일	2026년 1월	2025년 03월 05일
주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량	1,176,383	3,841,035

주식결제가 확정된 인센티브 금액	63,912	
약정일 현재 공정가치		207,414

18. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
성격별 비용		72,455,231
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	(1,130,821)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	28,353,466
	급여	8,906,310
	퇴직급여	422,769
	감가상각비	10,730,215
	무형자산상각비	788,575
	복리후생비	1,838,492
	유틸리티비	2,228,202
	외주용역비	2,114,605
	광고선전비	1,542,416
	판매촉진비	2,143,596
	기타 비용	14,517,406

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
성격별 비용		65,309,592
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	(399,265)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,298,463
	급여	8,075,000
	퇴직급여	347,810
	감가상각비	9,231,310
	무형자산상각비	719,482
	복리후생비	1,724,478
	유틸리티비	2,023,182
	외주용역비	1,770,506
	광고선전비	1,434,926
	판매촉진비	1,837,394
	기타 비용	14,246,306

성격별 비용에 대한 기술

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			21,445,300
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		12,412,559
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	2,253,204
		퇴직급여	102,207
		지급수수료	2,406,926
		감가상각비	435,267
		무형자산상각비	185,280
		광고선전비	1,542,416
		판매촉진비	2,143,596
		운반비	640,743
		서비스비	998,393
		기타판매비와관리비	1,704,527
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		9,032,741

전분기

(단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			19,423,260
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		11,603,220
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	2,179,210
		퇴직급여	77,591
		지급수수료	2,083,504
		감가상각비	412,997
		무형자산상각비	175,047
		광고선전비	1,434,926
		판매촉진비	1,837,394
		운반비	714,535
		서비스비	1,241,559
		기타판매비와관리비	1,446,457
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		7,820,040

20. 기타수익 및 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
--	--	------

기타수익		1,106,305
기타수익	배당금수익	35,117
	임대료수익	38,178
	유형자산처분이익	6,819
	기타	1,026,191
기타비용		241,413
기타비용	유형자산처분손실	10,748
	기부금	43,970
	기타	186,695

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		445,281
기타수익	배당금수익	39,457
	임대료수익	38,914
	유형자산처분이익	9,335
	기타	357,575
기타비용		381,393
기타비용	유형자산처분손실	26,048
	기부금	77,476
	기타	277,869

21. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

				공시금액	
금융수익 합계				3,970,884	
금융수익 합계	이자수익(금융수익)			1,239,349	
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익		1,239,294	
		당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이 자수익		55	
	외환차이			1,900,438	
	파생상품관련이익			831,097	
금융비용 합계				2,488,325	
금융비용 합계	이자비용(금융원가)			176,087	
	이자비용(금융원가)	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용		23,889	
		기타 금융부채 이자비용		152,198	

	외환차이	2,033,440
	파생상품관련손실	278,798

전분기

(단위 : 백만원)

				공시금액
금융수익 합계				3,484,504
금융수익 합계	이자수익(금융수익)			1,172,185
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익		1,172,152
		당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이 자수익		33
	외환차이			2,120,929
	파생상품관련이익			191,390
금융비용 합계				2,662,511
금융비용 합계	이자비용(금융원가)			242,772
	이자비용(금융원가)	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용		66,927
		기타 금융부채 이자비용		175,845
	외환차이			2,240,061
	파생상품관련손실			179,678

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다

.

22. 법인세비용 (연결)

평균유효세율과 적용세율간의 조정

	공시금액
법인세비용 인식에 대한 기술	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저 한세를 고려하여 추정된 최선의 가중평균연간법 인세율로 인식하였습니다.
2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.101

23. 주당이익 (연결)

주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

		보통주	우선주
기본주당이익			
기본주당이익	지배회사지분 분기순이익	7,056,091	972,316
	가중평균유통보통주식수(주)	5,920,293,406	
	가중평균유통우선주식수(주)		815,925,797
	기본주당이익(단위 : 원)	1,192	1,192
희석주당순이익			
희석주당순이익	희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,056,228	
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		972,179
	조정된 가중평균유통보통주식수(주)	5,921,137,636	
	조정된 가중평균유통우선주식수(주)		815,925,797
	희석주당이익(단위 : 원)	1,192	1,192

전분기

(단위 : 백만원)

		보통주	우선주
기본주당이익			
기본주당이익	지배회사지분 분기순이익	5,818,936	802,094
	가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	
	가중평균유통우선주식수(주)		822,886,700
	기본주당이익(단위 : 원)	975	975
희석주당순이익			
희석주당순이익	희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,818,936	
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		802,094
	조정된 가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	
	조정된 가중평균유통우선주식수(주)		822,886,700
	희석주당이익(단위 : 원)	975	975

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

당분기 가중평균 희석성 잠재적보통주는 845천주(주식보상 관련)가 포함되어 있으며, 전분기는 없습니다.

24. 현금흐름표 (연결)

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다.

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		11,957,684
조정내역 계	법인세비용 조정	928,698
	금융수익	(2,808,437)
	금융비용	1,620,482
	퇴직급여	422,769
	감가상각비	10,730,215
	무형자산상각비	788,575
	대손상각비(환입)	38,333
	배당금수익	(35,117)
	지분법이익	(118,853)
	유형자산처분이익	(6,819)
	유형자산처분손실	10,748
	재고자산평가손실환입	
	재고자산평가손실	870,898
	기타	(483,808)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(3,639,774)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	536,031
	미수금의 감소(증가)	929,088
	장단기선급비용의 감소(증가)	28,519
	재고자산의 감소(증가)	(2,101,170)
	매입채무의 증가(감소)	808,190
	장단기미지급금의 증가(감소)	(1,244,493)
	선수금의 증가(감소)	(103,338)
	예수금의 증가(감소)	62,649
	미지급비용의 증가(감소)	(1,572,697)
	장단기충당부채의 증가(감소)	(83,898)
	퇴직금의 지급	(407,198)
	기타	(491,457)

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		8,747,019

조정내역 계	법인세비용 조정	952,015
	금융수익	(2,077,714)
	금융비용	1,520,022
	퇴직급여	347,810
	감가상각비	9,231,310
	무형자산상각비	719,482
	대손상각비(환입)	(31,709)
	배당금수익	(39,457)
	지분법이익	(214,833)
	유형자산처분이익	(9,335)
	유형자산처분손실	26,048
	재고자산평가손실환입	(1,648,575)
	재고자산평가손실	
	기타	(28,045)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(3,395,289)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(3,609,636)
	미수금의 감소(증가)	(223,276)
	장단기선급비용의 감소(증가)	36,117
	재고자산의 감소(증가)	627,518
	매입채무의 증가(감소)	446,091
	장단기미지급금의 증가(감소)	479,925
	선수금의 증가(감소)	171,189
	예수금의 증가(감소)	13,584
	미지급비용의 증가(감소)	(1,229,733)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,149,499
	퇴직금의 지급	(289,829)
	기타	(966,738)

리스부채와 관련한 현금유출액에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	328,831
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	61,077

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	286,357
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	53,023

25-1. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

위험				위험 합계	
시장위험			신용위험		
	환위험	이자율위험		지분가격위험	
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동 위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.	이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.	유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 연결회사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다.

<p>위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술</p>	<p>연결회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 연결회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 전략적 목적으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 자본상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.</p>	<p>고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비용 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 연결회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 시스템으로 개별 회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간중요일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.</p>	<p>연결회사는 영업활동에서 파생되는 시장 위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성 자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.</p>
---------------------------------	--	---	--	---	--	--

보고기간 말 현재 노출된 주가변동의 각 유형별 민감도 분석

당분기

(단위 : 백만원)

	위험
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향 및 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 당기손익 증가	1,111
시장변수 하락 시 당기손익 감소	1,111
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	75,229
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	75,229

전분기

(단위 : 백만원)

	위험
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향 및 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 당기손익 증가	2,333
시장변수 하락 시 당기손익 감소	2,333
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	58,830
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	58,830

부채비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부채	109,762,479
자본	406,614,269
부채비율	0.270

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.
--------------------------------------	--

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부채	112,339,878
자본	402,192,070
부채비율	0.279
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

25-2. 공정가치측정 (연결)

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	당기손익인식금융자산	매출채권	공정가치평가를 기타 포괄손익으로 인식하는 금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
금융자산	53,161,004	51,943,037	1,259,591	44,866,585	10,288,577	15,699,434	177,218,228
금융자산, 공정가치			1,259,591		10,288,577	131,604	
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융자산 15,567,830백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	당기손익인식금융자산	매출채권	공정가치평가를 기타 포괄손익으로 인식하는 금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
금융자산	53,705,579	58,909,334	1,212,626	43,623,073	10,580,932	14,898,880	182,930,424
금융자산, 공정가치			1,212,626		10,580,932	520,656	

공정가치 공시대상에서 제외된 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융자산 14,378,224백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

금융부채의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	14,496,195	5,333,859	24,219,103	5,201,415	608,674	13,926,525	63,785,771
금융부채, 공정가치					610,425	89,603	
공정가치 공시대상에서 제외된 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융부채 13,836,922백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	12,370,177	13,172,504	22,170,002	5,547,142	610,538	13,793,044	67,663,407
금융부채, 공정가치					610,437	94,559	
공정가치 공시대상에서 제외된 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융부채 13,698,485백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	측정 단계											
	공정가치											
	자산											
	당기손익-공정가치측정 금융자산				공정가치평가용 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
자산	111,076	29,521	1,118,994	1,259,591	7,522,899	0	2,765,678	10,288,577	0	85,683	45,921	131,604

전기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체											
	공정가치											
	자산											
	당기손익-공정가치측정 금융자산				공정가치평가로 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	
자산	86,187	36,877	1,089,562	1,212,626	7,686,545	0	2,894,387	10,580,932	0	98,159	422,497	520,656

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	부채							
	사채				기타금융부채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	
부채	0	610,425	0	610,425	0	89,603	0	89,603

전기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	부채							
	사채				기타금융부채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	
부채	0	610,437	0	610,437	0	94,559	0	94,559

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	수준 1	수준 2	수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름할인법, 이항모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	측정 전체				
	공정가치				
	자산				
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산
	삼성벤처투자(주)	(주)미코세라믹스	TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	지분 풋옵션
	공정가치 서열체계의 모든 수준				
	공정가치 서열체계 수준 3				
자산	36,299	57,088	1,404,219	291,612	45,921
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	현금흐름할인법	현금흐름할인법 등	현금흐름할인법	현금흐름할인법	이항모형
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	영구성장률, 가중평균 자본비용	영구성장률, 가중평균 자본비용	영구성장률, 가중평균 자본비용	영구성장률, 가중평균 자본비용	무위험 이자율, 가격 변동성

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시, 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

	측정 전체							
	공정가치							
	자산							
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산							
	삼성벤처투자(주)	(주)미코세라믹스	TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)		China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)			
	평가방법							
	현금흐름할인법							
	관측할 수 없는 투입변수							
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.010	0.154	0.000	0.112	0.000	0.093	0.000	0.093

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시, 기타 금융자산

	측정 전체			
	공정가치			
	자산			
	기타금융자산			
	지분 풋옵션			
	평가방법			
	이항모형			
	관측할 수 없는 투입변수			
	무위험 이자율, 측정 투입변수		가격 변동성, 측정 투입변수	
	범위			
	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.038	0.050	0.297	0.341

수준 3에 해당하는 금융상품의 변동 내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	공정가치로 측정하는 금융자산

기초	4,406,446
매입	22,264
매도	(13,200)
당기손익으로 인식된 손익	607,370
기타포괄손익으로 인식된 손익	(133,702)
기타	(958,585)
기말	3,930,593

전분기

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	3,730,134
매입	29,994
매도	(6,092)
당기손익으로 인식된 손익	48,572
기타포괄손익으로 인식된 손익	16,585
기타	108,619
기말	3,927,812

금융상품의 민감도분석 방법에 대한 기술

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	자산							
	기타포괄손익-공정가치금융자산				기타			
	관측할 수 없는 투입변수			관측할 수 없는 투입변수 수 합계	관측할 수 없는 투입변수			관측할 수 없는 투입변수 수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	가격 변동성		영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	가격 변동성	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01					0.05	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01					0.05	

기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산				175,478				0
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산				(114,331)				0
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산				0				6,307
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산				0				(6,900)

26. 부문별 보고 (연결)

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문 사이의 거래에 대한 회계처리 방법에 대한 기술

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정
 이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않
 아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계					기업 전체 총계 합계
	영업부문				내부거래 조정 등	
	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman		
매출액	51,717,211	25,131,006	5,866,922	3,419,373	(6,994,009)	79,140,503
감가상각비	660,081	9,319,918	611,061	86,667	0	10,730,215
무형자산상각비	417,157	203,173	57,992	52,588	0	788,575
영업이익	4,721,900	1,105,503	462,227	306,858	0	6,685,272
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계					기업 전체 총계 합계
	영업부문				내부거래 조정 등	
	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman		
매출액	47,292,742	23,137,290	5,386,418	3,200,250	(7,101,099)	71,915,601
감가상각비	639,747	7,849,063	607,414	85,397	0	9,231,310
무형자산상각비	402,536	152,446	56,385	53,252	0	719,482
영업이익	4,074,891	1,914,015	340,684	240,839	0	6,606,009
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시 하지 않았습니다.

제품과 용역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
매출액	7,756,345	36,187,621	19,069,038	5,866,922	79,140,503
주요 제품별 매출액에 대한 기술					기타는 별도로 표시하 지 않습니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
매출액	7,233,971	32,791,373	17,494,267	5,386,418	71,915,601
주요 제품별 매출액에 대한 기술					기타는 별도로 표시하 지 않습니다.

지역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

		지역				지역 합계
		외국			연결실체 내 내부거	
본사 소재지 국가						

		미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	래조정	
순매출액	11,230,212	30,219,541	14,038,794	14,651,074	9,000,882	0	79,140,503
비유동자산	178,871,360	29,115,426	7,048,257	9,923,075	9,421,681	(298,945)	234,080,854
비유동자산에 대한 기술							금융상품, 이연법인 세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	지역						지역 합계
	본사 소재지 국가	외국				연결실체 내 내부거	
		미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	래조정	
순매출액	9,413,447	25,388,843	13,219,027	12,679,313	11,214,971	0	71,915,601
비유동자산	166,034,578	22,724,212	6,421,842	9,071,180	11,840,825	(1,690,474)	214,402,163
비유동자산에 대한 기술							금융상품, 이연법인 세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래 (연결)

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자									
	특수관계자									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스(주)	삼성전기(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획	기타 관계기업 및 공동 기업	삼성물산(주)	기타 그 밖의 특수관계 자	삼성이앤에이(주)	(주)에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
매출 등, 특수관계자거 래	58,947	38,231	34,745	36,506	357,386	2,024	176,810	1,012	4,922	62,119
비유동자산 처분, 특수 관계자거래	61	0	0	0	124	0	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거 래	532,755	313,853	158,089	203,587	3,262,240	47,280	376,612	1,247	129,487	66,353
비유동자산 매입, 특수 관계자거래	75,855	0	10,874	989	28,483	1,079,932	614,858	588,002	9,984	244,313
특수관계의 성격에 대 한 기술								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거 래에 관한 법률」에 따 른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거 래에 관한 법률」에 따 른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거 래에 관한 법률」에 따 른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자									
	특수관계자									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스(주)	삼성전기(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획	기타 관계기업 및 공동 기업	삼성물산(주)	기타 그 밖의 특수관계 자	삼성이앤에이(주)	(주)에스원	기타 대규모기업집단 소속회사

매출 등, 특수관계자거래	63,908	27,477	36,837	33,003	312,544	7,997	158,632	147	1,868	59,727
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거래	473,033	347,141	179,184	232,204	3,062,248	53,210	373,416	15,656	129,073	81,136
비유동자산 매입, 특수관계자거래	58,026	0	8,556	6,375	35,974	1,588,496	1,314,075	467,250	5,461	291,111
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

특수관계자거래에 대한 공시, 합계

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	525,815	178,834	68,053
비유동자산 처분, 특수관계자거래	185	0	0
매입 등, 특수관계자거래	4,470,524	423,892	197,087
비유동자산 매입, 특수관계자거래	116,201	1,694,790	842,299
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	473,768	166,629	61,742

비유동자산 처분, 특수 관계자거래	122	0	0
매입 등, 특수관계자거 래	4,293,810	426,626	225,865
비유동자산 매입, 특수 관계자거래	108,931	2,902,571	763,822
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동 일한 대규모기업집단 소 속회사입니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자										
특수관계자										
관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자			대규모기업집단		
	삼성에스디에스(주)	삼성전기(주)	삼성SDI(주)	(주)재일기획	기타 관계기업 및 공동 기업	삼성물산(주)	기타 그 밖의 특수관계 자	삼성이앤에이(주)	(주)에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거 래	9,669	3,478	118,671	191	315,172	204,455	25,478	1,100	3,698	13,609
채무 등, 특수관계자거 래	619,762	154,762	85,540	309,894	1,228,652	1,333,916	814,796	1,685,522	55,377	616,753
특수관계자거래의 채 권,채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대 한 기술								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거 래에 관한 법률」에 따 른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거 래에 관한 법률」에 따 른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범 위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거 래에 관한 법률」에 따 른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자										
특수관계자										
관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자			대규모기업집단		
	삼성에스디에스(주)	삼성전기(주)	삼성SDI(주)	(주)재일기획	기타 관계기업 및 공동 기업	삼성물산(주)	기타 그 밖의 특수관계 자	삼성이앤에이(주)	(주)에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거 래	23,493	5,704	123,940	206	311,560	205,420	19,784	513	2,660	16,848
채무 등, 특수관계자거 래	617,140	113,971	50,278	436,315	1,380,625	1,868,959	743,167	1,919,798	66,988	626,382
특수관계자거래의 채 권,채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계
당분기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	447,181	229,933	18,407
채무 등, 특수관계자거래	2,398,610	2,148,712	2,357,652
특수관계자거래의 채권, 채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	464,903	225,204	20,021
채무 등, 특수관계자거래	2,598,329	2,612,126	2,613,168
특수관계자거래의 채권, 채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술		기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.
-----------------	--	--

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	관계기업 및 공동기업
현금출자, 출자금 납입	13,965
현금출자, 출자금 회수	2,081

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	관계기업 및 공동기업
현금출자, 출자금 납입	6,342
현금출자, 출자금 회수	11,731

특수관계자 기타 거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자 거래	400,702	32,235
리스 이용 계약, 특수관계자거래	18,606	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	9,732	

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단

지급결의한 배당금, 특수관계자 거래	412,172	32,058
리스 이용 계약, 특수관계자거래	16,048	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	7,385	

배당과 관련한 미지급금에 대한 공시, 특수관계자거래

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	종속기업, 관계기업 및 공동기업 과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
배당과 관련한 미지급금, 특수관계자거래	400,702	32,235

주요 경영진(등기임원)에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	2,550
퇴직급여	600
기타 장기급여	1,799

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	3,017
퇴직급여	175
기타 장기급여	2,289

28. 사업결합 (연결)

사업결합에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

			사업결합
--	--	--	------

피취득자에 대한 명칭		레인보우로보틱스(주)	
취득한 의결권이 있는 지분율		0.203	
취득일		2024-12-31	
사업결합의 주된 이유에 대한 기술		당사가 보유한 AI 및 소프트웨어기술과 레인보우로보틱스(주)의 로봇기술을 접목하여 첨단 미래 로봇개발을 신속하고 체계적으로 준비해나갈 예정입니다.	
피취득자에 대한 취득자의 지배력 획득 방법에 대한 기술		당사는 2024년 12월 31일 이사회 결의를 통해 레인보우로보틱스(주)의 최대주주로부터 394만주(20.3%)의 지분을 취득하는 콜옵션 행사를 결의하였으며, 2025년 3월 12일에 지분인수 절차를 완료하였습니다. 당사는 지분인수 후 주주간 약정에 따라 레인보우로보틱스(주)의 이사진 선임권한을 보유함에 따라 지분법대상 관계기업에서 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다.	
총 이전대가의 취득일의 공정가치			
총 이전대가의 취득일의 공정가치	총이전대가, 취득일의 공정가치		2,142,230
	총이전대가, 취득일의 공정가치	이전된 현금	267,463
		파생상품	974,287
		취득자의 지분	900,480
	금융상품이나 지분의 공정가치 결정 방법에 대한 설명금융상품이나 지분의 공정가치 측정 방법에 대한 기술		당사의 기존 보유지분 285만주와 행사한 콜옵션 394만주를 지분인수일 현재의 공정가치로 평가함에 따라 발생하는 차이 847,696백만원과 600,606백만원은 손익계산서상 각각 기타수익과 금융수익으로 인식하였습니다.
	기타수익		847,696
	금융수익		600,606

취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액			
취득 자산과 인수 부채 의 주요 종류별로 취득 일 현재 인식한 금액	취득한 식별가능한 순자산		313,851
	취득한 식별가능한 순자 산	취득일 현재 인식한 현 금및현금성자산	53,429
		취득일 현재 인식한 단 기금융상품	18,789
		취득일 현재 인식한 매 출채권 및 기타채권	7,161
		취득일 현재 인식한 재 고자산	9,342
		취득일 현재 인식한 당 기손익-공정가치금융자 산	18,833
		취득일 현재 인식한 유 형자산	20,727
		취득일 현재 인식한 식 별가능한 무형자산	231,164
		취득일 현재 인식한 기 타자산	7,117
		취득일 현재 인식한 유 동부채	3,422
		취득일 현재 인식한 비 유동부채	49,289
		취득일에 인식한 피취득자에 대한 비지배지분	
취득일에 인식한 영업권			2,032,382

29. 보고기간 후 사건 (연결)

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

	자산의 주요 구입
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술	종속회사 Harman International Industries, Inc.는 2025년 5월 7일 Masimo Corporation의 소비자 오디오 사업부문의 인수계약을 체결하였으며, 인수절차는 2025년 중 완료할 예정입니다.
Masimo Corporation의 소비자 오디오 사업부문의 인수계약체결일	2025-05-07

4. 재무제표

4-1. 재무상태표 재무상태표

제 57 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 56 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기말	제 56 기말
자산		
유동자산	75,606,503	82,320,322
현금및현금성자산 (주3,25)	3,288,472	1,653,766
단기금융상품 (주3,25)	1,414,698	10,187,991
매출채권 (주3,25)	34,181,288	33,840,357
미수금 (주3,25)	2,147,779	3,249,731
선급비용	1,358,155	1,381,781
재고자산 (주5)	29,610,322	29,154,115
기타유동자산 (주3,25)	3,605,789	2,852,581
비유동자산	246,931,494	242,645,805
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	2,502,109	2,176,346
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	58,701,899	57,427,196
유형자산 (주7)	152,497,152	151,446,870
무형자산 (주8)	11,113,176	10,496,956
순확정급여자산 (주11)	1,959,074	2,249,792
이연법인세자산	16,065,939	14,333,432
기타비유동자산 (주3,25)	4,092,145	4,515,213
자산총계	322,537,997	324,966,127
부채		
유동부채	75,949,386	80,157,976
매입채무 (주3,25)	13,039,247	10,287,967
단기차입금 (주3,9,25)	4,067,920	11,110,972
미지급금 (주3,25)	18,209,684	18,591,524
선수금 (주14)	364,347	350,448
예수금 (주3,25)	567,870	516,454
미지급비용 (주3,14,25)	7,981,367	9,039,886
당기법인세부채	2,703,278	1,380,469
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	22,266,315	22,264,226
총당부채 (주12)	6,459,102	6,257,389
기타유동부채 (주14)	290,256	358,641
비유동부채	8,732,874	8,411,494
사채 (주3,10,25)	14,518	14,530
장기차입금 (주3,9,25)	729,334	795,703
장기미지급금 (주3,25)	5,083,698	4,965,481
장기총당부채 (주12)	2,353,514	2,602,575

기타비유동부채	551,810	33,205
부채총계	84,682,260	88,569,470
자본		
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	234,618,166	233,734,316
기타자본항목 (주17)	(2,063,836)	(2,639,066)
자본총계	237,855,737	236,396,657
부채와자본총계	322,537,997	324,966,127

4-2. 손익계산서 손익계산서

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기		제 56 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주26)	55,534,871	55,534,871	51,239,617	51,239,617
매출원가 (주18)	42,458,675	42,458,675	38,772,850	38,772,850
매출총이익	13,076,196	13,076,196	12,466,767	12,466,767
판매비와관리비 (주18,19)	11,606,923	11,606,923	10,459,387	10,459,387
영업이익 (주26)	1,469,273	1,469,273	2,007,380	2,007,380
기타수익 (주20)	4,419,250	4,419,250	8,249,118	8,249,118
기타비용 (주20)	48,027	48,027	271,087	271,087
금융수익 (주21)	1,830,799	1,830,799	1,440,265	1,440,265
금융비용 (주21)	1,279,709	1,279,709	1,440,379	1,440,379
법인세비용차감전순이익	6,391,586	6,391,586	9,985,297	9,985,297
법인세비용 (주22)	4,389	4,389	247,860	247,860
분기순이익	6,387,197	6,387,197	9,737,437	9,737,437
주당이익 (주23)				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	948	948	1,434	1,434
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	948	948	1,434	1,434

4-3. 포괄손익계산서 포괄손익계산서

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기		제 56 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	6,387,197	6,387,197	9,737,437	9,737,437
기타포괄손익	210,715	210,715	67,219	67,219
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	210,715	210,715	67,219	67,219
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	239,762	239,762	143,659	143,659
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(29,047)	(29,047)	(76,440)	(76,440)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	6,597,912	6,597,912	9,804,656	9,804,656

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774
분기순이익	0	0	9,737,437	0	9,737,437
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	143,659	143,659
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(76,440)	(76,440)
배당 (주16)	0	0	(2,452,977)	0	(2,452,977)
자기주식의 취득 (주15)					
자기주식 소각 (주15)					
주식기준보상 (주17)					
2024.03.31 (분기말자본)	897,514	4,403,893	227,247,811	(409,765)	232,139,453
2025.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	233,734,316	(2,639,066)	236,396,657
분기순이익	0	0	6,387,197	0	6,387,197
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	239,762	239,762
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(29,047)	(29,047)
배당 (주16)	0	0	(2,454,307)	0	(2,454,307)
자기주식의 취득 (주15)	0	0	0	(2,955,851)	(2,955,851)
자기주식 소각 (주15)	0	0	(3,049,040)	3,049,040	0
주식기준보상 (주17)	0	0	0	271,326	271,326
2025.03.31 (분기말자본)	897,514	4,403,893	234,618,166	(2,063,836)	237,855,737

4-5. 현금흐름표 현금흐름표

제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 57 기 1분기	제 56 기 1분기
영업활동현금흐름	14,330,619	14,628,720
영업에서 창출된 현금흐름	10,358,626	6,831,193
분기순이익	6,387,197	9,737,437
조정 (주24)	5,945,404	(1,466,860)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(1,973,975)	(1,439,384)
이자의 수취	158,742	44,596
이자의 지급	(123,043)	(162,952)
배당금 수입	4,160,397	8,032,303
법인세 납부액	(224,103)	(116,420)
투자활동현금흐름	(2,598,252)	(11,221,180)
단기금융상품의 순감소(증가)	8,775,287	(176)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	1
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	96	70,048
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(300,511)	(3,592)
유형자산의 처분	10,670	20,506
유형자산의 취득	(9,898,585)	(10,147,089)
무형자산의 취득	(1,183,663)	(1,113,016)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(1,546)	(47,862)
재무활동현금흐름	(10,097,514)	2,813,153
단기차입금의 순증가(감소)	(7,068,291)	2,866,252
사채 및 장기차입금의 상환	(73,188)	(52,838)
배당금의 지급	(184)	(261)
자기주식의 취득	(2,955,851)	0
외화환산으로 인한 현금의 변동	(147)	165
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,634,706	6,220,858
기초현금및현금성자산	1,653,766	6,061,451
분기말의 현금및현금성자산	3,288,472	12,282,309

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어있습니다. DX(Device

eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2025년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

동 개정사항은 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해, 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같으며 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 지침을 명확히 하고 추가
- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- 기타포괄-공정가치금융자산(지분상품)에 대한 추가 공시

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		44,867,031	2,502,109	0	47,369,140
금융자산 합계	현금및현금성자산	3,288,472	0	0	3,288,472
	단기금융상품	1,414,698	0	0	1,414,698
	매출채권	34,181,288	0	0	34,181,288
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	2,502,109	0	2,502,109
	기타금융자산	5,982,573	0	0	5,982,573

전기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		50,947,761	2,176,346	373,681	53,497,788
금융자산 합계	현금및현금성자산	1,653,766	0	0	1,653,766
	단기금융상품	10,187,991	0	0	10,187,991
	매출채권	33,840,357	0	0	33,840,357
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	2,176,346	0	2,176,346
	기타금융자산	5,265,647	0	373,681	5,639,328

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합 계
금융부채 합계		62,892,258	5,066,310	67,958,568
금융부채 합계	매입채무	13,039,247	0	13,039,247
	단기차입금	0	4,067,920	4,067,920
	미지급금	17,904,010	0	17,904,010
	유동성장기부채	21,997,259	269,056	22,266,315
	사채	14,518	0	14,518
	장기차입금	0	729,334	729,334
	장기미지급금	4,505,019	0	4,505,019
	기타금융부채	5,432,205	0	5,432,205

전기말

(단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합 계
금융부채 합계		59,909,108	12,173,636	72,082,744
금융부채 합계	매입채무	10,287,967	0	10,287,967
	단기차입금	0	11,110,972	11,110,972
	미지급금	18,331,728	0	18,331,728
	유동성장기부채	21,997,265	266,961	22,264,226
	사채	14,530	0	14,530
	장기차입금	0	795,703	795,703
	장기미지급금	4,383,749	0	4,383,749
	기타금융부채	4,893,869	0	4,893,869

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	2,502,109

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	2,176,346

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

측정 단계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
취득일자										공정가치																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
금융자산, 분류										금융자산, 분류																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
공정가치로 측정하는 금융자산										공정가치로 측정하는 금융자산																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
상장주식										상장주식																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	Marv	Soun	금융				(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	Marv	Soun	금융				(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주	(주</

분기말

(단위 : 백만원)

측정 단계																		공정가치																					
취득일자																		공정가치																					
금융자산, 분류																		금융자산, 분류																					
공정가치로 측정하는 금융자산																		공정가치로 측정하는 금융자산																					
상장주식																		상장주식																					
상성	종공	업(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	Marvell Technology, Inc.	SoundHound AI, Inc.	자산, 분류	상성	종공	업(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	(주)	Marvell Technology, Inc.	SoundHound AI, Inc.	자산, 분류			
합(주)	신라	코리	아이	카이	리온	솔루	스	스	스	스	스	스	스	스	스	스	스	스	스	합(주)	신라	코리	아이	카이	리온	솔루	스	스	스	스	스	스	스	스	스	합(주)			
금융																				1,514	73.97		5,179	1,134	1,284	8,804	4,486	41.36	51.57	72.33	43.93	98.03	26.62	10.58	23.95	7,144	28.11	49.66	2,072
자산																				588	4							8	9	6	3	3	9	5	8	463	9	6	180

공정가치금융자산 중 상장주식의 보유주식수 및 지분율에 대한 공시

금융자산, 분류		공정가치로 측정하는 금융자산																									
상장주식		상장주식																									
		상성종공업(주)	(주)호텔신라	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아	(주)아이마켓크리아
보유주식수(주)	134,027,281	2,004,717	647,320	240,000	400,000	1,592,000	1,759,171	1,850,908	2,467,894	437,339	1,716,116	9,801,617	1,022,216	1,287,688	2,140,936	1,522,975	810,030	173,187	1,702,957								
보유지분율	0.152	0.051	0.019	0.005	0.008	0.159	0.023	0.038	0.048	0.056	0.080	0.117	0.049	0.071	0.049	0.070	0.070	0.006	0.004								
지분율에 대한 설명		총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주	총발행보통주
		식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분	식수 기준 지분
		불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.	불합합니다.

5. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당 금	장부금액 합계
재고자산		33,184,607	(3,574,285)	29,610,322
재고자산	제품 및 상품	6,521,949	(1,138,374)	5,383,575
	반제품 및 재공품	21,865,463	(1,920,287)	19,945,176
	원재료 및 저장품	4,267,395	(515,624)	3,751,771
	미착품	529,800	0	529,800

전기말

(단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당 금	장부금액 합계
재고자산		32,283,948	(3,129,833)	29,154,115
재고자산	제품 및 상품	6,374,009	(774,903)	5,599,106
	반제품 및 재공품	20,944,352	(1,802,857)	19,141,495
	원재료 및 저장품	4,561,944	(552,073)	4,009,871
	미착품	403,643	0	403,643

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	57,427,196	57,392,438
취득	1,274,797	3,592
처분	(94)	(115,776)
분기말장부금액	58,701,899	57,280,254

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율 (%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스 (주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 · 관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직 스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및	19.6	한국	12월

	공급			
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기업명	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기(주)	17,693,084	2,284,177	445,244	2,190,404	445,244
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,030,259	560,827	2,232,936	560,827
삼성바이오로직스(주)	22,217,309	22,528,351	1,595,892	21,084,226	1,595,892
삼성SDI(주)	13,462,673	2,537,714	1,242,605	3,332,012	1,242,605
(주)제일기획	29,038,075	523,266	491,599	492,195	491,599

라. 당사는 2025년 3월 12일 레인보우로보틱스(주)의 최대주주로부터 지분 394만주를 인수하는 콜옵션 행사절차를 완료하였으며, 지분인수 후 주주간 약정에 따라 이사진 선임권한을 확보하여 관계기업에서 종속기업으로 재분류하였습니다. 인수한 지분의 취득원가는 1,241,750백만원이며, 행사한 콜옵션의 지분인수일 현재 공정가치 평가에 따른 평가차익 600,606백만원을 금융수익으로 인식하였습니다.

7. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	151,446,870
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	9,596,819
감가상각비, 유형자산	(8,436,591)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(86,714)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	(23,232)
분기말 유형자산	152,497,152

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	140,579,161
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	8,292,612
감가상각비, 유형자산	(6,907,882)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(32,588)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	(1,522)

분기말 유형자산	141,929,781
----------	-------------

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	7,641,062	795,529	8,436,591

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	6,349,137	558,745	6,907,882

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	1,683,092

전기말

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	1,730,144

사용권자산의 추가와 감가상각비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	114,503
사용권자산감가상각비	(78,321)

전분기

(단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	74,283
사용권자산감가상각비	(71,861)

8. 무형자산

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초의 무형자산 및 영업권	10,496,956
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	1,267,580
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(652,336)

무형자산의 처분, 폐기 및 손상	(5,616)
기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권	6,592
기말 무형자산 및 영업권	11,113,176

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초의 무형자산 및 영업권	10,440,211
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	816,682
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(586,939)
무형자산의 처분, 폐기 및 손상	(8,745)
기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권	10,178
기말 무형자산 및 영업권	10,671,387

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	495,323	157,013	652,336

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	440,433	146,506	586,939

9. 차입금

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭		
	담보부차입금		
	거래상대방		
	우리은행 등		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
연이자율	0.007	0.142	
단기차입금			4,067,920
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭
	담보부차입금
	거래상대방

	우리은행 등		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
연이자율			
단기차입금			11,110,972
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭				차입금명칭 합계
	리스 부채		무담보차입금		
	거래상대방				
	-	삼성디스플레이(주)	-	삼성디스플레이(주)	
연이자율	0.028			0.046	
만기일	-			2025.08.16	
유동성장기차입금	269,055			21,990,000	22,259,055
차입처	-			삼성디스플레이(주)	

전기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭				차입금명칭 합계
	리스 부채		무담보차입금		
	거래상대방				
	-	삼성디스플레이(주)	-	삼성디스플레이(주)	
연이자율					
만기일	-			2025.08.16	
유동성장기차입금	266,961			21,990,000	22,256,961
차입처	-			삼성디스플레이(주)	

장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	리스 부채
연이자율	0.028
장기차입금	729,334

전기말

(단위 : 백만원)

	리스 부채
연이자율	
장기차입금	795,703

리스부채 이자비용에 대한 공시
당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	7,175
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은 7,175백만원입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	7,953
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 전분기 중 발생한 이자비용은 7,953백만원입니다.

10. 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds
발행일	1997-10-02
만기상환일	2027-10-01
연이자율	0.077
명목금액	21,998
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]	15,000
사채할인발행차금	(220)
사채	21,778
차감: 유동성사채	(7,260)
비유동성사채	14,518
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds
발행일	
만기상환일	
연이자율	
명목금액	22,050
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]	15,000
사채할인발행차금	(255)
사채	21,795

차감: 유동성사채	(7,265)
비유동성사채	14,530
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급 여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	13,317,598	25,821	13,343,419
사외적립자산의 공정가 치			(15,302,493)
순확정급여부채(자산) 계			(1,959,074)

전기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급 여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	13,152,202	25,500	13,177,702
사외적립자산의 공정가 치			(15,427,494)
순확정급여부채(자산) 계			(2,249,792)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			288,455
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(28,685)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	107,563	152,207	259,770

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
--	------	-----------	-----------

당기근무원가, 확정급여제도			263,395
순이자비용(수익), 확정급여제도			(53,911)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	82,912	126,572	209,484

12. 총당부채

총당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	총당부채 합계
기초	756,630	2,793,901	654,326	4,655,107	8,859,964
순전입(환입)	129,930	207,314	49,146	50,067	436,457
사용	(139,850)	(181,153)	0	(142,750)	(463,753)
기타	0	(17,606)	0	(2,446)	(20,052)
기말	746,710	2,802,456	703,472	4,559,978	8,812,616
총당부채의 성격에 대한 기술	회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.	회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.	회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	2025년(당기 이행연도)
무상할당 배출권(단위: 만톤(tCO ₂ -eq))	1,117
배출량 추정치(단위: 만톤(tCO ₂ -eq))	1,537

배출권 변동내역에 대한 공시
당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

재무제표에 인식한 배출부채에 대한 기술

당분기 및 전분기 중 회사가 재무제표에 인식한 배출부채는 없습니다.

13. 우발부채와 약정사항

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	지급보증의 구분				
	제공한 지급보증				제공받은 지급보증
	해외중속기업(SETK) 자금조달 등을 위한 채무보증	해외중속기업(기타) 자금조달 등을 위한 채무보증	해외중속기업 자금조달 등을 위한 채무보증 합계	해외중속기업 계약이행을 위한 지급보증	해외중속기업 계약이행을 위한 지급보증
피보증처명	SETK	기타	SETK 및 기타		
보증처	BNP 외	기타	BNP 외 기타		
특수관계 여부	Y	Y	Y	Y	Y
기업의(으로의) 보증 한도 (비 PF)	1,388,776	10,511,492	11,900,268	534,220	
차입금(사채 포함)	506,949	0	506,949		
지급보증에 대한 비고 (설명)				당분기말 현재 회사가 해외중속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 534,220백만원입니다.	당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.
보증종료일	2025-12-16				

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시, 외화금액

	지급보증의 구분
--	----------

	제공한 지급보증
	해외중속기업 자금조달 등을 위한 채무보증 합계
기업의(으로의) 보증한도 (비 PF), USD [USD, 천]	8,114,741
차입금(사채 포함), USD [USD, 천]	345,699

법적소송우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	당분기말 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다.
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

분할과 관련된 연대채무 사실에 대한 기술

회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	약정의 유형
	매입약정
	발생하지 않은 유무형자산의 취득
약정 금액	10,767,768
약정에 대한 설명	당분기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 10,767,768백만원입니다.

14. 계약부채

계약부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	2,169,506

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	1,559,287

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식 액면 총액(백만원)	591,964	81,597	673,561
납입자본금(백만원)			897,514
자본금에 대한 설명			발행주식의 액면총액은 673,561백만원(보통주 591,964백만원, 우선주 81,597백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.
각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다.

주식에 대한 공시

당분기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,940,082,550	818,836,700
자기주식 취득주식수(주)	(47,444,628)	(6,587,036)
기말 유통주식수(주)	5,892,637,922	812,249,664

소각주식 수를 제외한 발행주식 수	5,919,637,922	815,974,664
유통주식수에 대한 기술	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주의 수(소각 주식수 제외)는 5,919,637,922주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다.	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 815,974,664주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다.

전기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700
자기주식 취득주식수(주)	(29,700,000)	(4,050,000)
기말 유통주식수(주)	5,940,082,550	818,836,700
소각주식 수를 제외한 발행주식 수		
유통주식수에 대한 기술		

주식 소각에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
소각한 주식 수	50,144,628	6,912,036	
소각한 주식의 취득원가			3,049,040
주식 소각 이사회 결의 일			2025-02-18

16. 이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		234,618,166
이익잉여금	법정적립금	450,789
	임의적립금 등	234,167,377

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		233,734,316
이익잉여금	법정적립금	450,789
	임의적립금 등	233,283,527

배당금에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분		
	분기배당		
	1분기		
	주식		주식 합계
	보통주	우선주	
배당기준일			2025-03-31
배당받을 주식(주)	5,892,637,922	812,249,664	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.65		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.65	
지급될 배당금	2,150,813	296,471	2,447,284

전분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분		
	분기배당		
	1분기		
	주식		주식 합계
	보통주	우선주	
배당기준일			2024-03-31
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)	3.61		
우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.61	
지급될 배당금	2,155,092	297,062	2,452,154

17. 기타자본항목

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(2,063,836)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	727,864
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(3,104,848)
	자기주식	(1,718,586)
	주식기준보상	271,326

	기타	1,760,408
--	----	-----------

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(2,639,066)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	488,102
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(3,075,801)
	자기주식	(1,811,775)
	주식기준보상	0
	기타	1,760,408

자기주식에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기 업 또는 관계기업이 소유하고 있 는 자기주식수(주)	27,000,000	3,725,000
자기주식	1,541,799	176,787

전기말

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기 업 또는 관계기업이 소유하고 있 는 자기주식수(주)	29,700,000	4,050,000
자기주식	1,625,252	186,523

주식기준보상약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	주식결제 성과인센티브	임직원 주식보상
--	-------------	----------

주식기준보상약정에 대한 기술	회사는 임원을 대상으로 성과인센티브 중 일부를 2026년 1월에 양도제한주식(RSA)으로 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 주식결제가 확정된 인센티브 63,912백만원(보통주1,176,383주)을 '미지급비용'에서 '기타자본항목'으로 대체하였습니다.	회사는 노사협의 결과에 따라 2025년 3월 5일 현재 재직중인 임직원 전원에게 보통주 30주를 부여하기로 약정하였으며, 이에 따라 지급예정인 보통주 3,841,035주의 약정일 현재 공정가치 207,414백만원을 '급여' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당기 중 지급완료할 예정입니다.
주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술	주식결제	주식결제
주식기준보상약정의 부여일	2026년 1월	2025년 03월 05일
주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량(단위 : 주)	1,176,383	3,841,035
주식결제가 확정된 인센티브 금액	63,912	
약정일 현재 공정가치		207,414

18. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
성격별 비용		54,065,598
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	(588,151)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	26,038,309
	급여	4,454,758
	퇴직급여	260,680
	감가상각비	8,436,591
	무형자산상각비	652,336
	복리후생비	940,902
	유틸리티비	1,539,278
	외주용역비	1,271,659
	광고선전비	256,033
	판매촉진비	398,006
	기타 비용	10,405,197

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
성격별 비용		49,232,237
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	(1,055,043)

	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,505,265
	급여	3,871,247
	퇴직급여	210,609
	감가상각비	6,907,882
	무형자산상각비	586,939
	복리후생비	879,011
	유틸리티비	1,391,476
	외주용역비	951,212
	광고선전비	370,551
	판매촉진비	310,302
	기타 비용	10,302,786

성격별 비용에 대한 기술

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			11,606,923
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		3,713,194
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	705,079
		퇴직급여	43,716
		지급수수료	909,413
		감가상각비	122,362
		무형자산상각비	104,336
		광고선전비	256,033
		판매촉진비	398,006
		운반비	166,940
		서비스비	423,804
		기타판매비와관리비	583,505
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		7,893,729

전분기

(단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			10,459,387
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		3,734,892
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	755,594
		퇴직급여	36,937

	지급수수료	720,785
	감가상각비	118,581
	무형자산상각비	98,233
	광고선전비	370,551
	판매촉진비	310,302
	운반비	227,061
	서비스비	587,770
	기타판매비와관리비	509,078
	경상연구개발비-연구개발 총지출액	6,724,495

20. 기타수익 및 기타비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		4,419,250
기타수익	배당금수익	4,309,232
	임대료수익	45,258
	유형자산처분이익	8,988
	기타	55,772
기타비용		48,027
기타비용	유형자산처분손실	2,000
	기부금	30,847
	기타	15,180

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		8,249,118
기타수익	배당금수익	8,149,657
	임대료수익	46,522
	유형자산처분이익	9,628
	기타	43,311
기타비용		271,087
기타비용	유형자산처분손실	21,264
	기부금	64,584
	기타	185,239

21. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
--	--	------

금융수익 합계			1,830,799
금융수익 합계	이자수익(금융수익)		71,483
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	71,483
	외환차이		1,158,710
	파생상품관련이익		600,606
금융비용 합계			1,279,709
금융비용 합계	이자비용(금융원가)		164,504
	이자비용(금융원가)	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	73,437
		기타 금융부채 이자비용	91,067
	외환차이		1,115,205

전분기

(단위 : 백만원)

				공시금액	
금융수익 합계				1,440,265	
금융수익 합계	이자수익(금융수익)			60,491	
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익		60,491	
	외환차이			1,350,333	
	파생상품관련이익			29,441	
금융비용 합계				1,440,379	
금융비용 합계	이자비용(금융원가)			200,943	
	이자비용(금융원가)	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용		72,674	
		기타 금융부채 이자비용		128,269	
	외환차이			1,239,436	

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용

평균유효세율과 적용세율간의 조정

	공시금액
법인세비용 인식에 대한 기술	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다.
2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.001

23. 주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

		보통주	우선주
기본주당이익			
기본주당이익	분기순이익	5,613,673	773,524
	가중평균유통보통주식수(주)	5,920,293,406	
	가중평균유통우선주식수(주)		815,925,797
	기본주당이익(단위 : 원)	948	948
희석주당순이익			
희석주당순이익	희석효과를 포함한 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,613,785	
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		773,412
	조정된 가중평균유통보통주식수(주)	5,921,137,636	
	조정된 가중평균유통우선주식수(주)		815,925,797
	희석주당이익(단위 : 원)	948	948

전분기

(단위 : 백만원)

		보통주	우선주
기본주당이익			
기본주당이익	분기순이익	8,557,811	1,179,626
	가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	
	가중평균유통우선주식수(주)		822,886,700
	기본주당이익(단위 : 원)	1,434	1,434
희석주당순이익			
희석주당순이익	희석효과를 포함한 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	8,557,811	
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		1,179,626
	조정된 가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	
	조정된 가중평균유통우선주식수(주)		822,886,700
	희석주당이익(단위 : 원)	1,434	1,434

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

당분기 가중평균 희석성 잠재적보통주는 845천주(주식보상 관련)가 포함되어 있으며, 전분기는 없습니다.

24. 현금흐름표

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다.

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		5,945,404
조정내역 계	법인세비용 조정	4,389
	금융수익	(1,143,534)
	금융비용	1,125,428
	퇴직급여	260,680
	감가상각비	8,436,591
	무형자산상각비	652,336
	대손상각비(환입)	20,126
	배당금수익	(4,309,232)
	유형자산처분이익	(8,988)
	유형자산처분손실	2,000
	재고자산평가손실환입	
	재고자산평가손실	690,983
	기타	214,625
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(1,973,975)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(15,636)
	미수금의 감소(증가)	1,259,126
	장단기선급비용의 감소(증가)	47,424
	재고자산의 감소(증가)	(1,117,277)
	매입채무의 증가(감소)	2,630,299
	장단기미지급금의 증가(감소)	(3,153,390)
	선수금의 증가(감소)	(74,404)
	예수금의 증가(감소)	51,416
	미지급비용의 증가(감소)	(1,054,370)
	장단기충당부채의 증가(감소)	(27,296)
	퇴직금의 지급	(285,253)
	기타	(234,614)

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		(1,466,860)
조정내역 계	법인세비용 조정	247,860
	금융수익	(467,923)
	금융비용	878,506
	퇴직급여	210,609

	감가상각비	6,907,882
	무형자산상각비	586,939
	대손상각비(환입)	6,975
	배당금수익	(8,149,657)
	유형자산처분이익	(9,628)
	유형자산처분손실	21,264
	재고자산평가손실환입	(1,754,124)
	재고자산평가손실	
	기타	54,437
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(1,439,384)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(5,181,386)
	미수금의 감소(증가)	223,291
	장단기선급비용의 감소(증가)	37,269
	재고자산의 감소(증가)	247,137
	매입채무의 증가(감소)	4,386,544
	장단기미지급금의 증가(감소)	(1,227,176)
	선수금의 증가(감소)	(55,057)
	예수금의 증가(감소)	25,813
	미지급비용의 증가(감소)	(278,614)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,305,879
	퇴직금의 지급	(220,017)
	기타	(703,067)

리스부채와 관련한 현금유출액에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	73,188
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	7,175

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	52,838
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	7,953

25-1. 재무위험관리

	위험					위험 합계
	시장위험			신용위험	유동성위험	
	환위험	이자율위험	지분가격위험			
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.	이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	회사는 전략적 목적으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.	유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다.	회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술	회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.	회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.	회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다. 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.	회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한, 대규모 유동성이 필요한 경우에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.	회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 한한치 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.
--------------------------	--	--	---	--	--	--

보고기간 말 현재 노출된 주가변동의 각 유형별 민감도 분석

당분기

(단위 : 백만원)

	위험
	시장위험

	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	23,906
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	23,906

전분기

(단위 : 백만원)

	위험
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	19,509
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	19,509

부채비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부채	84,682,260
자본	237,855,737
부채비율	0.356
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부채	88,569,470
자본	236,396,657
부채비율	0.375

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.
--------------------------------------	--

25-2. 공정가치측정

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	공정가치평가를 기타 포괄손익으로 인식하는 금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
금융자산	3,288,472	1,414,698	34,181,288	2,502,109	5,982,573	47,369,140
금융자산, 공정가치				2,502,109	0	
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		보고기간종료일 현재 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금융자산 5,982,573백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	공정가치평가를 기타 포괄손익으로 인식하는 금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
금융자산	1,653,766	10,187,991	33,840,357	2,176,346	5,639,328	53,497,788
금융자산, 공정가치				2,176,346	373,681	
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		보고기간종료일 현재 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금융자산 5,265,647백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	

금융부채의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	13,039,247	4,067,920	22,409,029	22,988,389	21,778	5,432,205	67,958,568
금융부채, 공정가치					24,350		

공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	
--------------------	--	--	--	---	--	--	--

전기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	10,287,967	11,110,972	22,715,477	23,052,664	21,795	4,893,869	72,082,744
금융부채, 공정가치					24,164		
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	자산							
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	
자산	2,390,603	0	111,506	2,502,109	0	0	0	0

전기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	자산							
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	
자산	2,072,108	0	104,166	2,176,346	0	0	373,681	373,681

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체
--	-------

	공정가치			
	부채			
	사채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3	
부채	0	24,350	0	24,350

전기말

(단위 : 백만원)

	측정 전체			
	공정가치			
	부채			
	사채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3	
부채	0	24,164	0	24,164

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	수준 1	수준 2	수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 사채 등이 있습니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름할인법 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다. 회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	측정 전체	
	공정가치	
	자산	
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	
	삼성벤처투자(주)	(주)미코세라믹스
	공정가치 서열체계의 모든 수준	
	공정가치 서열체계 수준 3	
자산	36,299	57,088
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	현금흐름할인법	현금흐름할인법 등
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

	측정 전체
--	-------

	공정가치			
	자산			
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산			
	삼성벤처투자(주)		(주)미코세라믹스	
	평가기법			
	현금흐름할인법			
	관측할 수 없는 투입변수			
	영구성장률, 투입 변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입 변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수
유의적이지만 관측 할 수 없는 투입변 수, 자산	0.010	0.154	0.000	0.112

수준 3에 해당하는 금융상품의 변동 내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	477,847
매입	0
매도	0
당기손익으로 인식된 손익	600,606
기타포괄손익으로 인식된 손익	7,340
기타	(974,287)
기말	111,506

전분기

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	490,403
매입	0
매도	0
당기손익으로 인식된 손익	29,440
기타포괄손익으로 인식된 손익	1,654
기타	0
기말	521,497

금융상품의 민감도분석 방법에 대한 기술

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	측정 전체		
	공정가치		
	자산		
	기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산		
	관측할 수 없는 투입변수		관측할 수 없는 투입변수 수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01	
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산			5,971
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산			(4,108)

26. 부문별 보고

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고 부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문 사이의 거래에 대한 회계처리 방법에 대한 기술

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계		기업 전체 총계 합계
	영업부문		
	DX 부문	DS 부문	
매출액	33,023,911	24,658,121	55,534,871
감가상각비	148,483	8,234,941	8,436,591
무형자산상각비	409,194	183,926	652,336
영업이익	1,388,471	82,013	1,469,273
보고부문에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계		기업 전체 총계 합계
	영업부문		
	DX 부문	DS 부문	
매출액	30,581,450	22,829,373	51,239,617
감가상각비	133,744	6,723,408	6,907,882
무형자산상각비	393,261	136,186	586,939
영업이익	938,898	1,067,002	2,007,380
보고부문에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

27. 특수관계자와의 거래

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

관제 특수관계자				
특수관계자				
종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단	
		계자		

[illegible][illegible]

[illegible]특수관계자거래에 대한 공시, 합계
당분기

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	51,794,992	371,307	150,404	57,270
비유동자산 처분, 특수관계자거래	7,939	185	0	0
매입 등, 특수관계자거래	25,571,388	1,091,365	191,985	135,564
비유동자산 매입, 특수관계자거래	5,701	84,403	1,002,295	816,495
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	52,673,213	321,315	132,128	51,135
비유동자산 처분, 특수관계자거래	16,244	122	0	0
매입 등, 특수관계자거래	25,294,767	1,166,884	204,415	164,070
비유동자산 매입, 특수관계자거래	5,191	66,542	1,080,956	614,082
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

Page 161

전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 162

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계

당분기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	31,045,583	295,142	199,502	7,014
채무 등, 특수관계자거래	13,906,979	1,132,782	1,405,284	2,275,269
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	32,238,136	297,926	196,569	6,294
채무 등, 특수관계자거래	13,608,939	1,292,487	1,960,964	2,520,417
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.
-----------------	--	--	--	--

종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 대여 및 차입 사실에 대한 기술

회사는 당분기 및 전분기 중 종속기업에 대여한 내역은 없으며, 당분기 및 전분기 중 종속기업으로부터 차입한 금액은 없습니다. 또한, 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에게 대여 및 차입한 내역은 없습니다.

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	종속기업
현금출자, 출자금 납입	300,511
현금출자, 출자금 회수	94

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	종속기업
현금출자, 출자금 납입	3,592
현금출자, 출자금 회수	115,776

특수관계자 기타 거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자 거래	400,702	32,235
리스 이용 계약, 특수관계자거래	84,151	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	12,715	

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	종속기업, 관계기업 및 공동기업 과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자 거래	412,172	32,058
리스 이용 계약, 특수관계자거래	16,025	
리스이용자로서 리스, 특수관계 자거래	16,006	

배당과 관련한 미지급금에 대한 공시, 특수관계자거래

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	종속기업, 관계기업 및 공동기업 과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
배당과 관련한 미지급금, 특수관 계자거래	400,702	32,058

특수관계자 채무에 대한 채무보증 제공 사실에 대한 기술

회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

주요 경영진(등기임원)에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영 진
단기급여	2,550
퇴직급여	600
기타 장기급여	1,799

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영 진

단기급여	3,017
퇴직급여	175
기타 장기급여	2,289

6. 배당에 관한 사항

6-1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여 현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 재원으로 활용하여 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 실시하였습니다. 2024~2026년의 주주환원 정책은 2024년 1월에 발표하였으며, 이에 따라 당사는 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하여 연간 9.8조원 수준의 정규배당을 유지하되, 정규배당 이후에도 잔여 재원이 발생하는 경우에 추가로 환원할 계획입니다. 또한, 당사는 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 새로운 주주환원 정책을 발표하고 시행할 수 있습니다.

그리고 당사는 2024년 11월 향후 1년간 총 10조원 규모의 자사주 분할 매입 계획을 발표하고, 이 중 3조원은 주주가치 제고를 목적으로 매입 후 2025년 2월에 소각하였습니다. 또한 2025년 2월에 주주가치 제고 및 임직원 보상 등 목적으로 잔여 7조원 중 약 3조원 규모의 자사주 취득을 결정하였고, 2025년 5월 자사주 취득을 완료할 예정입니다.

6-2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관	- 분기배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	- 불가
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	- 검토 중

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액 확정일	배당기준일	배당 예측가능성 제공여부	비고
기말배당	2024.12	○	2025.03.19	2024.12.31	X	-
기말배당	2023.12	○	2024.03.20	2023.12.31	X	-
기말배당	2022.12	○	2023.03.15	2022.12.31	X	-

※ 당사는 3년 단위(2024~2026년)의 주주환원 정책을 발표하고 매년 분기 단위로 동일한 금액(약 9.8조원)의

정규배당을 실시하여 실질적인 예측가능성을 제공하고 있음

6-3. 기타 참고사항

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제57기 1분기	제 56 기	제 55 기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		8,028,407	33,621,363	14,473,401
(별도)당기순이익(백만원)		6,387,197	23,582,565	25,397,099
(연결)주당순이익(원)		1,192	4,950	2,131
현금배당금총액(백만원)		2,447,284	9,810,767	9,809,438
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		30.5	29.2	67.8
현금배당수익률(%)	보통주	0.6	2.7	1.9
	우선주	0.7	3.3	2.4
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	365	1,446	1,444
	우선주	365	1,447	1,445
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은 제57기 1분기 2,447,284백만원(주당 365원), 제56기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며, 제55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
43	44	2.4	2.6

- ※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.
- ※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
- ※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.8%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.9%입니다.
- ※ 최근 3년간은 2022년(제54기)부터 2024년(제56기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2020년(제52기)부터 2024년(제56기)까지 기간입니다. 2025년(제57기) 1분기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 0.6%, 우선주 0.7%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	146,650	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	586,600	4.2%	A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
합 계	-	-	-	733,250	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과 4년 이하	4년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	593,933	7,333	7,332	-	-	-	-	608,598
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	593,933	7,333	7,332	-	-	-	-	608,598

- 삼성전자(주)

(기준일 : 2025년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	7,333	7,333	7,332	-	-	-	-	21,998
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	7,333	7,333	7,332	-	-	-	-	21,998

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2025년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	586,600	-	-	-	-	-	-	586,600
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	586,600	-	-	-	-	-	-	586,600

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	146,650	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2025.03.31)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2024년 중 처분 자산은 전체의 0.0%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

- ※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.
- ※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
- ※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.
- ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.
- ※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(eMagin Corporation 지분인수)

종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 Micro Display 기술 경쟁력을 확보를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation (대표자: AndrewSculley, 소재지: New York, USA) 지분 100%를 인수하였습니다.

(주)도우인시스 지분매각)

종속기업 삼성디스플레이(주)는 OLED 산업 내 경쟁구도가 갈수록 심화되고 있는 상황에서 본 연의 사업과 R&D에 집중하기 위해 2024년 1월 31일자로 SVIC 29호 신기술투자조합 및 SVIC 48호 신기술투자조합이 보유한 (주)도우인시스 지분 56.8%를 (주)뉴파워프라즈마 등 3개 사에 매각하였습니다.

(레인보우로보틱스(주) 지분인수)

당사는 2024년 12월 31일 이사회 결의를 통해 레인보우로보틱스(주)의 최대주주로부터 394만주(20.3%)의 지분을 취득하는 콜옵션 행사를 결의하였으며, 2025년 3월 12일에 지분 인수 절차를 완료하였습니다. 향후 당사가 보유한 AI 및 소프트웨어기술과레인보우로보틱스(주)의 로봇기술을 접목하여 첨단 미래 로봇개발을 신속하고 체계적으로 준비해나갈 예정입니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.04.20	2025.11.08	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.03.28	2025.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2024.10.01	2025.12.16	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.06.01	2025.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	318,000	286,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	46,000	46,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	947,000	947,000	495,321	△149,623	345,699	46.9%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2024.04.28	2025.12.16	808,270	820,741	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	125,000	115,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	906,400	938,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	20,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
합 계							8,102,270	8,114,741	495,321	△149,623	345,699	

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정
됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를
수취하고 있습니다.당사는 2024년 중 US\$2,215천의 수수료를 청구하였으며, 2025년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을
참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제57기 1분기	해당사항 없음	해당사항 없음
제56기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제55기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제57기 1분기말	매출채권	45,320,921	454,336	1.0%
	단기대여금	25,480	238	0.9%
	미수금	9,224,037	82,584	0.9%
	선급금	1,405,368	4,940	0.4%
	장기매출채권	25,706	-	0.0%
	장기미수금	767,749	274	0.0%
	장기선급금	6,131,438	6,320	0.1%
	장기대여금	143,445	909	0.6%
	합 계	63,044,144	549,601	0.9%
제56기말	매출채권	44,044,074	421,001	1.0%
	단기대여금	119,558	94,051	78.7%
	미수금	9,707,716	84,742	0.9%
	선급금	1,366,329	4,573	0.3%
	장기매출채권	27,641	-	0.0%
	장기미수금	784,030	203	0.0%
	장기선급금	5,997,761	6,802	0.1%
	장기대여금	141,149	911	0.6%
	합 계	62,188,258	612,285	1.0%
제55기말	매출채권	37,002,849	355,456	1.0%
	단기대여금	21,279	204	1.0%
	미수금	6,715,263	82,015	1.2%
	선급금	994,525	3,316	0.3%
	장기매출채권	23,889	-	0.0%
	장기미수금	759,704	209	0.0%
	장기선급금	4,964,481	9,255	0.2%
	장기대여금	239,149	77,608	32.5%
	합 계	50,721,139	528,063	1.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제57기 1분기	제56기	제55기
기초 대손충당금(손실충당금)	612,285	528,063	406,677
순대손처리액(① - ② + ③)	104,078	△22,558	14,647
① 대손처리액(상각채권액) 등	4,018	10,834	19,179
② 상각채권회수액	-	-	4
③ 기타증감액	100,060	△33,392	△4,528
대손상각비 계상(환입)액	41,394	61,664	136,033
기말 대손충당금(손실충당금)	549,601	612,285	528,063

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일)

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	45,069,555	45,592	119,072	112,408	45,346,627
구성비율	99.4%	0.1%	0.3%	0.2%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제57기 1분기말	제56기말	제55기말
DX 부문	제품 및 상품	7,358,122	7,198,304	7,229,898
	반제품 및 재공품	869,305	1,130,657	967,513
	원재료 및 저장품	10,584,138	10,352,671	9,608,619
	미착품	1,276,471	1,231,092	1,014,420
	소 계	20,088,036	19,912,724	18,820,450
DS 부문	제품 및 상품	5,230,335	5,394,407	6,476,768
	반제품 및 재공품	22,103,242	21,091,920	20,961,730
	원재료 및 저장품	3,028,178	3,134,003	3,484,046
	미착품	52,752	68,244	76,226
	소 계	30,414,507	29,688,574	30,998,770
SDC	제품 및 상품	366,924	458,697	284,394
	반제품 및 재공품	394,055	151,553	296,788
	원재료 및 저장품	783,716	575,119	564,573
	미착품	25,514	15,672	6,509
	소 계	1,570,209	1,201,041	1,152,264
Harman	제품 및 상품	979,572	916,269	725,484
	반제품 및 재공품	95,200	108,241	104,514
	원재료 및 저장품	717,737	680,564	700,011
	미착품	443,802	401,238	319,785
	소 계	2,236,311	2,106,312	1,849,794
총 계	제품 및 상품	13,973,334	13,842,276	14,553,014
	반제품 및 재공품	23,340,245	22,340,482	22,198,448
	원재료 및 저장품	14,444,868	14,146,279	13,697,354
	미착품	1,461,820	1,425,828	1,177,058
	소 계	53,220,267	51,754,865	51,625,874
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.3%	10.1%	11.3%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.9회	3.6회	3.5회

※ 당사 연결 기준입니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2025년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	15,444,441	15,444,441	△1,471,107	13,973,334
반제품 및 재공품	25,947,244	25,947,244	△2,606,999	23,340,245
원재료 및 저장품	15,739,355	15,739,355	△1,294,487	14,444,868
미착품	1,461,820	1,461,820	-	1,461,820
합 계	58,592,860	58,592,860	△5,372,593	53,220,267

※ 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2025년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
과생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제57기 1분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산	당기손익- 공정가치 측정 금융자산	기타금융자산 (*)	계
현금및현금성자산	53,161,004	-	-	-	53,161,004
단기금융상품	51,943,037	-	-	-	51,943,037
단기당기손익-공정가치금융자 산	-	-	29,521	-	29,521
매출채권	44,866,585	-	-	-	44,866,585
기타포괄손익-공정가치금융자 산	-	10,288,577	-	-	10,288,577
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,230,070	-	1,230,070
기타	15,567,830	-	109,097	22,507	15,699,434
계	165,538,456	10,288,577	1,368,688	22,507	177,218,228

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	14,496,195	-	-	14,496,195
단기차입금	315,140	-	5,018,719	5,333,859
미지급금	19,337,259	-	-	19,337,259
유동성장기부채	950,219	-	1,085,773	2,035,992
사채	14,518	-	-	14,518
장기차입금	6,240	-	3,753,339	3,759,579
장기미지급금	4,881,844	-	-	4,881,844
기타	13,836,922	47,052	42,551	13,926,525
계	53,838,337	47,052	9,900,382	63,785,771

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주
로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

2) 제56기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산	당기손익- 공정가치 측정 금융자산	기타금융자산 (*)	계
현금및현금성자산	53,705,579	-	-	-	53,705,579
단기금융상품	58,909,334	-	-	-	58,909,334
단기당기손익-공정가치금융자 산	-	-	36,877	-	36,877
매출채권	43,623,073	-	-	-	43,623,073
기타포괄손익-공정가치금융자 산	-	10,580,932	-	-	10,580,932
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,175,749	-	1,175,749
기타	14,378,224	-	476,394	44,262	14,898,880
계	170,616,210	10,580,932	1,689,020	44,262	182,930,424

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,370,177	-	-	12,370,177
단기차입금	338,058	-	12,834,446	13,172,504
미지급금	17,390,861	-	-	17,390,861
유동성장기부채	1,106,764	-	1,100,526	2,207,290
사채	14,530	-	-	14,530
장기차입금	6,537	-	3,929,323	3,935,860
장기미지급금	4,779,141	-	-	4,779,141
기타	13,698,485	36,795	57,764	13,793,044
계	49,704,553	36,795	17,922,059	67,663,407

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주
로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제57기 1분기말		제56기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	53,161,004	(*)	53,705,579	(*)
단기금융상품	51,943,037	(*)	58,909,334	(*)
단기당기손익-공정가치금융자산	29,521	29,521	36,877	36,877
매출채권	44,866,585	(*)	43,623,073	(*)
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,288,577	10,288,577	10,580,932	10,580,932
당기손익-공정가치금융자산	1,230,070	1,230,070	1,175,749	1,175,749
기타(*2)	15,699,434	131,604	14,898,880	520,656
계	177,218,228		182,930,424	
금융부채:				
매입채무	14,496,195	(*)	12,370,177	(*)
단기차입금	5,333,859	(*)	13,172,504	(*)
미지급금	19,337,259	(*)	17,390,861	(*)
유동성장기부채	2,035,992	593,859	2,207,290	594,010
－ 유동성장기차입금	1,441,836	(*)(*)3	1,611,282	(*)(*)3
－ 유동성사채	594,156	593,859	596,008	594,010
사채	14,518	16,566	14,530	16,427
장기차입금	3,759,579	(*)(*)3	3,935,860	(*)(*)3
장기미지급금	4,881,844	(*)	4,779,141	(*)
기타(*2)	13,926,525	89,603	13,793,044	94,559
계	63,785,771		67,663,407	

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*)2 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 15,567,830백만원(전기말:14,378,224백만원)

및 금융부채 13,836,922백만원(전기말:13,698,485백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*)3 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제57기 1분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	29,521	-	29,521
기타포괄손익-공정가치금융자산	7,522,899	-	2,765,678	10,288,577
당기손익-공정가치금융자산	111,076	-	1,118,994	1,230,070
기타	-	85,683	45,921	131,604
금융부채:				
유동성사채	-	593,859	-	593,859
사채	-	16,566	-	16,566
기타	-	89,603	-	89,603

(단위 : 백만원)

구 분	제56기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	36,877	-	36,877
기타포괄손익-공정가치금융자산	7,686,545	-	2,894,387	10,580,932
당기손익-공정가치금융자산	86,187	-	1,089,562	1,175,749
기타	-	98,159	422,497	520,656
금융부채:				
유동성사채	-	594,010	-	594,010
사채	-	16,427	-	16,427
기타	-	94,559	-	94,559

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2025년 1분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	36,299	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	15.4%
(주)미코세라믹스	57,088	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	11.2%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,404,219	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	9.3%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	291,612	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	9.3%
기타:				
지분 풋옵션	45,921	이항모형	무위험 할인율	3.8%~4.1%, 5.0%
			가격 변동성	29.7%, 34.1%

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제57기 1분기	제56기
기초	4,406,446	3,730,134
매입	22,264	250,695
매도	(13,200)	△133,546
당기손익으로 인식된 손익	607,370	23,415
기타포괄손익으로 인식된 손익	(133,702)	322,885
기타	(958,585)	212,863
기말	3,930,593	4,406,446

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제57기 1분기	제56기
기초	-	-
당기손익으로 인식된 손익	-	-
기타	-	-
기말	-	-

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2025년 1분기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익 효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	175,478	-	(114,331)
기타	6,307	-	(6,900)	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장을 및 가중평균자본비용을

1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써

공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 및 제56기 감사, 제57기 1분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제55기 및 제56기 감사의견은 적정이며, 제57기 1분기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

[회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사 유	계속기업 관련 중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
제57기 1분기 (당분기)	감사보고서	삼정회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결감사 보고서	삼정회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제56기 (전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
	연결감사 보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제55기 (전전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 메모리 반도체 재고자산 손실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
	연결감사 보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 메모리 반도체 재고자산 손실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제57기 1분기 (당분기)	삼정회계법인	분 · 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	8,100	81,000	1,312	13,120
제56기 (당기)	삼정회계법인	분 · 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	78,000	7,800	76,830
제55기 (당기)	삼정회계법인	분 · 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	85,700	7,800	85,036

(제57기 1분기 일정)

구 분		일 정
제57기 1분기	사전검토	2025.03.10 ~ 2025.03.28
	본검토	2025.04.07 ~ 2025.05.14

※ 별도 · 연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제57기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-
제56기(전기)	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	43	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.05	-	삼정회계법인
	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	73	삼정회계법인
제55기(전전기)	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	202	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	27	삼정회계법인
	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	79	삼정회계법인
	2023.05	ESG인증업무(국내종속기업)	2023.05~2023.07	25	삼정회계법인

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2025.01.24	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2025.04.28	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 4명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 분기 검토 경과 보고 연간 회계감사 계획 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

제57기 1분기말 현재 당사의 종속기업은 230개이며, Harman Belgium SA 외 해외 6개 종속기업은 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Rus Company LLC은 TeDO에서 B1으로 회계감사인을 변경하였으며, 국내 종속기업 중 스테코(주)와 삼성메디슨(주)은 삼일회계법인(PwC)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제57기 1분기종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
스테코(주)	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
삼성메디슨(주)	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	TeDO	B1
Harman Belgium SA	PwC	KPMG
Harman Connected Services AB.	PwC	KPMG
Harman Finland Oy	PwC	KPMG
Harman Inc. & Co. KG	PwC	KPMG
Harman International Romania SRL	PwC	KPMG
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	PwC	KPMG
Harman International (India) Private Limited	PwC	KPMG

제56기말(전기말) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 당기 중 해외 종속기업 중 Harman International Industries, Inc. 외 16개 종속기업은 PwC에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였으며, 국내 종속기업 중 (주)하만인터내셔널코리아는 삼일회계법인(PwC)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 전기 중 설립된 SVIC 67호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을, Samsung Electronics Middle east and North Africa는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한, 전전기 중 신규 인수한 eMagin Corporation은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였고, 전전기 중 설립된 종속기업 Samsung Federal Inc.는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제56기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
(주)하만인터내셔널코리아	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
Harman International Industries, Inc.	PwC	KPMG
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Holding Limited	PwC	KPMG
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems GmbH	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	PwC	KPMG
Harman Connected Services GmbH	PwC	KPMG
Harman Consumer Nederland B.V.	PwC	KPMG
Harman Deutschland GmbH	PwC	KPMG
Harman Holding GmbH & Co. KG	PwC	KPMG
Harman Hungary Financing Ltd.	PwC	KPMG
Harman Professional Kft	PwC	KPMG

당사는 제55기(전전기)부터 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경하였습니다. 이는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정한 결과로, 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

제55기말(전전기말) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 전전기 중 국내 종속기업 가운데 삼성디스플레이(주) 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로, 에스유머티리얼스(주)는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung Japan Corporation (SJC)등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다. 한편, 전전기 중 설립된 종속기업SVIC 62호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 신규 선임하였고, 제54기 중 설립된 종속기업 (주)희망별숲은 삼정회계법인(KPMG)을, Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ), DOWOOLINSYS VINA COMPANY LIMITED는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 이는 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스씨에스(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자판매(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자로지텍(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
(주)도우인시스	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
지에프(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
(주)미래로시스템	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
에스유머티리얼스(주)	한영회계법인(E&Y)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Deloitte	KPMG
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	Deloitte	KPMG
Samsung International, Inc. (SII)	Deloitte	KPMG
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics GmbH (SEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	Deloitte	KPMG
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	Deloitte	KPMG

Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	Deloitte	KPMG
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Deloitte	KPMG
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Deloitte	KPMG
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Deloitte	KPMG
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Deloitte	KPMG
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Deloitte	KPMG
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	Deloitte	KPMG
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Deloitte	KPMG
Samsung Japan Corporation (SJC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	PwC	KPMG
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	PwC	KPMG
Samsung Research America, Inc (SRA)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	PwC	KPMG
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	PwC	KPMG
Samsung Nanoradio Design Center (SNDG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	PwC	KPMG
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	PwC	KPMG
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	PwC	KPMG
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	PwC	KPMG
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	PwC	KPMG
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	PwC	KPMG
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	PwC	KPMG
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	PwC	KPMG
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	PwC	KPMG
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	PwC	KPMG
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	PwC	KPMG
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	PwC	KPMG
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	PwC	KPMG
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	PwC	KPMG
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	PwC	KPMG
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	PwC	KPMG
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	PwC	KPMG
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	E&Y	KPMG
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	KPP Co., Ltd	KPMG

2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2025년 1분기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2025년 3월 19일 제56기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제56기('24년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

2025년 1분기말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,919,637,922주, 우선주 815,974,664주입니다. 이중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 27,000,000주 및 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(598,772,685주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,293,865,237주입니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	5,919,637,922	-
	우선주	815,974,664	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	27,000,000	자기주식
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	815,974,664	우선주인 자기주식3,725,000주 포함
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	598,329,941	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험(주) 503,904,843주, 삼성화재해상보험(주) 88,058,948주, 삼성복지재단 4,484,150주, 삼성문화재단 1,880,750주, 삼성생명공익재단 1,250주)
	보통주	442,744	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험(주) 특별계정 일부)
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	5,293,865,237	-
	우선주	-	-

※ 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(598,772,685주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

마. 주식사무

구 분	내 용
-----	-----

정관상 신주인수권의 내용	<p>1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다.</p> <p>2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우</p> <p>③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.</p> <p>☞ (주) 제8조 6항 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자) 1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다.</p> <p>2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.</p> <p>☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임·직원(「상법」 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의</p>
---------------	---

	<p>임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 「상법」이 허용하는 한도내에서 「상법」 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임·직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로 하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다.</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.</p> <p>4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다.</p> <p>5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.</p> <p>6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다.</p> <p>7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>① 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우</p> <p>② 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우</p> <p>③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우</p>
결 산 일	12월 31일
정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)
주주의 특전	없음
공고 방법	중앙일보

※ 2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로, 주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

※ 당사는 정관에 의거 중앙일보에 공고하고 있으며, 당사 홈페이지(<https://www.samsung.com/sec/ir>)에도 게재하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2025년 3월 31일)

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용
제56기 정기주주총회 (2025.03.19)	제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 56기 영업성과 및 배당 관련 설명 • 주가관리 등 주주가치 제고 방안 질의응답 • M&A, 사업경쟁력, 관세 관련 질의응답 • 내부회계관리 관련 질의응답
	제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 선임의 건 제2-1-1호: 사외이사 김준성 선임의 건 제2-1-2호: 사외이사 허은녕 선임의 건 제2-1-3호: 사외이사 유명희 선임의 건 제2-1-4호: 사외이사 이혁재 선임의 건 제2-2호: 사내이사 선임의 건 제2-2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건 제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 제2-2-3호: 사내이사 송재혁 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 사외이사 후보 선정 경과 및 사내이사 추천사유 설명 • 사외이사 후보 선정 기준 관련 질의응답 • 여성 이사 및 임원 관련 질의응답 • 글로벌 인재 영입 관련 질의응답
	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
	제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 신재윤 선임의 건 제4-2호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 금융/재정 및 국제통상/법률 전문 감사위원 후보 추천사유 설명 • 감사위원 회계/재무 전문성 관련 질의응답
	제5호 의안 : 사외이사 신재윤 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명
제55기 정기주주총회 (2024.03.20)	제1호 의안 : 제55기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 55기 영업성과 및 배당 관련 설명 • 주주가치 제고 방안 질의응답 • 사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안 : 사외이사 신재윤 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명
	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 조직에서의 감사경력 등 후보 추천사유 설명 • 감사위원이 되는 사외이사 후보의 IT 전문성 및 회계/재무 전문성 관련 의견 등 후보선정에 관한 질의응답
	제4호 의안 : 감사위원회 위원 유명희 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 국제통상 및 법률전문가 등 후보 추천사유 설명 • 감사위원 후보의 회계/재무 전문성 및 감사위원회의 다양성 측면 의견 등 후보선정에 관한 질의응답
	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
	제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 관계법령 및 이사회 산하 위원회 활동 반영 등 정관변경 배경 및 내용 설명
제54기 정기주주총회 (2023.03.15)	제1호 의안 : 제54기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 54기 영업성과 및 배당 관련 설명 • 주주가치 제고 방안 질의응답 • 사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안 : 사내이사 한종희 선임의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 완제품 사업 전반에 대한 리더십 등 후보 추천사유 설명
	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	<ul style="list-style-type: none"> • 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	503,904,843	8.51	시간외매매
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험(주) (특별계정)	최대주주 본인	보통주	5,378,652	0.09	5,395,781	0.09	장내 매매
삼성생명보험(주) (특별계정)	최대주주 본인	우선주	329,788	0.04	301,505	0.04	장내 매매
삼성물산(주)	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.05	-
삼성화재해상보험(주)	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,058,948	1.49	시간외매매
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
삼성생명공익재단	출연 재단	보통주	1,250	0.00	1,250	0.00	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	97,978,700	1.64	97,978,700	1.66	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.65	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	47,745,681	0.80	47,745,681	0.81	-
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	계열회사 임원	보통주	47,290,190	0.79	47,290,190	0.80	-
이서현	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
전영현	계열회사 임원	보통주	0	0.00	17,000	0.00	신규 선임
노태문	계열회사 임원	보통주	28,000	0.00	28,000	0.00	-
송재혁	계열회사 임원	보통주	0	0.00	9,300	0.00	신규 선임
조혜경	계열회사 임원	보통주	500	0.00	500	0.00	-
이혁재	계열회사 임원	보통주	0	0.00	200	0.00	신규 선임
한종희	계열회사 임원	보통주	25,000	0.00	0	0.00	이사 퇴임
이정배	계열회사 임원	보통주	21,800	0.00	0	0.00	이사 임기만료
김한조	계열회사 임원	보통주	6,985	0.00	0	0.00	이사 임기만료
계		보통주	1,198,033,154	20.07	1,193,027,589	20.15	-
		우선주	993,638	0.12	965,355	0.12	-

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.

(단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다. 자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.)

※ 장내매매, 시간외매매 외 지분율 변동은 자사주 매입 및 소각에 따른 변동입니다.

※ 2025년 3월 31일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '주식등의대량보유상황보고서(일반)' 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험주)의 기본정보

1) 법적 · 상업적 명칭: 삼성생명보험주 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사 · 업무집행자 · 최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보 험주	71,090	홍원학	0.00	-	-	삼성물산주	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2025년 3월 31일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역
 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2024.03.21	홍원학	0.00	-	-	-	-

※ 2024년 3월 21일 전영묵 대표이사가 사임하고, 홍원학 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험주)
자산총계	318,858,553
부채총계	287,368,034
자본총계	31,490,519
매출액	8,409,861
영업이익	753,958
당기순이익	677,496

※ 재무현황은 2025년 3월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험주)의 사업현황 등

삼성생명보험주(주)은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

또한, 주요 종속기업인 삼성카드(주)는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성생명보험주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 기본정보

1) 법적 · 상업적 명칭: 삼성물산주 (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사 · 업무집행자 · 최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산주	112,360	오세철	0.00	-	-	이재용	19.93
		정해린	0.00	-	-	-	-
		이재언	0.00	-	-	-	-

※ 2025년 3월 31일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조함원)		업무집행자 (업무집행조함원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2023.03.17	한승환	-	-	-	-	-
2023.03.17	정해린	0.00	-	-	-	-
2023.04.21	-	-	-	-	이재용	18.26
2024.03.15	고정석	-	-	-	-	-
2024.03.15	이재언	0.00	-	-	-	-
2024.04.19	-	-	-	-	이재용	19.06
2025.02.05	-	-	-	-	이재용	19.93

※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각(보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.13%→18.26%)되었습니다.

※ 2024년 3월 15일 고정석 대표이사가 사임하고, 이재언 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2024년 4월 19일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.26%→19.06%)되었습니다

※ 2025년 2월 5일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(19.06%→19.93%)되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산주
자산총계	62,457,981
부채총계	24,124,122
자본총계	38,333,859
매출액	9,736,781
영업이익	724,421
당기순이익	937,243

※ 재무현황은 2025년 3월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 사업현황 등

삼성물산주는 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성물산주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2025.03.31)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주 와의 관계	재직기 간	임기 만료일
								의결권 있는 주 식	의결권 없는 주 식			
전영현	남	1960.12	부회장	사내이사	상근	· 대표이사 (DS부문 경영전반 총괄)	· KAIST 전자공학 박사 · 삼성전자 DS부문장 경)메모리사업부장, SAIT원장	17,000	-	계열회사 임원	1개월	2028.03.18
노태문	남	1968.09	사장	사내이사	상근	· DX부문장 직무대행 · MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 DX부문장 직무대행 경) MX사업부장, 품질혁신위원장	28,000	-	계열회사 임원	37개월	2028.03.15
송재혁	남	1967.08	사장	사내이사	상근	· DS부문 CTO	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 DS부문 CTO 경) 반도체연구소장	9,300	-	계열회사 임원	1개월	2028.03.18
신재윤	남	1958.03	이사	사외이사	비상근	· 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 사외이사 후보추천 위원회 위원장 · 보상위원회 위원장 · 지속가능경영 위원회 위원	· 서울대 경제학 학사 · 금융위원회 위원장	-	-	계열회사 임원	13개월	2027.03.28
김준성	남	1967.10	이사	사외이사	비상근	· 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영 위원회 위원장	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르 투자청 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	37개월	2028.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외이사	비상근	· 사외이사 후보추천 위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영 위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박 사 · 서울대 공과대학 교수	-	-	계열회사 임원	29개월	2028.03.18
유명희	여	1967.06	이사	사외이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 사외이사 후보추천 위원회 위원 · 지속가능경영 위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장	-	-	계열회사 임원	29개월	2028.03.18

조혜경	여	1964.07	이사	사외이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 로봇공학 박사 · 한성대 Si응용학과 교수	500	-	계열회사 임원	13개월	2027.03.19
이혁재	남	1965.02	이사	사외이사	비상근	· 내부거래위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Perdue대 전자컴퓨터공학 박사 · 서울대 전기정보공학부 교수	200	-	계열회사 임원	1개월	2028.03.18

- ※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.
- ※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 2024년 3월 20일 정기주주총회에서 신재윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 이사가 신규 선임되었으며, 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고,
- 신재윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 3월 20일 김선욱 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2024년 3월 22일 김종훈 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2024년 7월 29일 신재윤 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 12월 26일 박학규 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2025년 3월 19일 주주총회에서 전영현 사내이사, 송재혁 사내이사, 이혁재 사외이사가 신규 선임되었으며, 노태문 사내이사, 김준성 사외이사, 허은녕 사외이사, 유명희 사외이사가 재선임되었으며, 신재윤 사외이사, 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 당일 개최된 이사회를 통해 전영현 사내이사, 노태문 사내이사와, 송재혁 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었고, 김준성 사외이사가 내부거래위원회,
- 보상위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 허은녕 이사는 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 유명희 사외이사는 사외이사 후보추천위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 이혁재 사외이사는 내부거래위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2025년 3월 19일 김한조 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2025년 3월 25일 한종희 (전)대표이사(2022년 2월 선임)는 대표이사직과 사내이사직을 당연퇴임하였습니다.
- ※ 작성기준일 이후 2025년 4월 28일 신재윤 사외이사가 감사위원회, 보상위원회 위원장으로, 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 작성기준일 이후 2025년 4월 29일 김준성 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
유명희	사외이사	HD현대건설기계	사외이사	2022년~현재
조혜경	사외이사	현대건설	사외이사	2021년~현재

다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일)

(단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관계인	
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
고크리스 토포한승	남	1963.04	사장	상근	미래사업기획단장	삼성바이오에피스 대표이사	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	5
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	55
김용관	남	1963.12	사장	상근	경영전략담당	사업지원T/F 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	사장	상근	Global Public Affairs실장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	Foundry CTO	제조&기술담당	연세대(박사)	계열회사 임원	
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산, 건설부문 커뮤니 케이션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	28
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박학규	남	1964.11	사장	상근	사업지원T/F 담당임원	경영지원실장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션실장	커뮤니케이션팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	
안중현	남	1963.03	사장	상근	경영지원실 담당임원	SGR, 미래산업연구본부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	12
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국삼성전자협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
염대현	남	1966.03	사장	상근	법무실 담당임원	법무실 송무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	사장	상근	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	브랜드전략위원	글로벌마케팅실장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이원진	남	1967.08	사장	상근	글로벌마케팅실장	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor (박사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산, 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	28
한진만	남	1966.10	사장	상근	Foundry사업부장	DS부문 DSA총괄	서울대(학사)	계열회사 임원	
강동구	남	1976.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
강동훈	남	1970.12	부사장	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강석채	남	1971.06	부사장	상근	Foundry 전략마케팅실장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강신봉	남	1970.01	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터장	위대한상상, CEO	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	27
강태우	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	
강희성	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고대근	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	

고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	유럽총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	반도체연구소 Logic TD실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
권오경	남	1977.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	제조&기술담당 Foundry 제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권혁준	남	1971.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당Master	성균관대(석사)	계열회사 임원	5
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research AI센터장	Samsung Research Global AI센터장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	40
김동욱	남	1969.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI SOC사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜즈센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	Foundry People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김상우	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	14
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	

김성은	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(학사)	계열회사 임원	
김성한	남	1970.05	부사장	상근	Foundry Global운영팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연정	남	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스, 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	45
김용성	남	1973.09	부사장	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material 연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김용수	남	1971.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀장	Google, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	16
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 Next Product팀장	영상디스플레이 개발팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김우평	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-PKG 연구소장	TSP총괄 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	33
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원호	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	14
김은종	남	1965.06	부사장	상근	System LSI Global운영팀장	S.LSI Global Operation실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	아주대(학사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS, 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
김일룡	남	1974.02	부사장	상근	System LSI 제품기술팀장	S.LSI Global Operation실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기 술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부로 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SEIB법인장	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	Mobile eXperience CX실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종훈	남	1969.12	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience Galaxy Value Innovation팀장	Mobile eXperience 품질혁 신센터장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준석	남	1972.10	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI Project Management팀장	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김중정	남	1973.11	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터장	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	
김지윤	여	1975.02	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	

김창업	남	1969.08	부사장	상근	동남아총괄	SEDA-S판매부부장	한양대(학사)	계열회사 임원	
김창태	남	1972.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설 비기술연구소장	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김평진	남	1973.12	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	연세대(학사)	계열회사 임원	
김학상	남	1966.09	부사장	상근	Global CS센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기 술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형로	남	1973.01	부사장	상근	영상디스플레이 People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	40
김형재	남	1970.12	부사장	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	베트남삼성전략협력실장	People팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
노경래	남	1976.12	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	38
데이브다 스	남	1975.06	부사장	상근	SEA 담당임원	SEIB법인장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	50
류경동	남	1970.01	부사장	상근	AI센터 담당임원	SAIT System Research Center장	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	19
마크리퍼 트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 담당임원	북미총괄 대외협력팀장	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	37
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School (학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생산기술연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	

박건대	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	49
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	SEVT법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박세근	남	1974.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박수남	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	
박순철	남	1966.07	부사장	상근	경영지원실장	지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
박재성	남	1971.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
박정미	여	1968.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜 드센터 담당임원	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	51
박정호	남	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정호	남	1974.11	부사장	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터장	연세대(박사)	계열회사 임원	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실장	Univ. of California, Berkeley (박사)	계열회사 임원	
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센 터 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬홍	남	1972.10	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Sr.Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	4
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
박태상	남	1975.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박현정	남	1969.12	부사장	상근	DS부문 기획팀 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제 조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
반효동	남	1967.06	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
발라지	남	1969.09	부사장	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배승준	남	1976.03	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
배일환	남	1970.07	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	부사장	상근	신사업팀장	신사업T/F장	서울대(석사)	계열회사 임원	

부민혁	남	1973.06	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	
서보철	남	1972.01	부사장	상근	SIEL-P(N)법인장	Mobile eXperience Global운영팀장	동국대(학사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	부사장	상근	DS부문 IP팀장	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	52
서정아	여	1971.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서한석	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
성덕용	남	1973.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설 비기술연구소 담당임원	제조&기술담당 설비기술연 구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	복미총괄 지원팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/ 인프라센터장	아주대(박사)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜 드센터 담당임원	TSE-S법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
송방영	남	1974.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	
송병무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터장	TSP총괄 TP센터장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	AI센터장	메모리 Solution개발실장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 C.PKG개발팀장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley (박사)	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터장	제조&기술담당 메모리제조 기술센터장	Univ. of California, Berkeley (박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승원	남	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	51
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	

신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소장	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	Technical Univ. of Munich(박 사)	계열회사 임원	19
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience People팀장	영상디스플레이 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심재현	남	1972.01	부사장	상근	생활가전 지원팀장	지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안유정	여	1974.08	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Waymo, Head of Design	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	17
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 경영진단팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양병덕	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양익준	남	1969.11	부사장	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양준철	남	1972.06	부사장	상근	생활가전 구매팀장	생활가전 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 MDE전략팀장	생활가전 Global CS팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄재훈	남	1966.06	부사장	상근	상생협력센터장	DS부문 DS대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여태정	남	1970.06	부사장	상근	하만협력팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	혁신센터장	서울대(석사)	계열회사 임원	
오재균	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 지원팀장	System LSI 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	TSP총괄 지원팀장	淸華大(석사)	계열회사 임원	
오충훈	남	1969.10	부사장	상근	System LSI 지원팀장	메모리 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 개인정보보호팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(석사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종욱	남	1962.10	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	연세대, 교수	가톨릭대(박사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	생활가전 선행개발팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	28
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 S/W개발팀장	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	SEDA-S법인장	SEA 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유상민	남	1973.09	부사장	상근	System LSI IP개발팀장	System LSI SOC사업팀 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	52

유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	53
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	36
윤영조	남	1975.02	부사장	상근	Global Public Affairs실 담 당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤주한	남	1970.05	부사장	상근	중동총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	하만협력팀장	전장사업팀장	건국대(박사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄, CSO	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤하룡	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이귀호	여	1975.05	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 Principal Professional	이화여대(박사)	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(박사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이대성	남	1970.09	부사장	상근	중국총괄	SCIC 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	52
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	Global CS센터 담당임원	생활가전 CX팀장	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조센터장	SEVT법인장	부산대(박사)	계열회사 임원	
이병원	남	1972.05	부사장	상근	IR팀 담당임원	기획재정부, 부이사관	Indiana Univ., Bloomington(석 사)	계열회사 임원	17
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1973.04	부사장	상근	영상디스플레이 CX팀장	BT Group, CDO	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	5
이상원	남	1971.07	부사장	상근	경영진단팀장	서남아총괄 지원팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	유럽총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담 당임원	SELA법인장	한국외국어대(박사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	부사장	상근	DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(박사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	32
이석원	남	1970.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설 비기술연구소 담당임원	제조&기술담당 설비기술연 구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
이승엽	남	1968.08	부사장	상근	아프리카총괄	SEIN-S법인장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	메모리 Flash개발실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	

이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁 신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado, Boulder(석 사)	계열회사 임원	49
이영수	남	1972.01	부사장	상근	생산기술연구소장	SEVT 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영웅	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담 당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	24
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명, 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이월환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience 디자인 팀장	Mobile eXperience CX실 담 당임원	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	28
이재범	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 기획팀장	영상디스플레이 기획팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI사업팀장	System LSI LSI개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이정삼	남	1967.06	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정권	남	1977.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 담 당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	51
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	27
이제석	남	1969.01	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	18
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	글로벌마케팅실 CX센터장	디바이스플랫폼센터 담당임 원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	AI센터 담당임원	System LSI SOC사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종호	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry 기술개발실 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이주형	남	1972.08	부사장	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀장	Samsung Research 차세대 가전연구팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	Global EHS실장	생활가전 CX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 경영진단팀장	메모리 Flash개발실 담당임 원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 전략마케팅팀 담당임 원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산, 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석 사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	부사장	상근	SRA 담당임원	TSP총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	54
이현	남	1969.02	부사장	상근	SEIN-S법인장	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이현	남	1971.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀장	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이형우	남	1970.03	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장(Co)	북미총괄 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	

이화성	남	1970.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권, 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	40
임성수	남	1978.11	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
임성택	남	1966.06	부사장	상근	한국총괄	중동총괄	연세대(학사)	계열회사 임원	
임성택	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당 임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장성환	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	Interpublic Group, EVP	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	10
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀장	기획팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	28
장소연	여	1971.06	부사장	상근	한국총괄 마케팅팀장	한국총괄 마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당 임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀장	Mobile eXperience 전락기 획팀장	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	28
전신애	여	1973.08	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	SAIT Material Research Center 담당Master	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
전필규	남	1968.11	부사장	상근	창의개발센터장	삼성경제연구소, 리더십팀장	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	16
정성택	남	1976.09	부사장	상근	DS부문 기획팀 담당임원	미래사업기획단 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	32
정승욱	남	1969.05	부사장	상근	중국삼성전략협력실 담당임 원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	북미총괄	Mobile eXperience 전락마 케팅실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임 원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	29
정진국	남	1975.10	부사장	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁 신센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 담 당임원	Univ. of Southern California(박 사)	계열회사 임원	52
정혜순	여	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	남	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	

조기열	남	1971.03	부사장	상근	법무실 법무팀장	삼성디스플레이, 법무실장	경찰대(학사)	계열회사 임원	16
조기재	남	1967.01	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀장	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조영호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	영상디스플레이 기획팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	DS부문 DSA 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	유럽총괄	중동총괄	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1970.11	부사장	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	건국대(박사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀장	People팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	수원지원센터장	북미총괄 People팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성SDI, 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	36
조인하	여	1974.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스, 고객지원실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 삼성협력센터장	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(석사)	계열회사 임원	
차경환	남	1972.04	부사장	상근	중동총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	43
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최권영	남	1971.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 중소형 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	4
최동준	남	1972.05	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
최병희	남	1970.05	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	52
최성현	남	1970.05	부사장	상근	네트워크 선행개발팀장	Samsung Research 차세대 통신연구센터장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	부사장	상근	SIEL-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	삼성협력센터 담당임원	삼성생명, 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	28

최원우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라설비자동화T/F장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최재인	남	1976.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Director	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	1
최주호	남	1963.03	부사장	상근	People팀內	베트남삼성전략협력실장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀장	DSRA-Memory 연구소장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	AI센터 담당임원	SAIT AI Research Center장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
파트릭쇼 메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임 원	Mobile eXperience CX실장	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
편정우	남	1970.10	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	메모리 품질실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
한성숙	여	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
함선규	남	1970.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	중남미총괄 지원팀장	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허성희	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
현상진	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
홍경선	남	1970.08	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
홍기재	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	계열회사 임원	45
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센 터장	아프리카총괄	중앙대(학사)	계열회사 임원	
홍석준	남	1970.07	부사장	상근	CSS사업팀장	CSS사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	22
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	반도체연구소 메모리 TO실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터장	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담 당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영 팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Research Center장	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사 임원	22
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	메모리 전략마케팅실 담당임 원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황완구	남	1972.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
황인철	남	1977.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
황대환	남	1968.04	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	한국총괄 CE팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황희돈	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TO실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

강건혁	남	1978.11	상무	상근	DSRA-S.LSI 담당임원	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	43
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
강동우	남	1971.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터장	한양대(석사)	계열회사 임원	
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	28
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	40
강상용	남	1972.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	전자사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK Principal Professional	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	48
강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청, 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	21
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	40
강정대	남	1970.09	상무	상근	육상연행(파견)	재경팀 담당임원	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	
강종호	남	1974.12	상무	상근	SELV법인장	SEAD법인장	인하대(석사)	계열회사 임원	5
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 Principal Professional	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	40
강태형	남	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Dell, Director	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	20
강혁	남	1984.10	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	28
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
고상도	남	1975.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	5
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	28
고알시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	56
고익중	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	Compliance팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	40
고정욱	남	1976.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 MX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
고종현	남	1981.01	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀 Principal Engineer	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	5
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
고택균	남	1971.05	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	52

고현목	남	1980.02	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	16
공병진	남	1971.09	상무	상근	SEM-P법인장	SIEL-P(C)공장장	항공대(학사)	계열회사 임원	52
곽원근	남	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	16
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당 임원	System LSI LSI개발실 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	45
구윤본	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 연 구라인기술팀장	제조&기술담당 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1972.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 Principal Legal Counsel	서울대(학사)	계열회사 임원	52
권기덕	여	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략기 획팀장	기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	52
권기록	남	1974.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	17
권기성	남	1975.01	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	17
권민호	남	1975.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	5
권영재	남	1972.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁 신센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	52
권영호	남	1973.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	5
권영훈	남	1972.02	상무	상근	SEA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	45
권육	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜 드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담 당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
권정현	남	1980.03	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager	서울대(박사)	계열회사 임원	26
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEHC법인장	생활가전 Global제조팀 담당 임원	포항공대(학사)	계열회사 임원	52
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI SOC사업팀 담 당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
권혁우	남	1973.07	상무	상근	Global Public Affairs실 담 당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	33
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	52
김건우	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SESK 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	40
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 상품기획실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	40
김경태	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	52
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임 원	한국총괄 IMC팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	28

김경택	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Designer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	16
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업 장 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	40
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)법인장	SEDA-P(C)공장장	인하대(학사)	계열회사 임원	28
김기수	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임 원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	28
김기연	남	1972.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	DS부문 DSC 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	28
김길섭	남	1979.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	5
김대신	남	1970.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CSE팀장	혁신센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김대우	남	1970.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담 당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SME법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	28
김덕현	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 S/W개발팀 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김도기	남	1975.05	상무	상근	People팀 담당임원	DS부문 CTO People팀장	송실대(학사)	계열회사 임원	28
김도형	남	1977.05	상무	상근	SAIT People팀장	SCS Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	5
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	40
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	40
김동수	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	5
김동준	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담 당임원	제조&기술담당 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김두현	남	1976.10	상무	상근	SEROM법인장	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	5
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI 기반설계실 담 당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	48
김릉	남	1971.12	상무	상근	생활가전 People팀장	People팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	52
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	52
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	40
김문수	남	1977.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담 당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	52
김민성	남	1975.02	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	삼성SDI, 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	4
김민우	남	1978.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	TSE-S 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	52
김범준	남	1977.03	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F Principal Professional	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	16

김병진	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience Galaxy Value Innovation팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김병승	남	1976.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	17
김보창	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	28
김봉수	남	1971.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	52
김상윤	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	52
김상준	남	1976.10	상무	상근	SEG 담당임원	지원팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	5
김상하	여	1981.01	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	5
김상현	남	1978.10	상무	상근	SEI 담당임원	SEB법인장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	16
김석영	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	17
김선기	남	1973.11	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	13
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	28
김선정	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	40
김성민	남	1976.03	상무	상근	네트워크 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	40
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김성현	남	1977.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	5
김성훈	남	1977.02	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	5
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	28
김세훈	남	1975.01	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	28
김수연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	16
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 Principal Professional	단국대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	단국대(석사)	계열회사 임원	52

김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당 임원	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 제품기술팀장	Foundry 기술개발실 담당임 원	동국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	40
김영상	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 Principal Professional	Indiana Univ., Bloomington(석 사)	계열회사 임원	5
김영아	여	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	Adidas, VP	이화여대(학사)	계열회사 임원	8
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	22
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	28
김영정	남	1972.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
김영주	남	1973.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	40
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	28
김용관	남	1976.04	상무	상근	IR팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당 임원	DS부문 DSA 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	52
김용완	남	1970.04	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	메모리 Global운영팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
김용찬	남	1969.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	40
김용훈	남	1972.11	상무	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	52
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
김우일	남	1978.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC사업팀 Principal Engineer	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	5
김원경	남	1975.03	상무	상근	SEEG-P법인장	영상디스플레이 Global제조 팀 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	5
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	경북대(석사)	계열회사 임원	40
김원우	남	1970.03	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	SEDA-S 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEI법인장	SEAU법인장	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유나	여	1979.01	상무	상근	Samsung Research 기술전 략팀 담당임원	SRPOL연구소장	포항공대(박사)	계열회사 임원	40
김유승	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Intuitive, Staff Engineer	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	15
김윤재	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	52
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	단국대(학사)	계열회사 임원	
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	28
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Engineer	Univ. of Southern California(석 사)	계열회사 임원	52

김의송	남	1978.05	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	한동대(학사)	계열회사 임원	5
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담 당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	28
김인철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담 당임원	DX부문 경영지원실 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	17
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김재관	남	1976.01	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	SRA 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	16
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김재윤	남	1970.07	상무	상근	하만협력팀 담당임원	전자사업팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	52
김재현	남	1977.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	5
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	52
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	28
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박 사)	계열회사 임원	42
김정수	남	1983.09	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담 당임원	Qualcomm, Principal	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	15
김정현	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	29
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전자사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종현	남	1972.12	상무	상근	중동총괄 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 Principal Professional	세종대(학사)	계열회사 임원	16
김종현	남	1975.11	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담 당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	16
김중희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	NXP, Principal	포항공대(박사)	계열회사 임원	17
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임 원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	28
김준성	남	1975.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	28
김준연	남	1973.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	삼성디스플레이, 디스플레이 연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	12
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SERK법인장	SEHC 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA Principal Professional	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	28
김지훈	남	1971.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	한국총괄 B2B통합오퍼링센 터 담당임원	서강대(박사수료)	계열회사 임원	40
김지훈	남	1975.06	상무	상근	SENA법인장	SENA Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	5
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남북한단지 Principal Professional	경찰대(학사)	계열회사 임원	40

김진기	남	1972.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	40
김진만	남	1978.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	동아대(석사)	계열회사 임원	5
김진욱	남	1977.11	상무	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀 담당임원	Boltech, 대표이사	고려대(학사)	계열회사 임원	2
김진철	남	1976.11	상무	상근	SEVT 담당임원	Mobile eXperience People팀 Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	5
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	28
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIB 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	52
김창수	남	1975.11	상무	상근	SME법인장	SENZ법인장	Univ. of Texas Arlington(석사)	계열회사 임원	5
김창용	남	1973.04	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SAIT People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	40
김철주	남	1976.07	상무	상근	Samsung Research 담당임원	SRUK연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	28
김철희	남	1977.04	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 기획팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	5
김태경	남	1971.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	23
김태균	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	40
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	47
김태영	남	1976.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Kanazawa Univ.(박사)	계열회사 임원	17
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀장	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김태정	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	52
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 디자인 팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	52
김한조	남	1973.09	상무	상근	의료기기 지원팀장	SEA Principal Professional	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	16
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEF 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	40
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	40
김현기	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	28
김현덕	남	1981.06	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	27

김현석	남	1976.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	40
김현수	남	1970.09	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SR 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현중	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	52
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 유통전략팀장	한국총괄 e-Commerce팀장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김형수	남	1975.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 Principal Engineer	서강대(석사)	계열회사 임원	5
김형욱	남	1979.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개 발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	17
김형준	남	1972.05	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	숭실대(석사)	계열회사 임원	40
김호균	남	1968.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	중남미총괄 대외협력팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 디자인 팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담 당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI 품질팀장	System LSI Global Operation실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김훈식	남	1981.07	상무	상근	Mobile eXperience 담당임 원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	17
김희승	남	1970.09	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임 원	System LSI People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희열	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	17
나원만	남	1975.06	상무	상근	SEM-P 담당임원	SEM-P Principal Professional	영남대(학사)	계열회사 임원	16
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
남경인	남	1973.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
남덕우	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	17
남인호	남	1975.06	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 Principal Professional	건국대(학사)	계열회사 임원	5
남정만	남	1967.06	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당 임원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
남태호	남	1969.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 경영지원실 담당임 원	경북대(박사수료)	계열회사 임원	21
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	43
노대용	남	1978.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	5
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당 임원	DS부문 DSA 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
노성원	남	1971.03	상무	상근	People팀 담당임원	삼성바이오에피스, 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	5
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담 당임원	생활가전 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	52
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	52

다니엘아 라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기 획팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	28
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	52
류일근	남	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 구미지 원센터장	SEVT 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류철우	남	1975.04	상무	상근	SEF 담당임원	지원팀 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	5
류호열	남	1977.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당 임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	한국과학기술원(박사수료)	계열회사 임원	5
류효경	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	53
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	MIT(석사)	계열회사 임원	
명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당 임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
명승일	남	1976.11	상무	상근	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	16
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 담당임원	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문광진	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	5
문석진	남	1974.06	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	계명대(학사)	계열회사 임원	17
문성만	남	1976.07	상무	상근	기획팀 담당임원	Siemens Health, Power Archi	Univ. of Utah(박사)	계열회사 임원	1
문준기	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SEA 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
문진욱	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	
문태호	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 품질팀장	동아대(학사)	계열회사 임원	17
문태화	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	경희대(학사)	계열회사 임원	5
박영훈	남	1975.09	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	생활가전 지원팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	5
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	52
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	28
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI Custom SOC사 업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
박봉태	남	1974.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
박상교	남	1972.03	상무	상근	Compliance팀 담당임원	중국상성전략협력실 담당임 원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상도	남	1973.12	상무	상근	People팀 담당임원	복미총괄 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박성영	남	1976.01	상무	상근	유럽총괄 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	16

박상욱	남	1978.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	17
박상욱	남	1975.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	경북대(석사)	계열회사 임원	5
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개 발실 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	40
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	40
박성우	남	1976.04	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. Of Chicago(석사)	계열회사 임원	16
박승일	남	1976.01	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	5
박영민	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	16
박은중	남	1976.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	16
박일한	남	1976.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	5
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	서울대(학사)	계열회사 임원	52
박재범	남	1977.08	상무	상근	메모리 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	40
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	28
박재현	남	1975.06	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임 원	화재 국내법무그룹 변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	5
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 글로벌브랜 드센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	52
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라품질분석팀장	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
박정일	남	1976.08	상무	상근	한국총괄 유통전략팀 담 임원	한국총괄 유통전략팀 Principal Professional	인하대(학사)	계열회사 임원	5
박정재	남	1974.01	상무	상근	재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 Principal Professional	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담 임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	40
박종민	남	1968.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담 임원	Western Digital, Director	한국과학기술원(학사)	계열회사 임원	15
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담 임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	40
박준수	남	1967.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	31
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담 임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	52
박준호	남	1972.05	상무	상근	글로벌마케팅실 CX센터 담 임원	Mobile eXperience CX실 담 임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진표	남	1972.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담 임원	DS부문 DSA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

박찬형	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	28
박창서	남	1980.06	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	49
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience 담당임 원	연세대(학사)	계열회사 임원	40
박충신	남	1973.09	상무	상근	People팀 담당임원	의료기기 People팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	52
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	40
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
박현준	남	1978.01	상무	상근	People팀 담당임원	구주총괄 People팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	28
박형민	남	1977.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	SEA 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	52
박형신	여	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 디자인 팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담 당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	16
박혜린	여	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	Mobile eXperience 전략마 케팅실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	5
박호우	남	1971.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담 당임원	제조담당 Foundry제조기술 센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	40
박환홍	남	1973.10	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	16
박훈철	남	1974.05	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	40
반수형	남	1972.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	28
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담 당임원	SEJ Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI 기반설계실 담 당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	
배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	28
배상기	남	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
배윤수	남	1974.12	상무	상근	재경팀 담당임원	기획팀 Principal Professional	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	16
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	52
백기열	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS, 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	28
백상훈	남	1976.01	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개 발실 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	5
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대 가전연구팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	40
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	
백혜성	여	1980.02	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담 임원	연세대(학사)	계열회사 임원	16
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	우선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
서경현	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	40
서상원	남	1979.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	Apple, Engineer/Manager	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	29

서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기 술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
서재홍	남	1974.03	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 Principal Professional	아주대(석사)	계열회사 임원	5
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	40
서정현	남	1974.04	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	SCS 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
서창우	남	1974.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEF 담당임원	Manchester(석사)	계열회사 임원	28
서지영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	Univ. of Southern California(박 사)	계열회사 임원	37
서현석	남	1974.06	상무	상근	경영진단팀 담당임원	감사팀 Principal Professional	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	16
석지원	여	1980.06	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅 팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	5
선동석	남	1974.04	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
선종우	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	17
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 담 당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기 술센터 Principal Engineer	한양공고(고교)	계열회사 임원	40
성중훈	남	1978.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	5
소재민	남	1983.04	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
손석재	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Nike, Director	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	11
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담 당임원	생활가전 개발팀 담당임원	전남대(석사)	계열회사 임원	52
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global운영팀 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	40
손영아	여	1973.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담 당임원	SELA Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	28
손왕익	남	1984.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
손용우	남	1968.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
손준호	남	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	28
손현석	남	1976.03	상무	상근	SAMEX법인장	SEH-P법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	28
손호민	남	1969.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임 원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
손호성	남	1968.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담 당임원	생활가전 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	

송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	52
송명숙	여	1972.11	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당 임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송문경	여	1977.08	상무	상근	글로벌 마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌 마케팅실 D2C센터 Principal Professional	한동대(학사)	계열회사 임원	16
송보영	여	1976.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	28
송상철	남	1973.09	상무	상근	글로벌 마케팅실 Big Data센 터장	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	49
송승호	남	1981.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Professional	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	5
송영근	남	1970.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	Intel, Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	27
송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 Principal Professional	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	28
송윤종	남	1971.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 Principal Professional	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
송정우	남	1977.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임 원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	28
송정은	여	1976.12	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담 당임원	Mobile eXperience 마케팅 팀 Principal Professional	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	5
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당 임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송택상	남	1978.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	Rambus, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	14
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
세인혁비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
시티측	남	1972.11	상무	상근	TSE-S 담당임원	TSE-S VP	Georgia State Univ.(석사)	계열회사 임원	5
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁 신센터 담당임원	무선 Global CS팀 Principal Professional	부산대(학사)	계열회사 임원	52
신대중	남	1971.11	상무	상근	SEDA-P(M)법인장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
신무섭	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEV Principal Professional	경희사이버대(학사)	계열회사 임원	5
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	한국해양대(학사)	계열회사 임원	28
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	52
신병무	남	1970.08	상무	상근	SEEG-S법인장	SEGR법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	16
신상용	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 펌웨어팀 담 당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	28
신승주	남	1972.04	상무	상근	SEASA법인장	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
신용우	남	1974.12	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	40
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	28

신익창	남	1971.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 Principal Professional	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	52
신재영	남	1974.07	상무	상근	SECA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	5
신현석	남	1969.05	상무	상근	신사업팀 담당임원	신사업T/F 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
심승환	남	1974.04	상무	상근	글로벌 마케팅실 D2C센터 담당임원	Apple, Sr. Development Manager	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	22
심우철	남	1982.06	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	30
심재황	남	1975.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	5
심호준	남	1977.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 상품기획실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	40
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	52
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 유통전략팀 담당임원	한국총괄 CE팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	52
안덕민	남	1974.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	5
안성준	남	1975.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
안승환	남	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
안신현	남	1972.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	40
안영모	남	1973.10	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	경북대(학사)	계열회사 임원	16
안용석	남	1974.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	28
안재용	남	1977.02	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	감사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	28
안주원	여	1977.03	상무	상근	하만협력팀 담당임원	생활가전 기획팀 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	28
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	42
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	성균관대(학사)	계열회사 임원	28
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	28
양시준	남	1974.01	상무	상근	총남미총괄 지원팀장	네트워크 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	52
양종훈	남	1974.05	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	28

양진기	남	1971.05	상무	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전 략팀 담당임원	Samsung Research 기술전 략팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience UX팀장	Mobile eXperience CX실 담 당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
영훈섭	남	1975.06	상무	상근	SEV 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 Principal Professional	항공대(학사)	계열회사 임원	5
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	40
영강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	52
영부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	40
영충범	남	1977.06	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	Mobile eXperience People팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	28
예장희	남	1975.12	상무	상근	SECH법인장	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	5
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	40
오상진	남	1977.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	40
오석민	여	1974.07	상무	상근	Mobile eXperience UX팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담 당임원	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	
오성혁	남	1971.09	상무	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀 담당임 원	삼성화재, 일반보험전략팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	4
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 Principal Professional	충남대(학사)	계열회사 임원	28
오용찬	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	28
오정환	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	28
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 C.PKG개발팀 담 당임원	TSP총괄 Package개발실 담 당임원	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	52
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	부산대(석사)	계열회사 임원	
오형석	남	1970.09	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
옥신우	남	1978.05	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	5
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석 사)	계열회사 임원	40
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Designer	홍익대(학사)	계열회사 임원	28
우람찬	남	1978.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	System LSI 기획팀 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
우준영	남	1980.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	17

우현수	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	17
우형동	남	1970.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당 임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원석준	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 Principal Engineer	서강대(박사)	계열회사 임원	40
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	43
유성중	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당 임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	28
유성호	남	1973.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 지원팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	40
유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	40
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
유한중	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	SEF 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	52
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당 임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	인하대(석사)	계열회사 임원	
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	34
윤기영	남	1974.11	상무	상근	SEBN법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	16
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	이화여대(석사)	계열회사 임원	40
윤상용	남	1976.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	17
윤석진	남	1968.11	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	50
윤석호	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	한국기계연구원, 열에너지솔루션실장	서울대(박사)	계열회사 임원	27
윤석호	남	1972.07	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤성국	남	1974.06	상무	상근	유럽총괄 담당임원	인사팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	40
윤성현	남	1973.05	상무	상근	SIEL-P(C)법인장	SIEL-P(C)공장장	부산대(학사)	계열회사 임원	16
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당 임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사 임원	27
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Engineer	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	28
윤송호	남	1974.10	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당 임원	광운대(학사)	계열회사 임원	40
윤승국	남	1977.10	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	Cruise, Staff S/W Engineer	MIT(박사)	계열회사 임원	2

윤승욱	남	1970.01	상무	상근	System LSI 제품기술팀 담당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
윤원재	남	1975.08	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	5
윤원주	남	1978.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	17
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 Principal Professional	영남대(학사)	계열회사 임원	
윤창빈	남	1977.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	5
윤철중	남	1970.07	상무	상근	SEUK법인장	SELV법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	
윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	
은성민	남	1977.01	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	28
은형래	남	1974.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	5
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global운영팀 담당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
이강호	남	1977.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Global Foundries, Principal Member of Technical Staff	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	16
이경우	남	1977.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	5
이경준	남	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	52
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	40
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 SMB팀장	한국총괄 B2B팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	40
이광열	남	1974.11	상무	상근	지원팀 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	40
이광재	남	1974.03	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	16
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 Principal Professional	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	
이규철	남	1973.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	서울산업대(학사)	계열회사 임원	16
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	세종대(학사)	계열회사 임원	
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
이남호	남	1972.02	상무	상근	AI센터 담당임원	DS부문 재경팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	51
이동진	남	1971.01	상무	상근	SEH-P법인장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	52
이동하	남	1968.07	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
이두환	남	1976.12	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	동국대(학사)	계열회사 임원	5
이두희	남	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	28

이명재	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	HEC Paris(석사)	계열회사 임원	16
이명준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	17
이문근	남	1976.08	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(학사)	계열회사 임원	5
이민	남	1978.03	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	12
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이병국	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	5
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	28
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임 원	DS부문 법무지원팀 Principal Legal Counsel	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	52
이병철	남	1972.11	상무	상근	의료기기 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	40
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	28
이병현	남	1974.11	상무	상근	기획팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	Manchester Business Sch.(석 사)	계열회사 임원	40
이병현	남	1977.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	17
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 MDE전략팀 담당 임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	40
이보람	여	1973.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당 임원	World Bank, Senior Consultant	Univ. of Paris 6(박사)	계열회사 임원	11
이상빈	남	1979.02	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담 당임원	생활가전 Global제조팀 Principal Professional	한양대(석사)	계열회사 임원	5
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	52
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀 담당 부장	서울대(학사)	계열회사 임원	28
이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담 당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁 신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상희	남	1974.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	40
이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당 임원	Univ. of Southern California(석 사)	계열회사 임원	40
이선교	남	1976.01	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	5
이선웅	남	1976.12	상무	상근	SERC 담당임원	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	16
이선일	남	1978.02	상무	상근	SRUK연구소장	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	5

이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	40
이성원	남	1976.03	상무	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	42
이성준	남	1981.10	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(학사)	계열회사 임원	18
이성진	남	1979.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Amazon, Principal Scientist	포항공대(박사)	계열회사 임원	8
이성훈	남	1975.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	28
이수용	남	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당Master	한양대(석사)	계열회사 임원	32
이승욱	남	1973.09	상무	상근	한국총괄 People팀장	SAIT People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
이승민	남	1981.03	상무	상근	Mobile eXperience UX팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	18
이승준	남	1974.04	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	28
이승철	남	1977.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	21
이승철	남	1975.12	상무	상근	영상디스플레이 Global운영 팀장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	52
이승환	남	1971.05	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	LED사업팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	40
이승환	남	1980.07	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	16
이승훈	남	1976.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	28
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	
이영아	여	1983.03	상무	상근	생활가전 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 Principal Designer	Carnegie Mellon Univ.(학사)	계열회사 임원	16
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영학	남	1974.09	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	28
이우용	남	1975.10	상무	상근	지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	28
이원용	남	1978.11	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	28
이윤경	여	1979.09	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센터 담당임원	Big Data센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	52
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Samsung Research AI센터 Principal Engineer	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	52
이의형	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	28
이인학	남	1975.05	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	DS부문 상생협력센터 Principal Professional	광운대(석사)	계열회사 임원	5
이재영	남	1974.11	상무	상근	네트워크 People팀장	사업지원T/F 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이재호	남	1974.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	서강대(석사)	계열회사 임원	16

이재훈	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SERC 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	40
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임 원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	52
이정자	여	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메 모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정주	남	1976.07	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	P&G, Sr. Director	고려대(학사)	계열회사 임원	21
이정호	남	1974.11	상무	상근	People팀 담당임원	한국총괄 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	40
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	29
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당 임원	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담 당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이종필	남	1973.11	상무	상근	Systsem LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	충남대(석사)	계열회사 임원	
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(석사)	계열회사 임원	
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당 임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	41
이종원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	40
이지석	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당 임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	20
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgla Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
이지연	여	1979.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	5
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 디자인 팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담 당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	40
이지훈	남	1970.11	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SECA법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
이지훈	남	1976.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 지원팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	52
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당 임원	DS부문 DS대외협력팀 담당 임원	아주대(석사)	계열회사 임원	40
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당 임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	서울대(박사)	계열회사 임원	
이창수	남	1975.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	항공대(학사)	계열회사 임원	5

이치훈	남	1969.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이태선	남	1978.09	상무	상근	SEWA법인장	SEEA법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	5
이태호	남	1974.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	원광대(석사)	계열회사 임원	16
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	37
이혁	남	1973.02	상무	상근	기획팀 담당임원	Bloom T/F 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	22
이현동	남	1972.02	상무	상근	SESAR법인장	SELV법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	40
이현수	남	1980.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당 임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	16
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	52
이현정	여	1971.11	상무	상근	SCIC 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	40
이형철	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	광운대(학사)	계열회사 임원	5
이혜경	여	1978.01	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, Sr.Director	San Diego State Univ.(석사)	계열회사 임원	6
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	39
이훈철	남	1976.03	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당 임원	Ericsson, Sr.Researcher	고려대(박사)	계열회사 임원	7
이희운	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌EHS/인프라센터장	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
인우성	남	1977.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	5
임경록	여	1978.05	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	5
임산	남	1973.03	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	40
임수현	남	1977.07	상무	상근	SESK 담당임원	영상디스플레이 지원팀 Principal Professional	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	5
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당 임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
임윤모	남	1977.10	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 Principal Professional	인하대(학사)	계열회사 임원	16
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당 임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	52
임전식	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
임지운	남	1975.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	5
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	57
장경모	남	1977.10	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	16
장경훈	남	1970.02	상무	상근	DX부문 CTO 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	

장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	메모리 품질실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	52
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	서울대(학사)	계열회사 임원	
장용일	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	SEIL법인장	성균관대(학사)	계열회사 임원	5
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 X-ray사업팀장	의료기기 DR사업팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	52
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ법인장	SEJ 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	28
장윤형	남	1977.09	상무	상근	중국상성전략협력실 담당임 원	중국상성전략협력실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	5
장윤희	남	1974.09	상무	상근	지원팀 담당임원	SIEL-P(N) 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	28
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	중앙대(석사)	계열회사 임원	28
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEUK 담당임원	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	52
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	56
장흥민	남	1972.06	상무	상근	Global CS센터 담당임원	동남아총괄 CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	28
저메인클 라우제	남	1982.08	상무	상근	동남아총괄 담당임원	동남아총괄 지원팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	28
전대호	남	1971.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	제조&기술담당 People팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	52
전범준	남	1976.07	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임 원	DS부문 CTO 기술기획팀 담 당임원	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	28
전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	28
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	40
전소영	여	1974.05	상무	상근	IR팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	52
전승수	남	1976.07	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임 원	생활가전 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	52
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전영우	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	HP, Director	York Univ.(석사)	계열회사 임원	13
전충원	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임 원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	5
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI 전략마케팅실 Principal Engineer	Univ. Of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	28
전진규	남	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담 당임원	SENA 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	52
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	메모리 전략마케팅실 담당임 원	성균관대(석사)	계열회사 임원	52
전형민	남	1974.03	상무	상근	SEAU 담당임원	SENZ법인장	중앙대(학사)	계열회사 임원	16
전희정	여	1977.09	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당 임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Arizona State Univ.(박사)	계열회사 임원	14
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 Next Product팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	40

정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산, 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	40
정광희	남	1971.08	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	DS부문 DSC 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
정기호	남	1973.08	상무	상근	SEACE 담당임원	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	40
정다운	남	1980.09	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당 임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정덕우	남	1976.12	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당 임원	Palo Alto Networks, Sr. Principal	Yale Univ.(박사)	계열회사 임원	13
정석희	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	16
정성엽	남	1974.09	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션실 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	7
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당임 원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
정성원	남	1971.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	SEWA법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	40
정성훈	남	1976.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	17
정세환	남	1973.10	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	16
정승일	남	1973.08	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석 사)	계열회사 임원	28
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당 임원	서울대(석사)	계열회사 임원	52
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 Principal Engineer	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	40
정연일	남	1975.06	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	TSP총괄 기획팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	28
정영환	남	1971.08	상무	상근	SCIC 담당임원	Mobile eXperience 전략마 케팅실 담당임원	복단대(석사)	계열회사 임원	28
정용덕	남	1976.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임 원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
정육진	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Nike, Director	고려대(석사)	계열회사 임원	5
정원철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정유진	여	1970.06	상무	상근	SECE법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁 신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	
정인호	남	1975.02	상무	상근	Foundry 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기 술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당 임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	40
정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 Principal Professional	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	40
정주영	남	1977.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	카카오엔터프라이즈, 부사장	서강대(학사)	계열회사 임원	15
정준수	남	1970.09	상무	상근	영상디스플레이 Global제조 팀 담당임원	SEEG-P법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	40

정직한	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Mythical Games, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	18
정진희	여	1977.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담 당임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	16
정춘화	남	1974.09	상무	상근	SCS 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	17
정택정	남	1979.10	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담 당임원	구주총괄 Principal Legal Counsel	Univ. of Bonn(석사)	계열회사 임원	5
정한기	남	1976.05	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담 당임원	TSP총괄 Package개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	28
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	40
정홍욱	남	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Hitotsubashi Univ.(석사)	계열회사 임원	16
정희범	남	1979.06	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	고려대(학사)	계열회사 임원	5
제이콥주	남	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI CP개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	28
조강욱	남	1977.08	상무	상근	북미총괄 지원팀장	동남아총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	28
조근수	남	1976.06	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	16
조근휘	남	1974.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	17
조나단림	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Microsoft, Sales Director	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	19
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담 당임원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	27
조성욱	남	1980.10	상무	상근	북미총괄 People팀장	사업지원T/F Principal Professional	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	5
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조성재	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	28
조성훈	남	1976.01	상무	상근	System LSI People팀장	People팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
조성희	남	1974.08	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	28
조영민	남	1973.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담 당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	5
조영상	남	1980.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Google, Sr.Staff S/W Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	7
조영석	남	1976.11	상무	상근	재경팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	28
조용석	남	1975.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 중소형 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	4
조육래	남	1972.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	제조&기술담당 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	52
조원희	남	1975.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인 프라기술센터 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	5
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	52
조은경	여	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	삼성카드, 신용관리담당	성균관대(석사)	계열회사 임원	16

조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	52
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	40
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담 당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 Principal Designer	홍익대(학사)	계열회사 임원	28
조철형	남	1971.03	상무	상근	SSEC법인장	SEDA-P(M)공장장	충북대(학사)	계열회사 임원	52
조철호	남	1971.07	상무	상근	SETK법인장	Mobile eXperience 마케팅 팀 담당임원	Univ. of Southern California(석 사)	계열회사 임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 상품기획실 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	28
조호근	남	1977.11	상무	상근	하만협력팀 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	28
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsing Research AI센터 담당임원	Samsing Research Global AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	38
조희권	남	1976.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	SEA 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현태	남	1972.12	상무	상근	TSE-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당 임원	울산대(학사)	계열회사 임원	40
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SAVINA-S법인장	영상디스플레이 영상전략마 케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	52
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 S/W개발팀 담당임 원	동아대(학사)	계열회사 임원	28
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임 원	Univ. of Southern California(석 사)	계열회사 임원	
차이위엔 천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 제품기술팀 담당임 원	Foundry 기술개발실 담당임 원	NTUST(석사)	계열회사 임원	30
차지호	남	1976.04	상무	상근	경영진단팀 담당임원	감사팀 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	5
찰리장	남	1973.10	상무	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	SRA SVP	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	16
채교석	남	1978.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	5
채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임 원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	23
채수연	여	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 Principal Professional	경북대(학사)	계열회사 임원	5
천기철	남	1970.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	52
천상필	남	1969.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs실 담 당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
천홍문	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁 신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁 신센터 Principal Engineer	단국대(학사)	계열회사 임원	16
최경수	남	1971.12	상무	상근	경영진단팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	52
최동규	남	1977.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설 비기술연구소 담당임원	A*STAR, Sr.Principal Scientist	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	5
최명진	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	16

최민기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	16
최병철	남	1971.06	상무	상근	생활가전 Global운영팀장	영상디스플레이 Global운영 팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	52
최상중	남	1973.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임 원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	52
최상선	남	1975.03	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센 터 담당임원	Big Data센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	16
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 경영진단팀 담당임 원	설비기술연구소 기획지원팀 장	서울대(석사)	계열회사 임원	40
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI Design Technology팀장	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박 사)	계열회사 임원	40
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	재경팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	40
최연호	남	1975.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담 당임원	영상디스플레이 지원팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	16
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 유통전략팀 담당 임원	한국총괄 MX팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	52
최원경	여	1973.08	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
최원서	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	16
최원호	남	1981.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	Western Digital, Sr. Technologist	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	15
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 Principal Designer	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	40
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 C.PKG개발팀 담 당임원	TSP총괄 Package개발실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	52
최윤성	남	1975.05	상무	상근	System LSI 제품기술팀 담 당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	11
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 상품기획실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	28
최일환	남	1972.11	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센 터 담당임원	Big Data센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 상품기획실 담당임원	충남대(학사)	계열회사 임원	28
최재혁	남	1974.06	상무	상근	경영진단팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	52
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Technology팀장	Foundry Design Platform개 발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담 당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	28
최종구	남	1978.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	경찰대(학사)	계열회사 임원	5
최종근	남	1978.01	상무	상근	SCS 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	17
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	52

최종민	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	16
최종성	남	1977.01	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	5
최준일	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	5
최중훈	남	1973.01	상무	상근	베트남삼성전략협력실 담당임원	베트남복합단지 Principal Professional	단국대(학사)	계열회사 임원	5
최진필	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SEAU법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	40
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	남	1974.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	28
최청호	남	1976.11	상무	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	27
최형석	남	1969.01	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀장	LG전자, 상무	성균관대(학사)	계열회사 임원	9
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	28
최호석	남	1978.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Morgan Stanley, VP	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	14
최효석	남	1981.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	17
추민기	남	1975.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	SECE법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	28
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	40
카리아 타카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	東北大(박사)	계열회사 임원	29
코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
하지훈	남	1985.08	상무	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대 통신연구센터 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	5
하헌재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	28
하헌재	남	1984.02	상무	상근	Samsung Research SoC Architecture팀장	Meta, H/W System Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	14
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	28
한기욱	남	1980.12	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국삼성전략협력실 Principal Legal Counsel	연세대(학사)	계열회사 임원	5
한상섭	남	1972.04	상무	상근	북미총괄 CS팀장	Global CS센터 담당임원	광운대(석사)	계열회사 임원	40
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	28

한상원	남	1976.05	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 MX팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	5
한석근	남	1978.09	상무	상근	SESK법인장	SERK법인장	경기대(학사)	계열회사 임원	16
한의택	남	1974.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한중호	남	1976.01	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	52
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 기술표준연구팀장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
한진우	남	1980.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	35
함민기	남	1975.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 Principal Designer	강원대(학사)	계열회사 임원	5
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 Principal Professional	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	28
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	29
허정철	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	16
허준	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	28
허준영	남	1977.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 People팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	40
허준희	남	1979.03	상무	상근	DSRA-S.LSI 담당임원	System LSI SOC사업팀 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	45
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	SECA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	52
헨릭안손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 담당임원	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	27
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	52
현재웅	남	1975.09	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	RPI(석사)	계열회사 임원	20
현정혁	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	28
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	40

홍연석	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEIN-P법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	40
홍영주	남	1977.08	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	네트워크 지원팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	40
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	
홍재석	남	1981.11	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 Principal Legal Counsel	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	5
홍정우	남	1976.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	5
홍준식	남	1971.12	상무	상근	SCS 담당임원	제조&기술담당 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	52
홍준화	남	1974.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Nike, Sr.Director	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	8
홍창표	남	1973.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당 임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	5
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임 원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 장	네트워크 시스템솔루션팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global제조 팀장	영상디스플레이 Global제조 팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	기획팀 담당임원	창의개발센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황영삼	남	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	28
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security&Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	28
황호승	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전 센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	52

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 97,977,871주(이재용 회장 97,414,196주 등),

우선주(의결권 없는 주식) 176,668주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템

(<http://dart.fss.or.kr>)의

'임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하시기 바랍니다.

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

라. 미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분(사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원 선임	마우로	남	1975.05	사장	CDO	계열회사 임원
	소피아황	여	1969.11	부사장	글로벌마케팅실 담당임원	계열회사 임원
	김주영	남	1977.09	상무	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	계열회사 임원
	문종기	남	1975.10	상무	생활가전 개발팀 담당임원	계열회사 임원
	최창환	남	1977.08	상무	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	계열회사 임원

임원 사임	박종진	남	1982.02	상무	생활가전 개발팀 담당임원	계열회사 임원
	성희연	여	1974.03	상무	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	계열회사 임원
	이승호	남	1973.11	상무	SEVT 담당임원	계열회사 임원
	전승훈	남	1971.08	상무	Mobile eXperience 개발실 담당임원	계열회사 임원
	정육진	여	1975.08	상무	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기 · 사업보고서에 기재 예정)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2025년 1분기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 해외종속법인의 유연한 자금조달을 위하여 통합채무보증을 제공하고 있습니다

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.04.20	2025.11.08	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.03.28	2025.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2024.10.01	2025.12.16	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.06.01	2025.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	318,000	286,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	46,000	46,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	947,000	947,000	495,321	△149,623	345,699	46.9%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2024.04.28	2025.12.16	808,270	820,741	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	125,000	115,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	906,400	938,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	20,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
합 계							8,102,270	8,114,741	495,321	△149,623	345,699	

- ※ 별도 기준입니다.
- [△는 부(-)의 값임]
- ※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정
됩니다.
- ※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를
수취하고 있습니다.당사는 2024년 중 US\$2,215천의 수수료를 청구하였으며, 2025년 중 수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2025년 1분기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각/매입	2025.03.31	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	12,420	6,869
SESS	계열회사	자산매각	2025.03.26	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	473	473
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2025.03.27	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	403	14
SEHC	계열회사	자산매각	2025.03.10	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	225	9

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일 · 30일 이내

현금 지급조건 등통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2025년 1분기 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출입 등	2025.01~2025.03	반도체 매출 등	10,629,517

※ 별도 기준입니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자(주), 삼성디스플레이(주) 등)는 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채우자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.04.20	2025.11.08	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.03.28	2025.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2024.10.01	2025.12.16	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	64,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.06.01	2025.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	318,000	286,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	46,000	46,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	947,000	947,000	495,321	△149,623	345,699	46.9%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2024.04.28	2025.12.16	808,270	820,741	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	125,000	115,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	906,400	938,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2023.02.17	2027.11.24	584,785	584,529	497,067	△218	496,849	8.36%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
SEA	계열회사	US Government	지급보증	보조금	2024.12.20	채무소멸시	6,435,000	6,435,000	-	-	-	
합 계							15,462,055	15,464,270	992,388	△149,841	842,548	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2024년 중 US\$2,215천의 수수료를 청구하였으며, 2025년 중 수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2024년 중 \$2,982천 수수료를 청구하였으며, 2025년 중 수취하였습니다.

※ SEA의 US Government 채무는 SAS가 반도체 보조금 계약 불이행시 미 상무부에 반환해야 하는 금액에 대한 모법인의 지급보증 계약입니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 계열회사 현황(상세)

계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 타법인출자 현황(상세)

타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상 디스플레이	Neo QLED 8K (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV <ul style="list-style-type: none"> - QN900 (65 · 75 · 85 · 98") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN700 (55 · 65 · 75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실재를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - Neural Quantum Processor 8K 적용하여 입체감과 현실감 있는 시청 경험 제공 - OTS(Object Tracking Sound) 기능으로 공간을 감싸는 입체감 있는 음질 경험 제공 - 8K Wireless One Connect Box, 8K AI Upscaling Pro, AI HDR Remastering Pro, AI Motion Enhancer Pro, 8K 120Hz 4K 240Hz VRR을 적용한 QN990F 도입
		Neo QLED 4K (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> Mini LED 기반 4개 시리즈, 8개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98 · 100") <ul style="list-style-type: none"> - Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 장르별 선호 화질 선택 시, AI 활용하여 장르별 맞춤형 화질 변환 - 편리한 사용성 제공하는 New Home을 통해 빠른 진입점 및 추천경험 제공 - NQ5 SI Gen3 Processor 적용을 통한 강화된 AI 기능 제공(QN90F) (Live Translate, Click to Search, Home Insight 등) - Glare Free, VRR 4K 165Hz 적용 (QN90F)
		OLED TV (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65 · 77") <ul style="list-style-type: none"> - S95 (55 · 65 · 77") : 165Hz VRR 적용된 QD-OLED Display와 OLED Glare Free 적용된 True Reality 화질과 Ultra Slim Flat 폼팩터에 Top Speaker가 내장된 Infinity One Design에 Object Tracking Sound 및 ATMOS 까지 모두 적용된 진정한 TV 가치를 제공하는 OLED TV - S90 (55 · 65 · 77") : Neo QLED 외, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 내 포지셔닝 확대를 위해 144Hz VRR 적용된 OLED Display의 화질과 Laser Slim Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV - NQ5 SI Gen3 Processor 적용을 통해 강화된 AI 기능 제공(S90/S95F) <input type="checkbox"/> White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (42 · 48 · 55 · 65 · 77 · 83") <ul style="list-style-type: none"> - S95 (83") : 상동 - S90 (42 · 48 · 55 · 65 · 77 · 83") : 상동 - S85 (55 · 65 · 77 · 83") : OLED 판매 확대 및 손익 개선 중심의 신규 라인업으로 기획된 White OLED Display와 최후부까지 곡선으로 날렵하게 이어지는 Contour Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
		QLED TV (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV (32 · 43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar를 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대 - Art Store x Ambient 서비스 통합 및 도입 확대(QLED 이상), AI SoC 탑재(Q7F↑)
		UHD TV (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98") <ul style="list-style-type: none"> - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질

			<ul style="list-style-type: none"> - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Hub, IoT Hub, Chat Together, Voice Ready, Daily+, SmartThings Mobile Plugin 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화 <input type="checkbox"/> Flat FHD/HD TV (24 · 27 · 32 · 40 · 43") <ul style="list-style-type: none"> - 3면 Bezel-Less 디자인, Full Screen UI 반영하여 확장된 경험을 제공하는 FHD/HD Smart TV
		Lifestyle TV (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> The Sero (43") <ul style="list-style-type: none"> - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 <input type="checkbox"/> The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 영화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용 - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 - 4K Wireless One Connect Box 적용한 QFLS03W 도입 <input type="checkbox"/> The Serif (43 · 50 · 55 · 65") <ul style="list-style-type: none"> - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 - White 외 Dark계열 신규컬러(Ivy Green) 옵션 제공 <input type="checkbox"/> The Terrace (55 · 65 · 75") <ul style="list-style-type: none"> - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 <input type="checkbox"/> The Premiere (100~130") <ul style="list-style-type: none"> - 초단초점 · 레이저 · 고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질 · 음질을 제공하는 프로젝터 <input type="checkbox"/> The Freestyle (30~100") / Freestyle Rev (30~100") <ul style="list-style-type: none"> - 언제 어디서나 다양한 콘텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
		Micro-LED TV (~2023.12.)	<input type="checkbox"/> Micro-LED Screen (76 · 89 · 101 · 114", TFT 기반) <ul style="list-style-type: none"> - 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족시키는 차세대 Flagship 모델 - TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시 - MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현
		Sound Bar (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> Sound Bar Q990B <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재 <input type="checkbox"/> Sound Bar Q990F <ul style="list-style-type: none"> - AI 기술을 이용한 Immersive 사운드 최적화 경험 제공 - 고음질 음향 코덱(RAAT, IMAF) 신규 적용, Room Ready 인증 - Dual Unit Low-vibe Compact Woofer 탑재한 자진동 출력개선
		모니터 (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> 스마트 모니터 M80B (32") <ul style="list-style-type: none"> - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game)

			<input type="checkbox"/> 게이밍 모니터 G85NB (32") <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) <input type="checkbox"/> 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") <ul style="list-style-type: none"> - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 <input type="checkbox"/> QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") <ul style="list-style-type: none"> - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 <input type="checkbox"/> 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈을 보호하는 Matte Display - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' <input type="checkbox"/> DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57") <ul style="list-style-type: none"> - 신규 57" 초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공 - 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 <input type="checkbox"/> 무안경 3D Gaming 모니터 (G90XF 27") <ul style="list-style-type: none"> - 3D 전용 안경 없이, 3D 콘텐츠 경험을 통한 몰입감 제공 - 2D ↔ 3D 전환 및 3D 진입을 위한 별도 SW (Reality Hub) 제공 - 165Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도 통해 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
	사이니지 (~2023.06.)		<input type="checkbox"/> LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Hotel-TV, Video Wall, Outdoor 등) (13 · 24 · 32 · 43 · 49 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 <input type="checkbox"/> 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") <ul style="list-style-type: none"> - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항균 코팅
	생활가전	냉장고 (~2025.02.)	<input type="checkbox"/> 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 패키지 라인업 확대 - 신규격 기준 에너지 최고등급 구현 - 간냉식 용량 우위 확보 - 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화 <input type="checkbox"/> 북미 48" 냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 27.4cf 대용량 구현 - Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker) - Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화 <input type="checkbox"/> 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가) <input type="checkbox"/> Global Wide BMF 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - 고효율 에너지 등급 및 AI Energy mode 적용, 에너지 비용 절감 - SpaceMax 적용으로 내용적 확대로 수납 편의성 - SmartThings 기반 시간대별 고내 조명 자동 조절 등 Smart 서비스 제공 <input type="checkbox"/> 중국 가옥 맞춤 냉장고(W83cm)

		<div> <ul style="list-style-type: none"> - 좌우 제로갭 설치로 주방 공간에 딱 맞게 빌트인처럼 매끈하게 설치 가능 - AI에너지 모드 적용으로 실사용 에너지 절감(중국에너지 1등급) - 최적 온도와 습도에서 전문적으로 식재료 특화 보관 제공(건습/보습 Box) - Wide Open 자동 도어 열림 기능 적용 <div> <input type="checkbox"/> Peltier 적용 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - Peltier 적용 및 패열 활용을 통한 최고 효율 및 에너지 등급 달성 - 2개 냉각방식(Comp+Peltier)의 장점을 결합하여 소비자 Value 창출 <ul style="list-style-type: none"> · 1등급 -30% 에너지 달성 (기존 1등급 -22%) · Peltier 냉각 시스템 Compact화로 내용적 확보(기존 875L → 900L) </div> <div> <input type="checkbox"/> 구주 Built-In BMF 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - 구주향 빌트인 BMF 대용량(380리터 ↑) 최고 에너지 등급 달성 - AI Energy 적용, 동급비 10% 이상 실사용 에너지 절감 - Full 간냉 및 [냉동→냉장 전환] 기능 제공 </div> <div> <input type="checkbox"/> 한국 4Door 김치냉장고 도입 (소분/숙성 기능 장착) <ul style="list-style-type: none"> - 식재료 소분 저장/저온 숙성 가능한 별도 공간 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 김치숙성, 육류해동, 반죽발효 등 다양한 모드로 활용성 강화 - 개정 에너지 규격 기준 1등급 고효율 모델 도입 </div> <div> <input type="checkbox"/> 한국 오토 오픈 4Door 김치냉장고 도입 <ul style="list-style-type: none"> - Auto Open Door 적용으로 사용 편의성 강화 - 냄새 저감 김치통 적용으로 다양한 식재료 보관 가능 - 숙성, 해동, 발효 가능한 맞춤숙성실 제공 </div> <div> <input type="checkbox"/> 인도 에너지 규제 대응 TMF 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - 외관 디자인 변경 (Flat Door 적용) - AI Energy Mode 적용(전 모델 Wi-fi 적용 및 통합 PBA 반영) </div> <div> <input type="checkbox"/> 북미향 36인치 FDR 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - AI HOME를 통한 MDE 경험 제공 및 소비자 맞춤형 최적 컨텐츠 제공 - 32인치 패밀리허브를 통한 대화면 스크린 - 양손을 자유롭게 하는 Auto Open Door </div> <div> <input type="checkbox"/> 글로벌 36인치 T-Type FDR 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - 9인치 LCD 및 Bixby LLM으로 소비자의 상황에 맞춰 가장 필요한 최적 컨텐츠 제공 - AI Vision Inside 2.0, 자동인식 식품 확대 - AI 하이브리드 대체로 용량 및 에너지 우위 강화 - 양손을 자유롭게 하는 Auto Open Door - 무발포 도어 및 제로갭(키친핏)_3월 도입 </div> </div> <div> <div> <div>세탁기</div> <div>(~2025.03.)</div> </div> <div> <div> <input type="checkbox"/> 그랑데 AI 24kg 세탁기 <ul style="list-style-type: none"> - 24kg, Flat Design (Glass Type) - 핏케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알러젠 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) </div> <div> <input type="checkbox"/> BESPOKE 그랑데AI 원바디 Top-Fit <ul style="list-style-type: none"> - 한국향 BESPOKE 그랑데AI 일체형 Washer - 세탁기(21kg)와 건조기(17kg) 일체형 원바디 디자인 - 심플한 플랫폼 디자인 </div> <div> <input type="checkbox"/> 세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 <ul style="list-style-type: none"> - ONE 솔루션 : 세탁물 이동없이 편리하게 하나로 세탁건조 - AI 홈 : 터치화면 및 음성인식으로 간편하게 세탁건조 - AI 맞춤코스 : 세탁물에 맞는 최적의 코스로 작동 </div> <div> <input type="checkbox"/> SSEC 24"9kg Slim 콤보 </div> </div> </div>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Space Max 기술 적용: 좁은 주거 환경에서도 대용량 9kg을 한번에 세탁 - AI Energy Mode: 전기 에너지를 한층 더 절감 (AI Energy 사용시 70% 절감) - Ductless 타입 콤보 플랫폼으로 건조 시간 기존 대비 최대 50% 절약 - AI Wash, AI 에코버블, Flex Auto Dispenser 등으로 세탁성능 및 사용 편의성 강화 <p>□ 북미 27"Vent 콤보</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vent 건조 방식을 적용 - "All-in-one 컨셉" 및 "AI Home" 등으로 소비자 사용 경험 개선 - AI Optiwash&Dry로 소비자의 관여를 줄이면서 최적화된 코스 제공 - Auto Open Door 및 Easy Lint Clean 필터 등으로 차별화 POD 제공
		에어컨 (~2025.2.)	<p>□ 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 <p>□ BESPOKE 무풍에어컨 원도우핏</p> <ul style="list-style-type: none"> - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 <p>□ Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엣지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 <p>□ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) <p>□ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽걸이형) 실내기 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 <p>□ 시스템 에어컨 주력 상품인 DVM S의 혁신 고효율 신규 플랫폼 도입</p> <ul style="list-style-type: none"> - 캐나다내 Top 에너지 효율 달성(경쟁사 제품比 IEER 효율 경쟁력 리더십 확보) - 캐나다내 최대 용량 달성(단일 Set 최대 20Ton, D社 단일 Set 최대 14Ton) - 캐나다내 최대 난방 운전 온도 범위 <ul style="list-style-type: none"> · 당사 -30~24℃, D사 -25~16℃, X사 -30~16℃ <p>□ 모듈 고효율화 및 실외기 신규 개발을 통한 RAC 경쟁력 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAC 전모델 Smart 기능 (AI절전) 및 DC화를 통한 제품 경쟁력 확보 - 부품 종수 감축을 통한 원가 경쟁력 제고 - 9/12K STD급 실외기 체적 경쟁력 확보(기존 104리터 대비 85리터, 체적 19%↓) - 이태리 에너지 보조금 조건 충족 - Twin 압축기 적용으로 진동, 소음 저감 및 저부하 운전 영역 확대 <p>□ 북미 냉매 규제 시행 ('25.1.1 통관 기준 시행)에 따른 R32 신모델 도입</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi BLE 기능 적용 - 습도 센서를 이용한 쾌적 제습 운전

			<input type="checkbox"/> 주거용 통합 쾌적 시스템에어컨 실내기 도입(AI에어컴보제품) - 환기/청정+시스템에어컨 연동 정온 제습 기술 결합, 주거용 통합 공조 솔루션 제공 - 온도/습도 분리 제어로 과냉방 없는 쾌적 솔루션 제공, 최대 40% 에너지 절감 - AI에어컴보+DVM Home 연계를 통한 한국 주거용 시스템에어컨 경쟁력 강화
		청소기 (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 <input type="checkbox"/> 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 <input type="checkbox"/> 한국형 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 <input type="checkbox"/> 400W 흡입력 스틱 청소기 - 세계 최고 수준인 400W 압도적 흡입력으로 강력한 청소 성능 제공 - HEPA Filtration 적용으로 미세먼지 배출 걱정 없는 깨끗한 청소 보장 - AI 모드2.0 으로 청소 환경 인식하여 최적의 청소 성능 제공 및 배터리 사용량 절감 - 무게는 가볍게 청소 면적은 더 넓게 적용한 액티브 슬림 브러시 - 에어 블로워 : 눈에 보이지 않는 먼지까지 손쉽게 청소
		가스오븐 (~2023.08.)	<input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range - 48" all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용 - 7" Pop-up display 적용 <input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range (Dual Fuel) - 48" Dual Fuel Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Dual Fuel 연료 형태로 Oven(전기) + Cooktop(가스) - Cooktop부 6 Burners + Griddle 사양 적용 - Small oven 12" (신규 플랫폼), Big oven 36" (기존 플랫폼) 조합 - Steam Assist 기능 제공
		식기세척기 (~2025.01.)	<input type="checkbox"/> 북미 프리미엄 시장 핵심 사양 차별화를 통한 제품 경쟁력 확보 - 최고 에너지 효율 Energy Star Most Efficient 확보, 시장 최저 소음 38dBA 달성 - Rack 사용성 강화:Extra Large 3rd Rack, Storm Wash Zone, Glide(Soft) Rail 적용 - 편의성 강화 : Auto Open Door 적용
	MX	Galaxy 폴더블 (~2024.10.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold5 (2023.08.) - 인치(Main/Sub) : 7.6" QXGA+ (2176 x 1812) / 6.2" HD+ (2316 x 904) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 154.9 x 129.9 x 6.1mm, Close 154.9 x 67.1 x 13.4mm, 253g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1.1 - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 디자인 구현 : Dumbbell 방식(물방울형) Flex Hinge 적용 - 무게 절감과 두께 축소를 통한 단말 휴대성 및 그림감 향상 - 대화면 최적화를 통한 사용자 경험 개선 - 양손 활용 동작 : 한 손으로 앱/컨텐츠를 선택, 다른 손으로 원하는 동작 실행 - Taskbar 최적화 : 최근 앱 표시 확대(2→4개), Navigation 영역 자동 확장 - 멀티윈도우 전환 강화 : 홈화면에서 팝업 윈도우를 손쉽게 멀티윈도우로 전환

			<ul style="list-style-type: none"> • Game 최적화 : 주요 Game에 대한 최적 해상도 사전 확보 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경 - 슬림하고 가벼운 S펜과 Case : S펜 및 Case 형상 변경으로 두께 및 무게 절감
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip5 (2023.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치(Main/Sub) : 6.7" FHD+ (2640 x 1080) / 3.4" (748 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 165.1 x 71.9 x 6.9mm, Close 85.1 x 71.9 x 15.1mm, 187g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1.1 - 설계 최적화를 통한 커버스크린 확대(1.9" →3.4") - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 및 두께 축소로 그림감 개선 - 대형 커버스크린 활용한 차별화된 사용자 경험 핵심 기능 제공 및 사용성 강화 • 주요 위젯13종(Music, Alarm 等), 주요 앱(삼성Wallet, 메시지 답장), Fast Scroll 기능 제공 • Quick Setting 6종 →9종 확대(Mobile Data, Screen Recording, Modes 3종) - 대화면 커버스크린을 활용한 다양한 촬영 효과 및 기능 제공 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold6 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 얇고 가벼운 무게로 뛰어난 휴대성 제공을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 7.6" QXGA+ (2160 x 1856) / 6.3" HD+ (2376 x 968) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 153.5 x 132.6 x 5.6mm, Close 153.5 x 68.1 x 12.1mm, 239g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 • 서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트 등 • 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등 - 향상된 카메라/갤러리 경험 제공 • 포토/그리기 어시스트, 날씨 및 시간 배경 화면 등 - 무게 14g 감소, 두께(Close) 1.3mm 감소, Cover Display 0.1" 증가
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip6 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 내구성 향상을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 6.7" FHD+ (2640 x 1080) / 3.4" (748 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 165.1 x 71.9 x 6.9mm, Close 85.1 x 71.9 x 14.9mm, 187g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 • 서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 • 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드', 플렉스윈도우에서의 '답장 추천' 기능 지원 등 - 고화소 카메라(Wide 50MP) 적용 및 향상된 Flex 카메라 경험 제공 • 저조도/원거리 선명한 디테일 제공 • 플렉스모드에서 카메라 자동줌(Auto Zoom) 기능 지원으로 편리한 핸드프리 촬영 - Display Folding부 내구성 강화 • 화면 내구성 강화및 폴딩부 굴곡 개선
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold SE (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 더 넓고 더 슬림해진 디자인, 핵심 사양을 강화하여 제품 경쟁력 확보 - 한 단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 8.0" QXGA+ (2184 x 1968) / 6.5" FHD+ (2520 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 157.9 x 142.6 x 4.9mm, Close 157.9 x 72.8 x 10.6mm, 236g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터의 기본 사용성 향상 (Z Fold6 比)

			<ul style="list-style-type: none"> • 무게 3g 감소, 두께(Close) 1.6mm 감소, Main Display 0.4", Cover Display 0.2"증가 • Cover Display의 화면 비율(21:9) 개선을 통한 클로즈 상태의 사용성 향상 - 2억 화소 초고해상도 카메라를 적용하여, 폴더를 최고의 카메라 성능 확보 - 더 넓은 화면을 활용한 Galaxy AI 를 통해 Galaxy Intelligence 경험 혁신 • 서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트, 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등
		Galaxy S (~2025.02.)	<input type="checkbox"/> Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond <ul style="list-style-type: none"> * Unrivaled Camera, Ultimate Gaming Eco-conscious Design - 인치 : S23 6.1" FHD+ (2340 x 1080), S23+ 6.6" FHD+ (2340 x 1080), S23 Ultra 6.8" Quad HD+ (3088 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : S23 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g, S23+ 157.8 x 76.2 x 7.6mm, 195g S23 Ultra 163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 233g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 강화된 AI기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고 <ul style="list-style-type: none"> • AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 • OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5°→ S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> • S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 • 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 <ul style="list-style-type: none"> • 소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공 • 단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화 - S23 Ultra, 내장된 S펜으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> • 이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안 - 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC) <ul style="list-style-type: none"> • 폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능 - 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성 <ul style="list-style-type: none"> • 패키징 박스 100% 재생용지 사용 • 재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(28%) 사이드키 등 • 전/후면 글라스 재생유리 적용(22%), 메탈 가공시 천연염료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등 - Privacy와 Security 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 보안 상태 시각화 / 이미지 공유시 민감 정보 알림 / 제품 수리시 개인 정보 접근 제한
			<input type="checkbox"/> Galaxy S24 · S24+ · S24 Ultra (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신, 일상에 새로운 경험과 가치를 제공 <ul style="list-style-type: none"> • 서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 신규 AI 기능 제공 - 인치 : S24 6.2" FHD+ (2340 x 1080), S24+ 6.7" Quad HD+ (3120 x 1440), S24 Ultra 6.8" Quad HD+ (3120 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : S24 147.0 x 70.6 x 7.6mm 167g, S24+ 158.5 x 75.9 x 7.7mm, 196g S24 Ultra 162.3 x 79.0 x 8.6mm, 232g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400, Android 14, One UI 6.1 - Slimmer and even bezels 적용으로 몰입감 있는 디스플레이 경험 강화 - One-mass 디자인을 통한 조형의 일체감 완성 - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 스페이스 줌, 나이트그래피로 선명한 고품질 사진 촬영 • Instant Slow-mo, Edit Suggestion 기능 제공 - 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,750nit → 2,600nit - S24 Ultra, 메탈 프레임 티타늄 소재 적용을 통한 내구성 강화 및 고급감 극대화

			<ul style="list-style-type: none"> - S24 Ultra, 고화소 망원 카메라 적용 * 10MP (S23 Ultra) → 50MP (S24 Ultra)
			<input type="checkbox"/> Galaxy S24 FE (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 최신 플래그십 경험의 장벽을 낮추는 균형 잡힌 프리미엄 (with Galaxy AI) - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.0 x 77.3 x 8.0mm, 213g - Platform(H/W, S/W) : Exynos 2400e, Android 14, One UI 6.1 - 전작 대비 향상된 H/W 제공으로 사용자 경험 극대화 <ul style="list-style-type: none"> • AP (Exynos2200→Exynos2400e), Display (6.4"→6.7"), Battery (4,500mAh→4,700mAh) - 플래그십 AI기반의 Full Experience 제공 (서클 투 서치, 실시간 통역, AI 사진편집 등) - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 - 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,450nit → 1,900nit
			<input type="checkbox"/> Galaxy S25(2025.02.) <ul style="list-style-type: none"> - Galaxy AI 경험 고도화로 모바일 AI 경험의 새로운 패러다임 제시 <ul style="list-style-type: none"> • Now Brief, Google Gemini, Gemini Live, 오디오 지우개 등 신규 AI 기능 제공 - 인치 : S25 6.2" FHD+ (2340 x 1080), S25+ 6.7" Quad HD+ (3120 x 1440), S25 Ultra 6.9" Quad HD+ (3120 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : S25 146.9 x 70.5 x 7.2mm, 162g, S25+ 158.4 x 75.8 x 7.3mm, 190g S25 Ultra 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 218g - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> • Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Elite, Android 15, One UI 7.0 • 둥근 모서리 형상으로 갤럭시 S 시리즈의 통일된 정체성 표현 • 실장 구조 최적화 및 부품 경량화로 쏘 모델 슬림/경량화 (S24 7.6t → S25 7.2t, S24+ 7.7t → S25+ 7.3t, S24 Ultra 8.6t → S25 Ultra 8.2t, S24 167g → S25 162g, S24+ 196g → S25+ 190g, S24 Ultra 232g → S25 Ultra 218g) • 갤럭시 맞춤형 프로세서 탑재로 디스플레이 화질 및 배터리 효율 향상 • 더 강력해진 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 (향상된 10bit HDR 지원으로 어두운 곳에서도 선명한 영상 촬영, Object-aware Engine을 통해 주변 빛을 분석하여 자연스러운 피부 톤과 질감 표현, 원하는 사진을 AI로 분석하여 나만의 맞춤형 필터 제공) • S25 Ultra, 코닝 고릴라 아머2 글래스 적용을 통한 디스플레이 글래스 내구성 강화 • S25 Ultra, 업그레이드된 고화소 초광각 카메라 적용 * 12MP (S24 Ultra) → 50MP (S25 Ultra)
			<input type="checkbox"/> Galaxy Tab S9 · S9+ · S9 Ultra (2023.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S9 11"WQXGA (2560 x 1600) Tab S9+ 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S9 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Tab S9 165.8 x 254.3 x 5.9 mm, 498g Tab S9+ 185.4 x 285.4 x 5.7 mm, 581g Tab S9 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.5 mm, 732g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 풍부한 색감과 환경에 적응하는 대화면 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> • Tab S9 시리즈 전 모델 선명하면서도 편안한 Dynamic AMOLED 2X 기술 채용 • 햇빛 아래에서도 선명한 화면을 보여주는 Vision Booster 기술 도입 - 어디서나 걱정 없이 사용 가능하도록 이동성 및 신뢰성 확보 <ul style="list-style-type: none"> • 최상의 방수/방진 인증 등급 IP68 획득 • 충격과 낙하에서 기기를 안전하게 보호하는 Armor Aluminum

			<ul style="list-style-type: none"> • 양방향 충전 적용 S펜 및 Ruggedized 액세서리 도입으로 사용성 Eco 확대 • Tab FE 모델군과 키보드 및 액세서리 공용화로 호환성 강화 • Vapor Chamber를 이용한 양방향 방열 신규 구조 도입 장시간 사용에도 불편함 없이 사용 - 다양한 분야에 걸친 풍성한 Android App Eco 확보 • 필기, 문서, 브라우징 등 생산성 강화 주요 안드로이드 앱 강화 : 삼성노트, 굿노트 등 • 그림, 사진 및 영상 편집 사용성 개선을 위한 주요 앱 확보 : 루마퓨전, 클립스튜디오 등 - 외관 대형 플라스틱 부위 및 강화 유리 재활용으로 제품 전반에 걸친 친환경 소재 적용 • S펜 부착 부위 대형 재활용 플라스틱 신규 적용 • 디스플레이 강화 유리 신규 재활용 도입 (10%, 고릴라 글래스5) • 패키징 박스 100% 재생 용지 및 재활용 Armor Aluminum 적용(20%), 재활용 플라스틱 내장 자재 사용 등
			<input type="checkbox"/> Galaxy Tab S10+ · S10 Ultra (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S10 Plus 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S10 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Tab S10 Plus 185.4 x 285.4 x 5.6 mm, 571g Tab S10 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.4 mm, 718g - Platform(H/W, S/W) : Mediatek Dimensity 9300+, Android 14, One UI 6.1.1 - S펜을 활용한 쉽고 편리한 AI 사용 경험 - Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz, 저반사 코팅
			<input type="checkbox"/> Galaxy A14 5G (2023.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.7 x 78.0 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : D700/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.0 - 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP → 13MP) - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			<input type="checkbox"/> Galaxy A54 5G (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 158.2 x 76.7 x 8.2mm, 202g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1380, Android 13, One UI 5.1 - AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상 - 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화 - Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공 - Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용) - One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			<input type="checkbox"/> Galaxy A34 5G (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.3 x 78.1 x 8.2mm, 199g - Platform(H/W, S/W) : D1080, Android 13, One UI 5.1 - 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공 - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공
			<input type="checkbox"/> Galaxy A14 (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.7 x 78.0 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850/G80, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP)
		Galaxy A, M (~2025.03.)	

			<ul style="list-style-type: none"> - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
		<input type="checkbox"/> Galaxy A24 (2023.05.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.1 x 77.6 x 8.3mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G99, Android 13, One UI core 5.1 - 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공 - 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A05s (2023.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" FHD+ (2400 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 168.0 x 77.8 x 8.8mm, 194g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 13, One UI core 5.1 - LTE Entry 시장 물량 및 M/S 견인 - 전작 A04S 比 고성능 AP 탑재 (Exynos850 8nm → SDM680 6nm), 고사양 Front Camera 적용 (5MP → 13MP) - Global 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 급속25W 충전 지원 (15W → 25W) 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A05 (2023.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 168.8 x 78.2 x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G85, Android 13, One UI Core 5.1 - 6.7" 대화면과 50MP 고화소 카메라 지원으로 향상된 멀티미디어 경험 제공 - 고성능 AP 탑재하여 고객의 제품 사용성 향상 (전작比 CPU 33%↑, GPU 150%) - 25W 고속으로 30분 충전하여 장시간 사용할 수 있는 배터리 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A25 5G (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.0 x 76.5 x 8.3mm, 197g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1280, Android 14, One UI 6.0 - 6.5" FHD+, 120Hz 주사율을 지원하여 향상된 화면 경험 제공 - 50MP OIS 광각 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A15 (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 160.1 x 76.8 x 8.4mm, 200g - Platform(H/W, S/W): [5G] D6100+ / [LTE] G99, Android 14, One UI 6.0 - 전작(A14) 대비 디스플레이 업그레이드를 통한 화질 향상 (LCD → Super AMOLED) - 25W 고속 충전 가능한 5,000mAh 대용량 배터리 탑재 - Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A55 5G (2024.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 14.0, One UI 6.1 - 강화된 카메라 센서 및 AP로 더 완벽해진 Nightography와 비디오 촬영 경험 제공 - Metal + Glass 적용, Young & Energetic한 CMF 구현으로 디자인 경쟁력 강화 - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A54-5g 6.4") 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A35 5G (2024.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209g 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Exynos 1380, Android 14, One UI 6.1 - HID(Hole In Display), Back Glass적용하여 디자인 차별화 - Knox Vault로 보안을 강화하고, OS UP 4회 및 Security MR 5회 지원하여 품질 보증 확대
			<input type="checkbox"/> Galaxy A06 (2024.09.) <ul style="list-style-type: none"> - A05 후속 최저가 LTE 모델로 Entry Seg 물량 확대 - 인치 : 6.7" HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.3 x 77.3 x 8.0mm, 189g - Platform(H/W, S/W): G85, Android 14, One UI 6.1 - 대화면 Slim 디자인 (두께 8.00mm) 적용 - 측면 지문 지원 및 Samsung Knox Vault 보안솔루션 탑재로 데이터 보안 강화
			<input type="checkbox"/> Galaxy A16 5G (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - A15 5G 후속, Entry 5G 시장 성장 대응 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1330 / D6300, Android 14, One UI 6.1 - 6.7"대화면 디스플레이 및 Slim 디자인 (두께 7.9mm) 적용 - OS 6회/SMR 6년 업데이트 지원 및 IP54 방수방진 등급 적용
			<input type="checkbox"/> Galaxy A16 (2024.11.) <ul style="list-style-type: none"> - A15 후속 Entry LTE 물량 대응 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200g - Platform(H/W, S/W): G99, Android 14, One UI 6.1 - 6.7"대화면 디스플레이 및 Slim 디자인 (두께 7.9mm) 적용 - OS 6회/SMR 6년 업데이트 지원 및 IP54 방수방진 등급 적용
			<input type="checkbox"/> Galaxy A06 5G(2025.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 5G Entry 시장 대응 및 물량 견인 모델 - 인치 : 6.7" HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.3 x 77.3 x 8.0mm, 191g - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> • Platform(H/W, S/W): D6300, Android 15, One UI Core 7.0 • Entry 5G Seg 최초 도입 및 Slim 디자인(8.0mm), 대화면 디스플레이(6.7") 적용 • IP54 적용, 측면지문 지원 및 Samsung Knox Vault 보안솔루션 탑재로 데이터 보안 강화
			<input type="checkbox"/> Galaxy M16 5G (2025.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 서남아 온라인 판매를 위한 5G Entry JDM모델 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 191g - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> • Platform(H/W, S/W): D6300, Android 14, One UI Core 6.1 • Super AMOLED 적용 및 50MP+5MP+2MP/13MP 카메라 탑재 • 25W 고속 충전 가능한 5000mAh 대용량 배터리 탑재 • Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			<input type="checkbox"/> Galaxy A56 5G (2025.03.) <ul style="list-style-type: none"> - A55 5G 후속으로 핵심 사양의 실체감 성능 강화를 통한 High Seg 경쟁력 확보 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.2 x 77.5 x 7.4mm, 198g - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> • Platform(H/W, S/W): Exynos 1580, Android 15, One UI 7.0

			<ul style="list-style-type: none"> · 더 Slim하고 가벼워진 바디의 프리미엄 디자인 (두께 8.2t→7.4t, 무게 213g→198g) · 전작 比 강화된 셀피 동영상 촬영 경험 제공 및 밝고 선명해진 Nightography 경험 제공 (전면카메라 12MP 신규센서 및 10bit HDR 적용 / 후면 Wide 및 전면 카메라 LN mode 적용) · AI로 빠르게 선택하여 최적의 화질로 촬영하고 다양한 사진 편집 경험 확대 제공 (AI segmentation, AI Powered Context-Aware, Edit Suggestion, Image Clipper 기능 등 제공) · 강력해진 AP와 방열 시스템으로 압도적인 성능 구현 (AP Rose→Santa, Vapor Chamber Size↑)
			<input type="checkbox"/> Galaxy A36 5G (2025.03.) <ul style="list-style-type: none"> - A35 5G 후속으로 디자인 및 실 체감 중심 핵심 경험 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 195g - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> · Platform(H/W, S/W): Snapdragon 6 Gen3, Android 15, One UI 7.0 · 7.4t Slim Design, 6.7" FHD+ Super AMOLED Display, 45W Fast Charging 제공 · Awesome Intelligence 적용으로 모바일 AI 대중화 선도 * Object Eraser, AI Select等 · IP67등급 방수/방진
			<input type="checkbox"/> Galaxy A26 5G(2025.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 디자인 및 체감 성능 강화하여 Mid seg 5G시장 경쟁력 확보 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.0 x 77.5 x 7.7mm, 200g - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> · Platform(H/W, S/W): Exynos 1380 / Exynos1280(LA only), Android 15, One UI 7.0 · 7.7t Slim Design, 6.7" FHD+ Super AMOLED Display, Glass CMF 적용으로 디자인 경쟁력 강화 · Awesome Intelligence 적용으로 모바일 AI 대중화 선도 * Object Eraser, AI Select等 · IP67등급 방수/방진
		Galaxy Book (~2025.02.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Ultra (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg - Intel® Core™ Processor (13세대), Win 11, LPDDR5, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D AI, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (Galaxy 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 <ul style="list-style-type: none"> · Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나, 문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 · Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 · Quick Share : 폰/태블릿 등 Galaxy 기기 간 무선 파일 공유
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16.0" 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 스펀 & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic

			<ul style="list-style-type: none"> - SSD : Gen4 SSD - WiFi 6E 지원 - Battery : 76Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Pro (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14" 312.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280) - WiFi 6E 지원 - Battery : 16" 76Wh, 14" 63Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book3 360 (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) 13.3" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.49kg 13.3" 304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120% - 스펀 & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6") - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh, 13.3" 61.1Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Ultra (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 250.4 x 16.5mm, 1.86kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070 - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Pro 360 (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg

			<ul style="list-style-type: none"> - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜 - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 퀵드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Pro (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14"312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 퀵드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 16"76Wh, 14"63Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Edge (2024.06.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.3mm, 1.55kg 14"312.3 x 223.8 x 10.9mm, 1.16kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit (HDR) - 그래픽 : Qualcomm Adreno - 퀵드 스피커 (16"우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2 / 14"우퍼 Max 4W x 2, 트위터 2.7W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Memory, SSD : 16"16GB, eUFS 512GB, 1TB / 14"16GB, eUFS 512GB - Bluetooth v5.3, WiFi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be - Battery : 16"61.8Wh, 14"55.9Wh - Next Gen AI PC 시장 선도를 위한 AI 기능 탑재
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book5 Pro 360 (2024.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.69kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜 - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - 퀵드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 3.3W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 - Battery : 76.1Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Pro 360 5G (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.73kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11

			<ul style="list-style-type: none"> - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, S펜 - 그래픽 : Qualcomm Adreno - 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos, 2M Camera - Battery : 76Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Edge (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 356.6 x 229.75 x 15.0mm, 1.5kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Plus (8 core), Windows 11 - 그래픽 : Qualcomm Adreno - Bluetooth v5.3, WiFi 7 지원 - 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Battery : 61.2 Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book5 Pro/Pro H (2025.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14" 312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> • Platform : Intel® Core™ Ultra Processor Lunar lake (Pro) Intel® Core™ Ultra Processor Arrow lake (Pro H) • OS : Windows 11 • Dynamic AMOLED 2X : 2880x1800, 500nit(HDR) • 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics • 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5W x 2, 트위터 (16"3.3W x 2 / 14"2W x 2)), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 16" 76.1Wh, 14" 63.1Wh
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book5 360 (2025.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.46kg - 사양 및 기능 <ul style="list-style-type: none"> • Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor Lunar lake, Windows 11 • AMOLED FHD(1920x1080), 500nit(HDR) • 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics • 스테레오 스피커(2W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 68.1Wh
		Galaxy 워치 (~2024.07.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic (2023.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch6 Classic (47mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 Classic (43mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch6 (44mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 (40mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Watch6 Classic (47mm) : 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g Watch6 Classic (43mm) : 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0g Watch6 (44mm) : 42.8 x 44.4 x 9.0mm, 33.3g

			<p>Watch6 (40mm) : 38.8 x 40.4 x 9.0mm, 28.7g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : Exynos W930, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) - 시인성 향상을 구현한 디자인과 성능 <ul style="list-style-type: none"> · 전작 대비 베젤 축소 및 약 20% 넓어진 대화면 구현 · 고해상도 Super AMOLED 디스플레이 탑재 및 최대 2,000니트 밝기 지원 - 강화된 수면 관리 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 수면 점수를 구성하는 요인을 항목별 심층 분석 및 종합하여 수면 점수 제공 · 향상된 맞춤형 수면 코칭 프로그램 제공 - 보다 개인화된 피트니스 관리 기능 등 신기능 추가 <ul style="list-style-type: none"> · 심폐 역량에 따라 5가지 심박수 구간 측정으로 사용자에게 개인화된 운동 가이드 제공 · 트랙 달리기 기능으로 레인 지정 등 트랙 운동 기록 · 불규칙 심장 리듬 알림 기능 적용 - One-Click 밴드 적용으로 보다 쉽고 편리하게 워치 스트랩 교체 - 배터리 용량 확대로 실사용 성능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 47/44mm 425mAh, 43/40mm 300mAh 적용
			<p>□ Galaxy Watch7 / Galaxy Watch Ultra (2024.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch7 (44mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch7 (40mm) 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch Ultra (47mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) - 사이즈(H x Wx D) & 무게 : Watch7 (44mm) 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8g Watch7 (40mm) 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.8g Watch Ultra (47mm) 47.4 x 47.1 x 12.1 mm, 60.5g - Platform(H/W, S/W): Exynos W1000(5Core,3nm), Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) - 강력한 하드웨어로 높은 사용성 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 3나노 프로세서 탑재하여 빠른 CPU 속도와 소모 전류 효율 개선 · 이중 주파수 GPS 시스템 탑재하여 복잡한 환경에서의 GPS 정확도 개선 - 강화된 건강 모니터링 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 최종당화산물 지표(AGEs Index) 측정 제공 · 수면 무호흡 감지 및 개선된 수면 AI 알고리즘 적용하여 정확한 수면 측정 지원 - 극대화된 성능을 통해 차원 높은 아웃도어 피트니스 경험 제공 (Ultra only) <ul style="list-style-type: none"> · 시그니처 원형 디자인에 새로운 쿠션 디자인 가미 · 다이내믹 러그 시스템 적용으로 쉬운 체결과 완벽한 착용감 제공 · 10ATM 방수 자원 등 극한 환경에서 다양한 피트니스 활동 측정 · 긴 배터리 수명 제공 : 절전모드 100시간, 운동 중 절전모드 48시간 사용 가능 - 배터리 : 47mm 590mAh, 44mm 425mAh, 40mm 300mAh 적용
		Galaxy 버즈 (~2024.07.)	<p>□ Galaxy Buds3 Pro / Buds3 (2024.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신규 Stem 디자인을 통한 착용성 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 차별화된 Futuristic Blade 디자인으로 선명성 확보 - 오디오 기기 특성을 반영한 AI를 통해 개인 맞춤형 사운드 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 주변 환경에 따른 소음 최적화 및 착용 상태에 따른 실시간 사운드 최적화 - 통역 듣기모드 지원을 통한 자유로운 소통 경험 제공 - 사이즈(H x W x D)& 무게 : Buds3 Pro 18.1 x 19.8 x 33.2 mm, 5.4g Buds3 18.1 x 20.4 x 31.9 mm, 4.7g Cradle 48.7 x 58.9 x 24.4 mm, 46.5g - Platform(H/W, S/W) : BES2800(6nm)/BES2700(14nm), RTOS - 오디오 음질 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 24bit/96kHz UHQ 지원 *Buds2 Pro(24bit/48kHz Hi-Fi)

			<ul style="list-style-type: none"> • Buds3 Pro 분리형 2 Way Speaker 적용 • Adaptive EQ 지원 *Buds2 Pro(Fixed EQ) - 설계 최적화를 통한 통화 품질 개선 <ul style="list-style-type: none"> • Complex DNN/VPU 솔루션 적용으로 음성 명료도 강화 • Super Wide Band 통화 지원으로 음성 대역폭 강화 - Cradle 버튼 Pairing 적용으로 직관적인 동작 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> • Intelligence 기능 경험 강화 • Buds3 Pro Siren/Voice Detect 및 Adaptive Noise Control 지원 - 배터리 : Buds3 Pro 53mAh, Buds3 48mAh, Cradle 515mAh
		Galaxy 링 (2024.07.)	<input type="checkbox"/> Galaxy 링 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 일상 중 항상 착용 가능한 디자인으로 Galaxy Health 경험 확장 - 사이즈 : 11종 (5호 ~ 15호) - 크기 & 무게 : (Ring) 7.0(W) x 2.6 mm(D), 2.3g(5호) ~ 3.3g(15호) (Cradle) 48.9(H) x 48.9(W) x 24.5mm(D), 61.3g - Platform(H/W, S/W) : nRF5340, Zephyr RTOS - 24/7 상시 착용에 용이한 디자인 및 배터리 사용시간 • 슬림하고 가벼운 디자인으로 편안한 착용감 • 한번 충전하면 최대 7일 사용으로 건강 정보 지속 측정 가능 * 5호 18mAh ~ 15호 23.5mAh - 티타늄 소재 및 10ATM, IP68 방수 적용으로 내구성 강화 - 개인 맞춤형 건강 관리 기능 제공 • 개인의 컨디션 관리를 위한 지표 및 개인화된 인사이트 메시지 제공 • 고도화된 수면 분석 및 코칭 지원 • 고/저심박수 알람, 자동 운동 감지 등 일상 활동에 대한 모니터링 - Galaxy 사용자 차별화된 사용 경험 제공 • 단말과 연계된 Easy Pairing, 제스처 컨트롤, 링 위치 찾기 지원 • 위치와 동시 착용 시 사용시간 개선 등 최적의 사용성 제공
	네트워크	RAN S/W Package (~2024.10.)	<input type="checkbox"/> vRAN* SW Package (2023.11.) <ul style="list-style-type: none"> * vRAN(virtualized RAN): 가상화 기지국 - 당사 vRAN SW Package에 1세대 CPU 연동 개발로 업계 최초 vRAN 상용망 적용 • 당사는 3세대 CPU를 활용한 vRAN 대규모 상용을 既완료한데 이어, 4세대 CPU를 적용한 vRAN으로 상용망에서 data call 성공 <input type="checkbox"/> 5G vRAN SW PKG (2024.06.) <ul style="list-style-type: none"> - RedCap Energy-saving 기능 시험 완료(5G IoT 디바이스의 전력 소모를 줄이는 기능 시험) • 업계 최초로 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 시험 완료 • 당사는 vRAN RedCap 기술 검증(美 vRAN 상용망 등)을 이어오고 있으며, 향후 tRAN, vRAN 모두 상용 기능 제공할 계획 * tRAN(traditional RAN) : 하드웨어 기반 기지국 * RedCap(Reduced Capability) : 5G 저전력 사물 인터넷(IoT) 기술 <input type="checkbox"/> AI 기반 5G 기지국 품질 최적화 기술(AI-RAN Parameter Recommender) (2024.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 기지국 환경에 맞는 최적의 파라미터(parameter, 매개변수)를 자동으로 추천하는 AI기반 기술을 개발, SKT와 협력하여 상용망에 적용 및 실증 - 향후 기지국 성능 극대화로 체감품질 향상 및 트래픽 변화 빈번한 곳에 확대 적용 예정
		기지국 (~2024.08.)	<input type="checkbox"/> 3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 - Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국 - 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소

			<p>형화</p> <p>□ 북미向 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1세대 대비 고출력화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발 <p>□ 캐나다 n77(3.4~3.8GHz) NR 64T64R 신규 MMU (2024.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 새로운 구조의 New PAM(Power Amplifier Module : 전력 증폭기 모듈) 적용한 고출력의 <p>New MMU 플랫폼 제품 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 제품대비 Wideband 지원(고효율)으로 고출력, 저전력을 요구하는 글로벌 시장 진입이 가능해져 <p>5G 시장 확대에 기여</p> <p>* Wideband 지원: 넓은 주파수 대역 사용으로 많은 양의 데이터 동시 전송으로 전송속도가 빠름</p>
OS 부문	메모리	모바일용 DRAM (~2024.07.)	<p>□ 업계 최초 LPCAMM 개발 (2023.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPDDR 기반 모듈 개발로 PC·노트북 등 차세대 모듈 시장 선도 - SO-DIMM 대비 성능 50%↑ 전력 효율 70%↑ 탑재 면적 최대 60% 이상↓ 가능 및 교체·업그레이드 용이하여 제조 유연성 및 사용자 편의성 증대 - 주요 고객사와 차세대 시스템에서 검증 예정, 2024년 상용화 추진 및 차세대 PC·노트북부터 데이터센터 등으로 응용처 확대 기대 <p>□ 미디어텍과 업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공 (2024.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 미디어텍 최신 플래그십 모바일AP '디멘시티'에 검증 완료로 고성능 제품 상용화 선도 - 온디바이스 AI 시대에 저전력·고성능 LPDDR D램 역할 증대 - 모바일 분야 넘어 AI 가속기, 서버, HPC, 오토모티브 등 응용처 적극 확대
		서버용 DRAM (~2023.09.)	<p>□ 업계 최선단 12나노급 D램 양산 (2023.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로 <p>차세대 컴퓨팅 최적화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고유전율 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성 - 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해, 다양한 응용처에 공급 예정 <p>□ 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발 (2023.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만배 확대 - TSV 공정 적용 없이 128GB 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 동일 용량의 모듈 대비 소비 전력 10% 개선 - AI에 최적화된 고용량 D램 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 연내 양산 예정으로AI, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정
		그래픽 DRAM (~2025.01.)	<p>□ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 (2023.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 향상 - 패키지 신소재 적용·회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 <p>차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대</p> <p>□ 업계 최초 24Gb GDDR7 D램 개발 ('24.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12나노급 미세 공정 적용해 셀 집적도 증가, 업계 최고 용량 24Gb 구현 - 'PAM3 신호 방식' 적용으로 40Gbps의 속도 자랑, 최대 42.5Gbps 가능 - 'Clock 컨트롤 제어 기술' 적용 등으로 저전력 특성 구현 및 전력 효율 극대화 - 기존 그래픽 D램 응용처부터 AI 워크스테이션, 데이터센터까지 폭넓게 활용 <p>□ 업계 최초 24Gb GDDR7 D램 양산 ('25.1월)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - 그래픽 D램 중 최고 용량인 24Gb 구현으로, 고용량 그래픽 카드 수요에 대응 가능한 집적도 확보 - 업계 최고 수준인 최대 42.5Gbps 속도 및 총 1.92TB/s 대역폭을 지원하여 차세대 AI 및 그래픽 환경에 최적화 - 고열전도성 신소재 적용으로 패키지 열저항 특성을 이전 GDDR7 제품 대비 11% 개선, 고성능 동작 환경에서의 신뢰성 강화
		HBM (~2024.02.)	<input type="checkbox"/> AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 (2023.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며, 열전도를 극대화해 열 특성을 또한 개선 - 현재 HBM3 8단, 12단 제품을 양산 중이며, 차세대 제품인 HBM3E도 고객들에게 샘플을 전달 중 <input type="checkbox"/> 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발 (2024.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 12단 적층으로 업계 최대 용량 36GB 구현, - Advanced TC NCF 기술로 HBM3 8단과 동일한 높이로 12단 적층 구현 및 성능과 용량 모두 50% 이상 향상 - 업계 최소 7마이크로미터 칩간 간격으로 수직 집적도 개선 및 다양한 사이즈의 범프를 적용 - 고객사에 샘플 제공 시작, 상반기 양산 예정
		NAND (~2024.09.)	<input type="checkbox"/> 업계 최초 '9세대 V낸드' 양산 (2024.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '1Tb TLC 9세대 V낸드' 양산 - 더블 스택(Double Stack) 구조로 구현 가능한 최고 단수 V낸드 - 업계 최소 크기 두께, 차세대 인터페이스 적용 등으로 기술 리더십 증명 - 최첨단 기술로 셀 면적은 줄이면서 간섭 현상은 줄여 이전 세대 대비 비트 밀도 1.5배 증가 <input type="checkbox"/> 업계 최초 'QLC 9세대 V낸드' 양산 (2024.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 9세대 V낸드 QLC, TLC 모두 업계 최초 출시로 고용량 QLC · 고성능 TLC 통해 차세대 낸드플래시 시장 경쟁력 강화 - '채널 홀 에칭' 기술로 더블 스택 구조 등 혁신 기술 집약을 통해 업계 최고 단수 제품 구현 - 브랜드 제품 시작으로 모바일 UFS, PC · 서버 SSD 등 응용처 확대
		Client SSD (~2024.10.)	<input type="checkbox"/> 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 (2023.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상 - 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상 - DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원 <input type="checkbox"/> 업계 최고 성능 최대 용량 PC용 SSD PM9E1 양산 ('24.10월) <ul style="list-style-type: none"> - 8채널 PCIe 5.0 지원 및 8세대 V낸드 탑재로 업계 최고 성능 구현 - 고용량 4TB 옵션, AI 생성 콘텐츠 등 대용량 파일 저장 가능 - 전작 'PM9A1a' 대비 성능 최대 2배, 전력 효율 50% 이상 개선 - 신규 보안 솔루션인 SPDM 1.2버전 적용으로 데이터 위 · 변조 방지
		브랜드 SSD (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> 고성능 SSD '990 PRO' 4TB 출시 (2023.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 최첨단 '8세대 V낸드' 적용 및 업계 최고 수준 성능 구현으로 PCIe 4.0 기반 소비자용 SSD 중 가장 빠른 임의 읽기 속도 제공 - 고성능 게임, 3D/4K그래픽 작업 등 초고속 데이터 처리 작업 필요한 환경에 최적화 - 단면 설계, 열 분산 시트/히트싱크 장착으로 호환성, 방열 성능 강화 <input type="checkbox"/> 초고속 포터블 SSD 'T9' 출시 (2023.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 최신 데이터 전송 인터페이스 'USB 3.2 Gen2x2' 지원으로 전세대 대비 연속읽기/쓰기 성능 약 2배 향상 - 대용량 파일 전송 시 발생하는 성능 저하, 발열 현상 개선을 위해 표면 소재 개선 및 S/W 최적화

			<p>□ 업계 최대 8TB 용량 포터블 SSD 신제품 'T5 EVO' 출시 (2023.11.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB3.2 Gen1 기반 최대 460MB/s 연속 읽기 · 쓰기 성능 제공 - 컴팩트한 크기와 무게와 메탈링 적용하여 휴대성 강화 - 과열 방지 기술과 하드웨어 데이터 암호화 기술을 적용 <p>□ 성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO' 출시 (2024.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '970 EVO Plus' 대비 읽기 · 쓰기 속도 최대 43% 향상 - 5나노 신규 컨트롤러 탑재로 전력 효율 최대 70% 개선 - 차세대 인터페이스 PCIe 5.0 x2 지원 - 호스트 메모리 버퍼(HMB) 기술 적용으로 가격 경쟁력 강화 <p>□ PCIe 4.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '990 EVO Plus' 출시 (2024.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8세대 V낸드 · 5나노 컨트롤러 탑재로 전작 대비 읽기 · 쓰기 속도 45%, 50% 향상 및 전력 효율 70% 이상 개선 - 고용량 4TB 제품 포함 3가지 용량으로 출시로 소비자 선택지 확대 - 노트북 · PC 메인보드에 장착해 성능 · 용량 간편하게 업그레이드 가능 - 니켈 코팅된 컨트롤러와 열 분산 라벨로 과열 방지, 제품 안정성 강화 <p>□ PCIe 5.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '9100 PRO' 출시 (2025.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCIe 4.0 인터페이스 대비 2배 빠른 속도로, 전작인 '990 PRO' 대비 순차 읽기 속도 99% 향상, 전력 효율 49% 향상 - 고용량 8TB 제품 포함 4가지 용량으로 출시하여 소비자 선택지 확대 - 노트북, 데스크탑, 게임 콘솔까지 설치 가능
		CXL (~2024.06.)	<p>□ 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발 (2023.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능 - CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감 - 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응으로 <p>시장 선도</p> <p>□ 업계 최초 '레드햇 인증 CXL 인프라' 구축 (2024.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 삼성전자 내부 연구시설인 SMRC에 레드햇 인증 CXL 인프라 구축하여 제품부터 소프트웨어까지 모든 서버 구성 요소 자체 검증 가능 - 업계 최초 CMM-D 레드햇 인증 등 신속한 제품 개발 진행, 고객 맞춤 솔루션 제공 - 美 '레드햇 서밋 2024'에서 CXL 기반 서버 성능 향상 기술 시연
		브랜드 Card (~2024.08.)	<p>□ 속도와 안정성 강화한 메모리카드 'PRO Ultimate' 출시 (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UHS-I 규격 최고 수준의 200MB/s 읽기 속도, 130MB/s 쓰기 속도 지원, 기존 대비 전력 효율 37% 향상 및 방수 · 낙하 · 마모 · 엑스레이 · 온도 등 극한의 외부 환경에서도 데이터 보호 - 전문 포토그래퍼, 크리에이터 및 드론, 액션캠, DSLR 카메라 등 고해상도 콘텐츠 작업에 최적의 SD카드/마이크로SD카드 제공 <p>□ 업계 최초 SD 익스프레스 마이크로SD 카드 개발 (2024.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 마이크로SD 카드 최고 연속 읽기 성능인 초당 800 메가바이트(800MB/s)와 256GB의 고용량을 제공 - SSD에 탑재했던 DTG(Dynamic Thermal Guard) 기술을 최초 적용해 소형 폼팩터에서 발생하는 발열 문제를 효과적으로 해결 <p>□ 최신 V낸드 기반 고용량 1TB UHS-I 마이크로 SD카드 양산 (2024.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8세대 V낸드로 마이크로 SD카드에 테라바이트급 고용량 구현 - 방수, 낙하마모 등 극한 외부환경에서도 데이터를 안전하게 보호 <p>□ 고용량 1TB 마이크로SD 카드 2종 출시 (2024.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 용량 1Tb TLC 8세대 V낸드 적용하여 테라바이트급 고용량 구현 - 최대 용량 1TB로 고성능 · 고용량 솔루션에 대한 요구 충족

			<p>- 28나노 컨트롤러 탑재로 전력 효율 개선, 배터리 소모량 감소</p>
		Automotive (~2024.09.)	<p>□ 초저전력 차량용 UFS 3.1 양산 (2023.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최저 소비 전력을 가진 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 양산으로 전기차, 자율주행차 등에 최적화 - 전 세대 제품 대비 33% 낮은 소비 전력, 256GB 기준 최대 읽기 속도 2,000MB/s, 최대 쓰기 속도 700MB/s 제공 - 고객의 다양한 요구 충족을 위한 128GB/256GB/512GB 라인업 구축으로 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)용 UFS 3.1 제품과 함께 전장 스토리지 제품 라인업 강화 <p>□ 2025년 전장 메모리 시장 1위 달성을 위한 차량용 핵심 솔루션 공개 (2023.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스토리지 가상화를 통해 하나의 SSD를 분할해 여러 개의 SoC가 사용할 수 있는 'Detachable AutoSSD(탈부착 가능한 차량용 SSD)' 공개, 최대 6,500MB/s의 연속 읽기 속도를 지원하며 4TB 용량 제공 - 차량용 고대역폭 GDDR7 및 패키지 크기를 줄인 LPDDR5X 등도 선보임 <p>□ 쉐릴 차량용 솔루션에 'LPDDR4X' 공급 (2024.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 삼성전자-쉐릴, 차량용 반도체 분야에서 첫 협력 시작하여 스냅드래곤 디지털 새시에 공급 및 프리미엄 차량용 인포테인먼트 지원 - 영하 40℃~영상 105℃까지 극한 환경에서도 안정적 성능 보장 - 글로벌 완성차 및 자동차 부품 업체 등 고객사에 장기 공급 계획 <p>□ 업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발 (2024.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 256GB SSD 샘플 고객 제공 및 차량 내 AI 기능 지원 최적화 - 8세대 V낸드?5나노 기반 컨트롤러 탑재로 업계 최고 속도 구현 - 고성능 SLC 모드 지원으로 고용량 파일 빠르게 접근 가능 - 내년 초 2TB 제품 출시로 차량용 고용량 SSD 고객 수요 대응
	System LSI	이미지센서 (~2024.12.)	<p>□ 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선 - '테트라 스캐어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현 - '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원 <p>□ 업계 최고 성능 자율주행 이미지센서 출시(1H1, 2.1um/8.3Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전장 120dB HDR, LFM(LED Flicker Mitigation) 및 Motion-Artifact Free 동시 구현 - 인접 픽셀 간섭 방지 DTI(Deep Trench Isolation) 적용, 저조도 SNR 강화 <p>□ '아이소셀 비전 63D' iTOF(indirect Time of Flight) 센서 공개(63D, 3.5um/0.3Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 빛의 파장을 감지해 사물의 3차원 입체 정보를 측정 - 업계 최초 원칩 iTOF 센서 적용, 전작(33D) 대비 시스템 전력 소모량 40% 감소 - 면광원 및 점광원 모드 동시 지원하여 최대 측정거리 10미터까지 확장 <p>□ '아이소셀 비전 931' 글로벌 셔터(Global Shutter) 센서 공개(931, 2.2um/0.4Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사람 눈처럼 모든 픽셀 동시에 빛에 노출해 촬영하여 신속성 및 정확성 증가 - 사용자의 눈동자, 얼굴 표정, 손동작 같은 미세한 움직임 인식 가능 <p>□ 업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 공개(HP9, 0.56um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 독자 개발 신규 소재 적용 마이크로 렌즈 적용, 저조도 감도 대폭 향상 - 3배 망원 모듈 탑재시 최대 12배 줌까지 선명한 화질 구현 <p>□ 새로운 픽셀 기술의 집약체로 듀얼 픽셀 '아이소셀 GNJ' 출시(GNJ, 1.0um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '센서 자체 줌' 기능 탑재로 잔상, 모아레 현상 없는 선명한 해상력 구현 - 픽셀 간 격벽 물질 변경으로 픽셀 간섭 현상 최소화해 빛 투과율 향상 <p>□ 모든 화각에서 일관된 카메라 경험 선사, '아이소셀 JN5' 출시(JN5, 0.64um/50Mp)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - 얇은 옵티컬 포맷 적용하여 광각, 초광각부터 전면, 망원용까지 채용 가능 <input type="checkbox"/> 얇은 스마트폰 구현 가능한 센서 솔루션(ALoP : All Lenses on Prism) 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 렌즈와 프리즘 구조를 재배치하여 렌즈 직경이 커져도 작은 모듈 사이즈 유지
		엑시노스 (~2024.12.)	<input type="checkbox"/> 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) <ul style="list-style-type: none"> - 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영 - 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용 - 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능 <input type="checkbox"/> UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능 - 저전력 원칩으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화 - 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용 - UWB 표준 단체 'FiRa 컨소시엄' 국제 공인 인증 <input type="checkbox"/> 삼성전자-AMD, 차세대 그래픽 설계자산 파트너십 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰 외 다양한 기기에서 콘솔 게임 수준의 게이밍 경험 제공 - 차세대 그래픽 솔루션 연구개발 생태계 확장 <input type="checkbox"/> 삼성전자, 현대자동차와 차량용 인포테인먼트 분야 첫 협력 <ul style="list-style-type: none"> - 프리미엄 인포테인먼트용 '엑시노스 오토 V920', 현대자동차에 공급 - 전작(V910) 대비 대폭 향상된 성능으로 운전자에게 최적의 모빌리티 경험 선사 - 차량용 시스템 안전기준인 '에이실-B' 지원 통해 높은 안정성 제공 <input type="checkbox"/> 최첨단 모바일 AP '엑시노스 2400' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 수준의 레이 트레이싱 성능, 전작 대비 2.1배 성능 향상 - 향상된 AI성능으로 인터넷 연결없이 온디바이스 생성형 AI 기능 제공 - 비지상 네트워크(NTN : Non-Terrestrial Network) 기술, 엑시노스 최초 탑재 <input type="checkbox"/> 삼성전자, 최신 기술 적용 모바일 AP '엑시노스 1480' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 최신 4나노 공정 적용, 전작 대비 22% 개선된 전력 효율성 - 강력한 AI성능 기반으로 콘텐츠 인식 이미지 프로세싱 기능 탑재 - AMD RDNA 기반 엑스클립스 530 GPU 탑재로 전 세대 대비 그래픽 성능 향상 <input type="checkbox"/> 삼성전자, 최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 웨어러블 최초 3나노 공정 적용 및 Big 코어 탑재, 전작(엑시노스 W930) 대비 싱글코어 3.4배, 멀티코어 3.7배 성능 개선 - 최신 패키지(FO-PLP: Fan-Out Panel Level Packaging, SiP: System in Packaging, ePoP: embedded Package on Package) 적용으로 시스템 실장 공간 확보 극대화 <input type="checkbox"/> 삼성전자, 성능 대폭 개선한 모바일 AP '엑시노스 1580' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - CPU 업그레이드(Armv9) 및 트라이 클러스터 아키텍처 적용으로 탁월한 CPU 성능 - 3세대 커스텀 GPU(Xclipse 540) 탑재로 전세대(1480) 대비 최대 성능 37% 향상 - 2억화소 이미지 센서 처리 기능 및 초당 14.7조 회의 연산(TOPS) 지원 NPU 탑재
		LSI (~2025.03.)	<input type="checkbox"/> 업계 최초 하드웨어 PQC(Post Quantum Cryptography) 탑재 IC 개발(S3SSE2A) <ul style="list-style-type: none"> - 독립적인 보안 처리 및 정보 저장 가능하여, AP의 보안 연산과 관계없이 더욱 안전한 보안 환경 제공 <input type="checkbox"/> 무선 전력 컨소시엄(Wireless Power Consortium)의 Qi 표준을 지원하는 무선충전 IC 개발(S2MIW06) <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 환경에서 일관된 성능 지원 및 대용량 내장 메모리 활용 펌웨어 기반 동작 - 최대 50W의 고효율 무선 충전 및 스마트폰의 무선 배터리 공유 기능 지원
		Foundry HPC 전용 4나노 4세대 공정 (2024.11.)	<input type="checkbox"/> High-Performance Computing(HPC) 전용 공정의 4나노 4세대 공정 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 고속 동작 트랜지스터와 개선된 후속 배선 공정 (BEOL) 추가를 통한 RC 지연 감소 제공하는 고성능 저전력 HPC용 최적화된 공정 - 2.5D/3D 선행 패키지 기술 지원 가능
SDC	디스플레이 패널	Galaxy북3 프로용 14/16" OLED개발	<input type="checkbox"/> 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상품화 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용

		(2023.02.)	<ul style="list-style-type: none">- 신규재료 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화- 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소
	HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.)	<input type="checkbox"/> OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성 <ul style="list-style-type: none">- 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10)- 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제공	
	Google Pixel 8pro용 OLED개발 (2023.10.)	<input type="checkbox"/> 고효율, 장수명 OLED 신규재료 적용으로 고회도 (HBM 1,600nits, Peak 2,400nits), 저소비전력 구현 <ul style="list-style-type: none">- 6.7" WQXGA+ (1,344 x 2,992)- 1~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 및 Dead Space 최소화 기술 적용	
	Galaxy S24 AMOLED개발 (2024.01.)	<input type="checkbox"/> Galaxy S24 (6.16"FHD+, 6.66"WQ+, 6.79WQ+) <ul style="list-style-type: none">- 고해상도 저소비전력 기술과 패널 Dead Space 최소화 기술 적용- 고해상도에서 고회도 및 저전력, Slim Bezel구현, 화질 특성 및 사용자 체감성능 향상	
	31.5"UHD, 27"QHD QD-OLED개발 (2024.01.)	<input type="checkbox"/> 31.5"(140ppi), 27"(360Hz) QD-OLED 모니터개발 <ul style="list-style-type: none">- 초정밀 잉크젯 프린팅 기술 및 당사 고유 AI 기반 구동 알고리즘 기술로 고해상도(140ppi), 고주사율(360Hz) 자발광 제품 개발	
	BMW Mini 13.4" 185ppi개발 (2024.06.)	<input type="checkbox"/> 13.4", 차량 Center Information Display용 Round OLED Display (1,752 x 1,660) <ul style="list-style-type: none">- Automotive向 Round Shape 최초 적용- 新 보상회로 및 패널구조 개발로, 비정형 Display의 영역별 균일특성 확보- 대면적 비정형 OCTA 기술 개발	
	Surface Pro 10 개발 (2024.05.)	<input type="checkbox"/> 13" WQ+ (2,880x1,920, 3:2) <ul style="list-style-type: none">- 30Hz 저주파 구동 노트북 OLED 최초 적용 (30~120Hz 가변주사율)으로 저소비전력 구현	
	Galaxy Z Fold6용폴 더블 OLED개발 (2024.07.)	<input type="checkbox"/> 7.61" (2,160x1,856) 폴더블용 Display <ul style="list-style-type: none">- 광효율 및 시인성 개선 新패널 구조/재료 적용으로 저소비전력 구현, 화질 개선- 폴더블 내구성 향상 구조/재료 적용	
	Google Pixel 9proXL용 OLED개발 (2024.09.)	<input type="checkbox"/> 6.75"고화질/저전력 스마트폰용 Display · 1,344 x 2,992, Peak 휘도 3,000nit <ul style="list-style-type: none">- 저소비전력 패널 구조와 고효율 신규 유기재료 적용으로 밝기와 수명, 화질 개선 및 소비전력 10% 감소	
	Galaxy S25 Ultra AMOLED 개발 (2025.01.)	<input type="checkbox"/> 6.86" WQ (1,440 x 3,120) <ul style="list-style-type: none">- 전작比 Display size는 확대하고 좌우,하단 Border 및 두께 감소로 Full Screen, Slim 디자인 구현- 120Hz 주사율, 고회도(Peak 2,600nit)	
	27"UHD 16:9 QD-OLED 모니터 개발 (2025.03.)	<input type="checkbox"/> 자발광 최고 해상도 27"U 16:9 (160ppi) 프리미엄 모니터 <ul style="list-style-type: none">- 초정밀 제어 잉크젯 프린팅 기술로 27"UHD 고해상도구현, Pixel 집적도 향상- 선명한 고화질 제품으로 게임 몰입감 향상 및 사진 편집, 동영상 제작 등 생산성 증가 기여 가능	

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계